

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

เครื่องกีดขวางแผ่นวางจรมพิมพ์ความคมด้วยคอมพิวเตอร์



โดย

นาย ทรงวิทย์ เจริญราษฎร์ รหัส 33504011

นาย อภินันท์ เข้มกล้าดนาค รหัส 33504047

ร/พ.
ท 116ค
2536

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน.....
วัน,เดือน,ปี.....

6/2554935

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชา ฟิลิกส์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มีนาคม 2536



Computerized Printed Circuit Board Etching Machine

Mr.songwit Charoenruaywattana

Mr.Apinan Khengladnark

**A Special Project Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirement for the Degree of bachelor of science
Department of Applied Physics
Faculty of science
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
March 1994**

หัวข้อโครงการพิเศษ	เครื่องกัดลายแผ่นนางจรพิมพ์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
นักศึกษา	นายทรงวิทย์ เจริญรายวัฒนา นายอภิวัฒน์ เข้มกลัดนาค
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร. วราวุฒิ เถาลัดดา อาจารย์ อนุชิต จารุวนาวัฒน์
ภาควิชา	ฟิลิกส์ประยุกต์
ปีการศึกษา	2536

บทคัดย่อ

ในการพัฒนาางจรอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากออกแบบและทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะต้องทำการออกแบบลายวงจร แล้วจึงผ่านขั้นตอนการกัดลายวงจรบนแผ่นนางจรพิมพ์ซึ่งใช้วิธีทางเคมี โดยการนำลายพิมพ์ของวงจรไปแช่ในสารเคมีเพื่อกัดทองแดงส่วนที่ไม่ต้องการออกซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องทำโดยบุคลากรที่มีความชำนาญ นอกจากนี้วิธีการทางเคมียังเป็นวิธีที่สิ้นเปลืองสารเคมี และสารเคมีที่ใช้ยังทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โครงการนี้จึงได้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้สร้างแผ่นนางจรพิมพ์โดยใช้วิธีการแกะสลัก การทำงานจะถูกควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้เพียงแค่ป้อนนางจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบไว้เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นไมโครคอมพิวเตอร์จะควบคุมเครื่องกัดลายวงจรบนแผ่นนางจรพิมพ์โดยตรง วิธีการนี้จะช่วยให้ผลิตแผ่นนางจรได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีการทางเคมี

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากหลาย ๆ ฝ่าย คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ดร.วราวุฒิ เถาลัดดา และ อาจารย์อนันต์ จารุวนาวัฒน์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วิโรจน์ เตชะวิญญธรรม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ได้ให้คำปรึกษาและจัดทำชุดขับเคลื่อน คุณสุชาติ ตุลาภรณ์โชติ(บริษัท เคเคซี) ที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเลือกใช้บอลสกรู (ball screw) และ linear system และสุดท้ายขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ให้ความสนใจ

คณะผู้จัดทำโครงการ

นาย ทรงวิทย์ เจริญราษฎร์

นาย อภินันท์ เข้มกลัดนาค

มีนาคม 2537

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อปัญหาพิเศษภาษาไทย	
บทคัดย่อปัญหาพิเศษภาษาอังกฤษ	
กิตติกรรมประกาศ	
สารบัญตาราง	
สารบัญรูป	
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการพิเศษ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 การออกแบบระบบขับเคลื่อน 3 แกน	4
2.1 การเลือกระบบขับเคลื่อน	4
2.2 การเลือกชนิดของมอเตอร์	4
2.3 การเลือกขนาดของบอลสกรู	6
2.4 การเลือกขนาดของมอเตอร์	6
บทที่ 3 การสร้างระบบขับเคลื่อน 3 แกน	9
3.1 วัสดุอุปกรณ์ของระบบขับเคลื่อน	9
3.1.1 ทางแกน XY	9
3.1.2 ทางแกน Z	10
3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการกัดเซาะแผ่นปรีนท์	11
3.3 หลักการทำงานของระบบขับเคลื่อน	16

บทที่ 4	การออกแบบและสร้างระบบควบคุมพร้อมระบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์	17
4.1	ชุดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 8255 อิกททุท/เอาก์ททุททอ์ท	17
4.1.1	การแบ่งแอดเดรสของ IBM/PC	17
4.1.2	การ decode address	20
4.2	ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์	23
4.2.1	ET-SMCC STEPPING MOTOR CONTROL	23
4.2.2	TCA 1560B	31
4.3	แหล่งจ่ายไฟ	31
บทที่ 5	โปรแกรมควบคุม	33
5.1	การทำงานของโปรแกรม	33
5.2	วิธีการใช้โปรแกรม	34
บทที่ 6	การทดลองและผลการทดลอง	44
6.1	การติดตั้งและทดสอบระบบขับเคลื่อน (XYZ-TABLE)	44
6.2	การทดสอบการทำงานร่วมกัน 3 แกน	46
6.3	การทดสอบความถูกต้องในการลากเส้น	46
6.4	การทดลองการทำแผ่น PCB	46
บทที่ 7	สรุปและข้อเสนอแนะ	50
ภาคผนวก		
ส่วนของโปรแกรม		
บอลสกรู(ball screw)		
หัวก๊าดเอ็นมิลล์		
คาด้าชีท(date sheet)		
แบบของ XYZ-Table		
เอกสารอ้างอิง		

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 4.1 การแบ่งแอดเดรสของ IBM/PC	19
ตารางที่ 4.2 แสดงการขับเคลื่อนแบบ Half Step	29
ตารางที่ 4.3 แสดงการขับเคลื่อนแบบ Full Step	29
ตารางที่ 4.4 แสดงการขับแบบ One-Two Motor Drive	30

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 3.1 ภาพแสดงลักษณะของ Ball Screw ที่นำมาใช้งาน	9
รูปที่ 3.2 ภาพเขียนของระบบขับเคลื่อนทางแกน X	12
รูปที่ 3.3 ภาพเขียนของระบบขับเคลื่อนทางแกน Y	13
รูปที่ 3.4 ภาพถ่ายของระบบขับเคลื่อน XY	14
รูปที่ 3.5 ภาพถ่ายของระบบขับเคลื่อนทางแกน Z	14
รูปที่ 3.6 ภาพเขียนระบบขับเคลื่อนทางแกน Z	15
รูปที่ 3.7 ภาพแสดงลักษณะของหัว endmill	16
รูปที่ 4.1 ระบบบัสของ IBM/PC	18
รูปที่ 4.2 แผนผังโครงสร้างภายในและการจัดขาไอซี 8255	21
รูปที่ 4.3 การต่อ 8255 กับวงจร decode	22
รูปที่ 4.4 การจัดวางอุปกรณ์ของ ET-SCMM	23
รูปที่ 4.5 การต่อ ET-SCMM กับอุปกรณ์ต่าง ๆ	25
รูปที่ 4.6 การต่อ Power Supply กับ ET-SMCC	26
รูปที่ 4.7 การใช้งานพอร์ตอินพุทของบอร์ด ET-SMCC	27
รูปที่ 4.8 การหัดตำแหน่งของ Jumper เพื่อเลือกพอร์ตใช้งาน	27
รูปที่ 4.9 การต่อบอร์ด ET-SMCC เพื่อใช้งานร่วมกัน	27
รูปที่ 4.10 การเลือกตำแหน่งของพอร์ตอินพุท	28
รูปที่ 4.11 รายละเอียดขา Connector ของ ET-SMCC	28
รูปที่ 4.12 วงจรชุดขับเคลื่อนสแต็ปมอเตอร์ทางแกน Z	31
รูปที่ 4.13 วงจร Power Supply	32
รูปที่ 5.1 Flowchart ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น	35
รูปที่ 5.2 Flowchart ของโปรแกรมในส่วนการ Load File	36
รูปที่ 5.3 Flowchart ของโปรแกรมในส่วนการหาขอบของภาพ	37

รูปที่ 5.4	Flowchart ของโปรแกรมในส่วนการทำแผ่น PCB	38
รูปที่ 5.5	ภาพถ่ายของเมนูที่ใช้ในโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น	39
รูปที่ 5.6	ภาพถ่ายของลາສາວຈຽກທີ່ວາດບນຈອກາພ	40
รูปที่ 5.7	ภาพถ่ายของลາສາວຈຽກที่ผ่านขั้นตอนการหาขอบแล้ว	40
รูปที่ 5.8	ภาพแสดงตำแหน่งในการ Initial	41
รูปที่ 5.9	ภาพแผ่น PCB เมื่อเสร็จสิ้นการทำงาน	42
รูปที่ 5.10	ภาพของลາສາວຈຽກที่แสดงบນຈອກາພ	43
รูปที่ 5.11	แสดงจอภาพเมื่อเลือกตัวเลือก Help	43
รูปที่ 6.1	ภาพถ่ายของ XYZ-Table พร้อมระบบขับเคลื่อนซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์	44
รูปที่ 6.2	ไดอะแกรมของระบบควบคุมการทำงานของระบบ	45
รูปที่ 6.3	ภาพลายเส้นที่ใช้ในการทดสอบการทำงานของแท่น	47
รูปที่ 6.4	ผลการทดลองสร้างภาพจากต้นแบบรูปที่ 6.3	47
รูปที่ 6.5	ภาพลายเส้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3", 2" และ 1" ตามลำดับ	48
รูปที่ 6.6	ผลการทดลองสร้างภาพจากต้นแบบรูปที่ 6.4	48
รูปที่ 6.7	ภาพลາສາວຈຽກที่ออกแบบบนโปรแกรม Protel	49
รูปที่ 6.8	ภาพแผ่น PCB ที่ได้จากการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้น	49
รูปที่ 7.1	แสดงเส้นที่เกิดขึ้นจากความลึกในการกัดเจาะไม้เท่ากัน	51

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการพิเศษ

ในการพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากการออกแบบและทดลองเรียบร้อยแล้ว การสร้างเครื่องต้นแบบจะต้องทำการออกแบบลายวงจร แล้วจึงผ่านขั้นตอนการกัดลายวงจร บนแผ่นวงจรพิมพ์โดยวิธีการทางเคมี โดยขั้นแรกจะต้องพิมพ์ลายวงจรลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ จากนั้นจะต้องนำไปแช่ในสารเคมีเพื่อกัดลายวงจรตามที่ต้องการ วิธีการนี้จะต้องทำโดยบุคคลากรที่มีความชำนาญ นอกจากนี้วิธีการทางเคมียังเป็นวิธีที่สิ้นเปลืองทั้งสารเคมี และเวลาอีกทั้งสารเคมีเหล่านั้นยังทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จะเห็นได้ว่าวิธีการนี้ไม่เหมาะสม ในการสร้างเครื่องต้นแบบ

โครงการวิจัยนี้เป็นการออกแบบและจัดสร้างเครื่องกัดลายวงจรลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ โดยใช้วิธีทางกลแทนวิธีทางเคมีได้แก่วิธีการแกะสลัก โดยการทำงานจะถูกควบคุมโดย ไมโครคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้เพียงแต่ป้อนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบไว้เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นไมโครคอมพิวเตอร์จะวาดลายวงจร และส่งข้อมูลไปยังเครื่องกัดลายวงจรให้ กัดลายวงจรนั้นลงบนแผ่นวงจรพิมพ์โดยตรง วิธีการนี้จะช่วยให้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับ เครื่องต้นแบบได้ง่าย และรวดเร็วกว่าวิธีการทางเคมี ดังนั้นในโครงการนี้จึงได้จัดทำขึ้นมา เพื่อทำการวิจัย และเพื่อที่จะทำการพัฒนาต่อไป

โดยเรียกโครงการนี้ว่า "เครื่องกัดลายแผ่นวงจรพิมพ์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์"

(Computerized Printed Circuit Board Etching Machine)

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์รวมทั้ง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้น

1.3 ขอบเขตของโครงการพิเศษ

1. ทำการออกแบบและสร้างชุดขับเคลื่อน 3 แกน (XYZ-TABLE)
2. ออกแบบและสร้างชุดควบคุม (HARDWARE) พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SOFTWARE)
3. ทดสอบการทำงาน
4. หาข้อบกพร่องและแนวทางที่จะพัฒนาต่อไป

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบชุดขับเคลื่อน 3 แกน (XYZ-TABLE)
2. จัดหามอเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับชุดขับเคลื่อน 3 แกน
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในการสร้างชุดขับเคลื่อน 3 แกน
4. จัดทำชุดควบคุมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุม
5. ศึกษาการทำงานของโปรแกรมโปรเทล (PROTEL)
6. จัดทำโปรแกรมที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลจากโปรแกรมโปรเทล (PROTEL) ไปยังชุดขับเคลื่อน 3 แกน
7. จัดหาวัสดุที่จะนำมาใช้ในการกัดแผ่นปริ้นท์
8. ทดสอบการทำงานของแต่ละส่วนของระบบ
9. วิเคราะห์และสรุปผล

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการควบคุมระบบเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปในอนาคต
2. สามารถสร้างชุดขับเคลื่อนที่ในระนาบ XYZ ด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งชุดขับเคลื่อนนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานหลายๆอย่าง อาทิเช่น LASER SCANNING, LASER MARKING, เครื่องตัดโลหะ ฯลฯ

3. เป็นพื้นฐานในการสร้างบุคคลกรทางด้านนี้ให้แพร่หลาย เนื่องจากในปัจจุบัน บุคคลกรทางด้านนี้มีค่อนข้างน้อย
4. ในเชิงพาณิชย์สามารถที่จะผลิตออกมาขายได้ ปัจจุบันมีขายในต่างประเทศแล้ว แต่มีราคาค่อนข้างสูง

บทที่ 2

การออกแบบระบบขับเคลื่อน 3 แกน (XYZ-TABLE)

2.1 การเลือกระบบขับเคลื่อน

ระบบขับเคลื่อนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

1. ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน เช่น ใช้สายพานหรือลวดสลิงเป็นตัวขับเคลื่อนชิ้นงาน ซึ่งมีข้อดีคือมีราคาถูก และสร้างได้ง่ายแต่มีข้อเสียคือการบ่งชี้ตำแหน่งผิดพลาดได้ง่าย

2. ระบบขับเคลื่อนแบบฟันเกลิ้อ เช่น เกลิ้อหอนแบบลูกปืน (BALL SCREW) ซึ่งมีข้อดี คือ มีความเที่ยงตรงของตำแหน่งสูงมาก แต่มีข้อเสีย คือ ราคาแพงเนื่องจากวัสดุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อสร้างระบบขับเคลื่อน 3 แกน สำหรับใช้วางแผ่นปริ้นท์ที่ใช้ในการกัดเซาะผิวทองแดงบนแผ่นปริ้นท์ ดังนั้นความเที่ยงตรงแม่นยำของตำแหน่งจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก จึงทำให้การทำโครงการพิเศษนี้เลือกใช้ระบบขับเคลื่อนแบบบอลสกรู (BALL SCREW)

หลังจากเลือกระบบขับเคลื่อนแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเป็นการออกแบบระบบขับเคลื่อน ซึ่งไดอะแกรมของระบบขับเคลื่อนจะต้องกำหนดตัวแปรที่ต้องการขึ้นมาก่อน ซึ่งในที่นี้ได้แก่

1. ระยะทางที่ขับเคลื่อนได้ (TRAVEL LENGTH)

2. ความละเอียดในการขับเคลื่อน

การกำหนดระยะทางที่เคลื่อนที่ทางแกน X และแกน Y ซึ่งในที่นี้ได้กำหนดไว้ให้ทางแกน X มีระยะทางเคลื่อนที่ได้ 200 ม.ม. และทางแกน Y มีระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ 200 ม.ม. (สำหรับระยะทางที่เคลื่อนที่ก็คือระยะความยาวของบอลสกรู ต้องคำนึงถึงความยาวของบอลสกรูที่มีขายหรือหาซื้อได้ตามท้องตลาด)

2.2 การเลือกชนิดของมอเตอร์

หลังจากที่เลือกระบบขับเคลื่อนได้แล้ว จะต้องทำการเลือกชนิดของมอเตอร์ที่ต้องการใช้ในการขับเคลื่อนบอลสกรูที่ได้เลือกใช้ในระบบขับเคลื่อนดังกล่าวแล้วในการเลือกชนิดของมอเตอร์นั้นจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของมอเตอร์แต่ละชนิด ตามความชำนาญของผู้ใช้และความยากง่ายในการหาซื้อ ซึ่งจะพิจารณาแต่ละชนิดดังต่อไปนี้

(1) มอเตอร์กระแสตรง (DC MOTOR)

มอเตอร์ชนิดนี้เป็นที่ยอมรับว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนที่ที่มีขนาดดีพอสมควร แต่ต้องคำนึงถึงปัญหาในการควบคุม ได้แก่

1. ไม่สามารถทราบถึงตำแหน่งของมุมที่หมุนไปของแกนมอเตอร์ ดังนั้นการที่จะต่อใช้งานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก

2. ปัญหาเรื่องแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์กระแสตรง เพราะมอเตอร์กระแสตรงไม่สามารถเบรคได้เองโดยลำพัง ต้องอาศัยการเบรคจากระบบภายนอกซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากในการควบคุม

จากปัญหาทั้ง 2 ข้อจะเห็นว่าการเลือกใช้มอเตอร์แบบนี้ แล้วระบบควบคุมจะต้องมีขนาดใหญ่ ซับซ้อนและยากต่อการควบคุม ถึงแม้ว่ามอเตอร์แบบนี้จะหาซื้อได้ง่ายก็ตาม แต่โดยเหตุผลรวมแล้วจะไม่เลือกใช้มอเตอร์ชนิดนี้ในโครงการนี้

(2) เซอร์โวมอเตอร์กระแสตรง (DC servo motor)

มอเตอร์ชนิดนี้ใช้งานได้ดีกับระบบขับเคลื่อน [1, 2] มอเตอร์แบบนี้จะหาซื้อได้ยากภายในประเทศ เท่าที่หาซื้อได้ในท้องตลาดจะเป็นมอเตอร์เก่าซึ่งไม่ทราบสมบัติเฉพาะตัวของมัน จึงเป็นการยากในการจัดทำชุดควบคุมมอเตอร์ ดังนั้นในโครงการพิเศษนี้จึงไม่เลือกใช้มอเตอร์ชนิดนี้

(3) สเต็ปป์มอเตอร์ (STEPPING MOTOR)

มอเตอร์ชนิดนี้เป็นมอเตอร์ที่มีการหมุนในลักษณะเป็นสเต็ป ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการการกระตุกไปที่ละสเต็ป ซึ่งถ้ามองอย่างผิวเผินอาจคิดว่าไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน เพราะจะทำให้การเคลื่อนที่งานของมีการกระตุกไปเป็นช่วงทำให้ไม่มีความต่อเนื่องในการเคลื่อนที่ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยอาศัยเทคนิคพิเศษเสริมเพิ่มเข้าไปนอกเหนือจากการใช้งานปกติ ทำให้มีการขับเคลื่อนทีละ $1/n$ step เทคนิคนี้เรียกว่า "การจ่ายกระแสแบบพัลส์" และมีการใช้มอเตอร์ชนิดนี้ในระบบต่าง ๆ อย่างแพร่หลายและหาซื้อได้ในท้องตลาดค่อนข้างง่าย ดังนั้นในโครงการนี้จึงเลือกใช้สเต็ปป์มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งสเต็ปป์มอเตอร์ที่หาซื้อได้โดยทั่วไปเป็นแบบ 200 สเต็ปต่อรอบ หรือ 1.8 องศาต่อสเต็ป ดังนั้นการหมุนของมอเตอร์ในแต่ละรอบมีเพียง 200 สเต็ปเท่านั้น ซึ่งการหมุนแต่ละสเต็ปค่อนข้างหยาบ จึงจำเป็นต้องออกแบบชุดควบคุมการหมุนของมอเตอร์ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ต้องกำหนดความละเอียดในการเคลื่อนที่ของมอเตอร์โดยการกำหนดสเต็ปที่ต้องการในหนึ่งรอบ

ซึ่งในโครงการนี้ต้องการควบคุมมอเตอร์ให้มอเตอร์เคลื่อนที่ได้ 400 สเต็ปต่อรอบนั้นคือมีความละเอียด 0.9 องศาต่อหนึ่งสเต็ป

2.3 การเลือกขนาดของบอลสกรู

หลังจากที่กำหนดแล้วว่าต้องการสร้างชุดควบคุมมอเตอร์ให้มอเตอร์เคลื่อนที่ได้ 400 สเต็ปต่อรอบ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเลือกขนาดของบอลสกรู ในการออกแบบเพื่อใช้ขนาดของบอลสกรู และจำนวนพิตช์(Pitch)หรือระยะระหว่างเกลียวของบอลสกรูนั้น โดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิตจะผลิตบอลสกรูที่มีระยะระหว่างเกลียว 2.00-20.00 มม. ซึ่งเป็นระยะทางที่บอลสกรูจะขับเคลื่อนงานได้ โครงการนี้ได้เลือกใช้บอลสกรูที่มีระยะระหว่างเกลียว 2 มม. หมายความว่าบอลสกรูหมุนไปหนึ่งรอบงานจะเคลื่อนที่ได้ 2 มม. นั่นคือถ้ามอเตอร์เคลื่อนที่ 1 รอบ หรือ 400 สเต็ปงานจะเคลื่อนที่ได้ 2 มม. แต่ถ้ามอเตอร์หมุนไปหนึ่งสเต็ปงานจะเคลื่อนที่ $2 \text{ มม.} / 400 = 5 \text{ ไมโครเมตร}$ ซึ่งเป็นระยะการเคลื่อนที่ที่มีความละเอียดสูงพอต่อการเคลื่อนที่ของมอเตอร์แต่ละสเต็ป ดังนั้นจึงใช้บอลสกรูที่มีระยะระหว่างเกลียว 2 มม. ส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นไม่สนใจมากนักเพราะโครงการนี้ไม่ต้องการ critical speed มาก

2.4 การเลือกขนาดของมอเตอร์

ก่อนที่จะเลือกขนาดของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนบอลสกรู นั้นจะต้องทำการคำนวณหาแรงบิดทั้งหมดที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อนบอลสกรูเสียก่อนซึ่งเมื่อทำการออกแบบส่วนต่าง ๆ มาถึงขณะนี้ สามารถสรุปข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตัวของระบบขับเคลื่อนนั้นๆ ได้จึงสามารถที่จะคำนวณหา Torque ได้ดังนี้

Torque ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อนบอลสกรู

$$T_{\text{Total}} = T_{\text{Weight}} + T_{\text{Friction}} + T_{\text{Cutting}} + T_{\text{Acceleration}}$$

1. คำนวณหา T_{Friction} (T_F)

$T_F = \text{Torque}$ เนื่องจากแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น

$$[T_{F(\text{Table})} + T_{F(\text{Screw})}] \cdot i$$

เมื่อ $i = \text{Gear ratio} = 1$ สำหรับ direct couple ระหว่าง
มอเตอร์กับบอลสกรู (นั่นคือไม่ใช้ gear box)

$$T_{F(\text{Table})} = mg\mu h/2\pi$$

m = มวลของชิ้นงาน + มวลของแท่นวางชิ้นงาน + มวลของชุด
จับเคลื่อนแกน Y ที่วางอยู่บนแกน X

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

μ = สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่าง steel กับ steel

h = ระยะระหว่างเกลียว 2 มม

โดยการคิดค่า T_F นี้เป็นค่าที่ได้จากประสบการณ์ของวิศวกรที่ทำงานทางด้านนี้

2. คำนวณหาค่า $T_{W(\text{table})}$ (T_w) สำหรับแกน X

T_w = Torque เนื่องจากน้ำหนักที่บอลสกรูต้องจับในแนวแกน X

$$= mg \sin \alpha \cdot hi/2$$

= Axis angle ของบอลสกรู

สำหรับ Horizontal axis, $\sin \alpha = 0$

สำหรับ Vertical axis, $\sin \alpha = 1$

ในกรณีที่แกนของบอลสกรูอยู่ในแนวราบ, $\sin \alpha = 0$ ดังนั้น $T_w = 0$

3. คำนวณหา T_{cutting}

ในกรณีของ MACHINE TOOLS เช่น MILLING MACHINE มีการสัมผัสระหว่าง
ดอกสว่านกัดโลหะกับชิ้นงาน ดังนั้น Torque ที่เกิดขึ้นระหว่างการกัดโลหะแต่ในกรณีของ
โครงการนี้ก็เหมือนกันจะมี Torque เกิดระหว่างหัวกัดเส้นมิลล์ (end mill) กับทองแดง
ที่อยู่บนแผ่นปรินต์

4. $T_{\text{Acceleration}}$ (T_A)

ในกรณีที่ยังไม่มีการเคลื่อนที่ จะทำให้ $T_A = 0$ แต่จากข้อ 1-3

สามารถคำนวณหาขนาดของมอเตอร์ได้อย่างคร่าวๆแล้ว

แต่เนื่องจากในโครงการนี้งบประมาณจำกัด ดังนั้นมอเตอร์ที่ใช้จึงใช้ของเก่าที่หาซื้อได้
ตามที่ตลาดทั่วไป โดยใช้มอเตอร์ดังนี้ Stepping Motor Type 103G770-3B ของบริษัท
Sanyo

บทที่ 3

การสร้างระบบขับเคลื่อน 3 แกน (XYZ-TABLE)

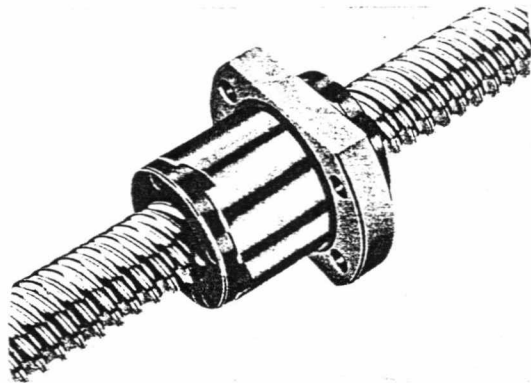
3.1 วัสดุอุปกรณ์ของระบบขับเคลื่อน

หลังจากที่ได้ทำการออกแบบและคำนวณหาขนาดของส่วนต่าง ๆ ของระบบขับเคลื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการหาวัสดุอุปกรณ์ของระบบขับเคลื่อนโดยจะทำการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

3.1.1 ทางแกน XY

1.บอลสกรู (BALL SCREW)

เป็นแบบ Precision-Rolled Thread ดังแสดงในรูปที่ 3.1 วัสดุที่ใช้ทำบอลสกรูเป็น stainless steel ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม และความยาวของบอลสกรูทางแกน X และแกน Y 300 มม (รายละเอียดของบอลสกรูดูในเอกสารอ้างอิง)



รูปที่ 3.1 ลักษณะของ Ball Screw ที่นำมาใช้งาน

2. Thrust bearing

เป็นแบริ่งสำหรับใช้ยึดปลายของบอลสกรูเข้ากับแท่นยึด (Ball screw block) ในแต่ละแกนต้องใช้แบริ่งยึดปลายของบอลสกรูยึดกับแท่นแกนละ 1 ตัว ดังนั้นบอลสกรูในแต่ละแกนจะต้องใช้ thrust bearing จำนวน 2 ตัว

3. motor coupling

ทำด้วยเหล็กเป็นรูปทรงกระบอกเจาะรูให้อยู่ในแนวเดียวกัน เพื่อใช้สำหรับต่อโดยตรง (direct coupling) ระหว่างแกนของมอเตอร์กับแกนของบอลสกรู

4. motor

เป็นสแตมป์มอเตอร์ของบริษัท SANYO รุ่น 103G770-38 มีจำนวนสแตมป์เท่ากับ 200 สแตมป์ต่อรอบ หรือ 1.8 องศาต่อสแตมป์

5. Linear system

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรองรับตัวบอลสกรู และใช้ช่วยในการลดแรงเสียดทานภายในระหว่างที่แท่งทำงาน

6. ตัวแทน XY

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแท่งนั้นเป็นอลูมิเนียมแล้วมาทำการหล่อขึ้นรูปตามแบบในภาคผนวก เหตุที่เลือกใช้อลูมิเนียมเพราะว่ามีน้ำหนักเบา, ไม่เป็นสนิม และมีความสวยงาม โครงสร้างของระบบขับเคลื่อนทางแกน X และ แกน Y และภาพถ่ายของแท่งที่สร้างขึ้นแสดงดังรูปที่ 3.2 - รูปที่ 3.4

3.1.2 ทางแกน Z

1. เกลียวคางหมู 4 ปาก

โลหะที่นำมาใช้ทำนั้นเป็น STAINLESS STEEL มีหน้าที่ใช้เป็นเกลียวสำหรับขับเคลื่อนทางแกน Z เหตุที่ใช้เกลียวแบบนี้เพราะว่าทางด้านแกน Z ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ความละเอียดสูง

2. thrust bearing

ใช้ลักษณะเดียวกับในทางแกน XY

3. motor

เป็นสแตมป์มอเตอร์ของบริษัท SANYO DENKI รุ่น 103-771-16 และมีจำนวนสแตมป์เท่ากับ 200 สแตมป์ต่อรอบ หรือ 1.8 องศาต่อสแตมป์

4. ตัวแทนแกน Z

ใช้วัสดุเช่นเดียวกับในทางแกน XY

5. เพลา (shaft)

เป็นเพลา solid shaft ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 mm โดยเพลาแต่ละอันจะถูกสวมผ่าน linear compact set สำหรับระบบขับเคลื่อนแกน Z จะมี compact linear set จำนวน 2 ตัว เพื่อทำหน้าที่ยึดเพลาในแกน Z กับแท่นรองระบบขับเคลื่อน

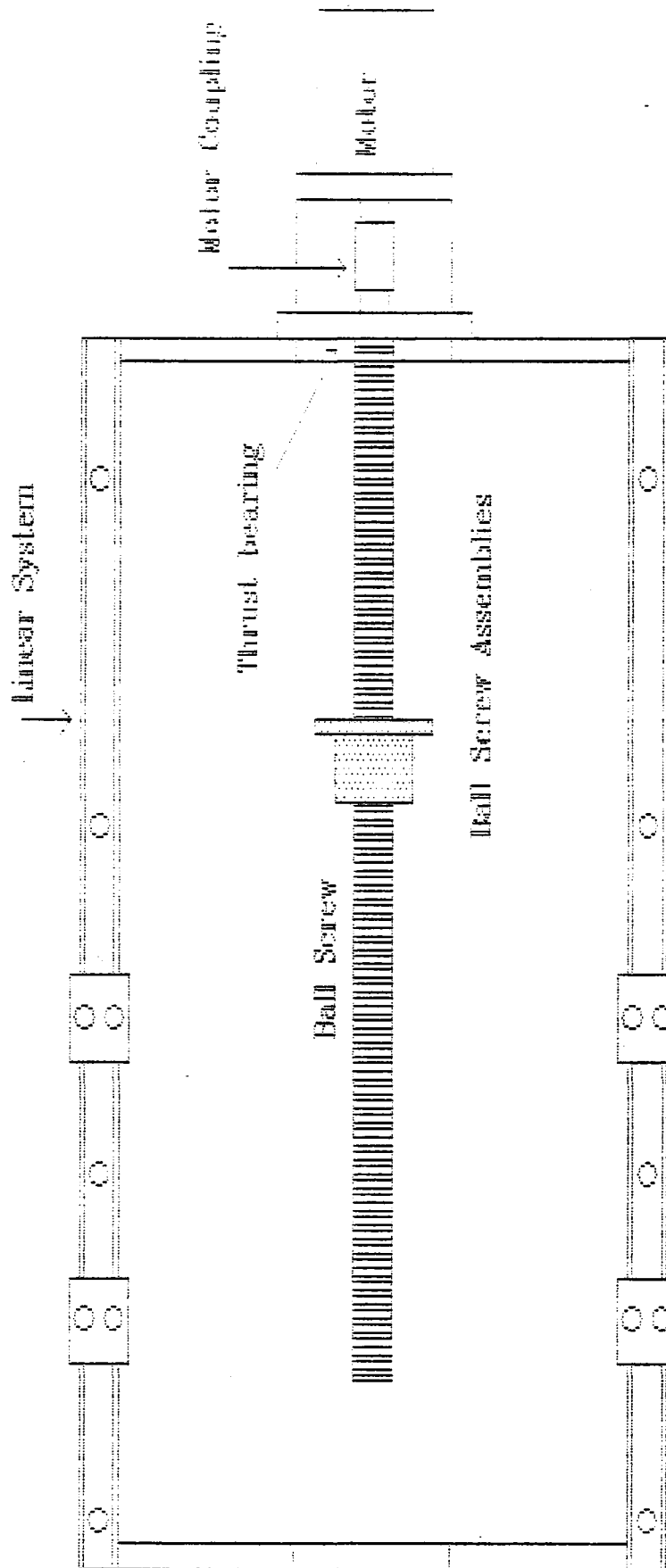
6. Linear compact set

ทำหน้าที่ช่วยทำให้การเคลื่อนที่มีความราบเรียบ และช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างโลหะด้วยเพราะว่ามีลูกปืนอยู่ข้างใน

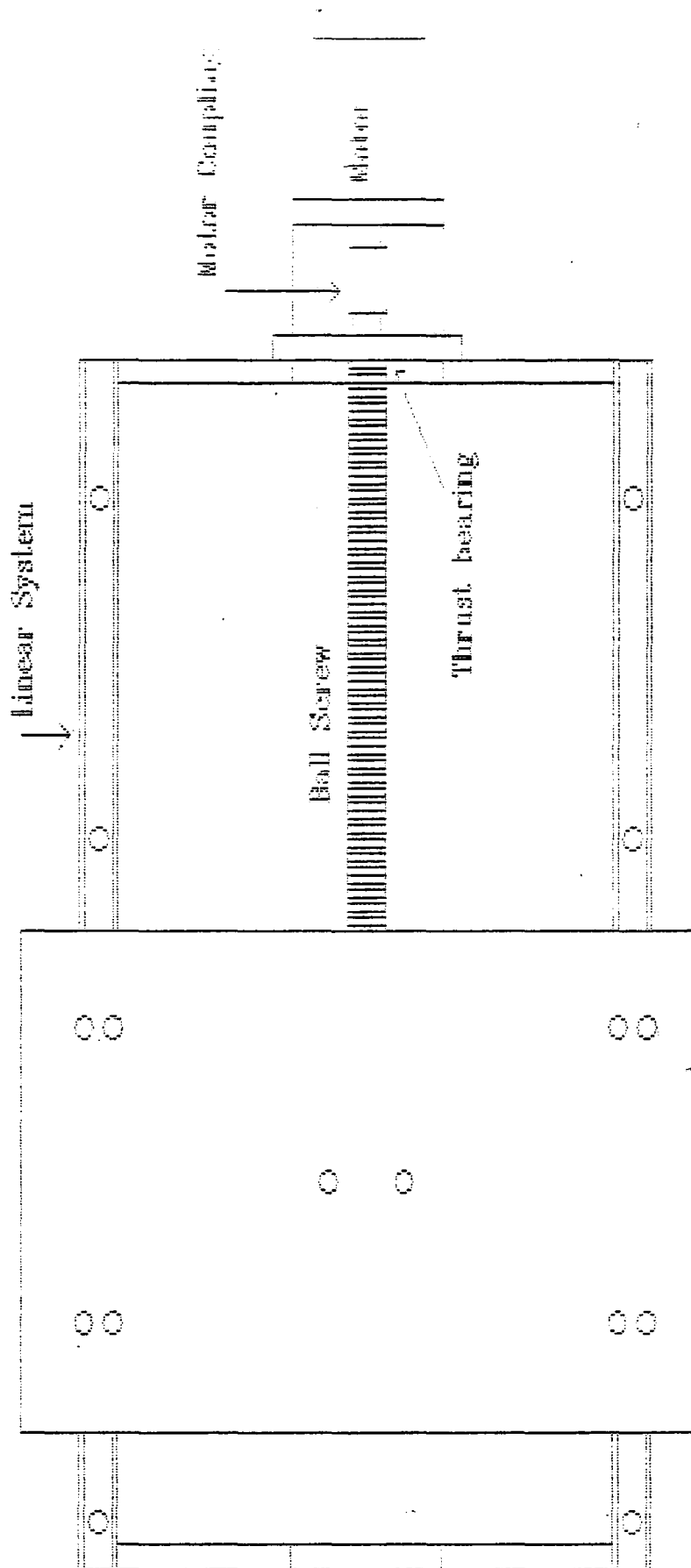
โครงสร้างและภาพถ่ายของระบบขับเคลื่อนแกน Z แสดงดังรูปที่ 3.5 และ 3.6

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการกัดปรีนัท

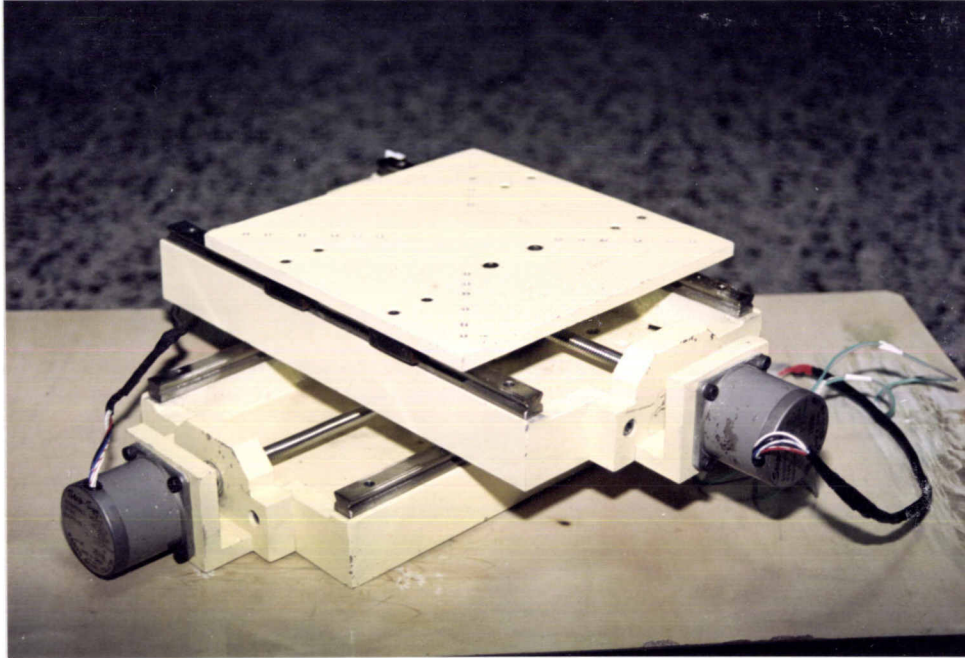
ในการกัดเจาะแผ่นปรีนัทนั้นจะต้องใช้หัวกัดที่มีขนาดเล็กและมีความคมมาก อีกทั้งตัวมอเตอร์ที่ใช้ในการหมุนหัวกัด ในโครงการพิเศษนี้ใช้เป็นดีซีมอเตอร์ขนาด 24 โวลต์ มีความเร็วรอบประมาณ 3700 rpm ซึ่งความเร็วรอบของมอเตอร์นี้มีความสำคัญมากสำหรับความคมของเส้นที่ต้องการจะกัด (โดยความเร็วรอบนี้มาจากแค็ตตาล็อกของบริษัท OSG) ดังนั้นหัวกัดปรีนัทนี้จำเป็นต้องใช้หัวกัดที่เรียกว่า endmill ของบริษัท OSG (รายละเอียดดูในภาคผนวก)



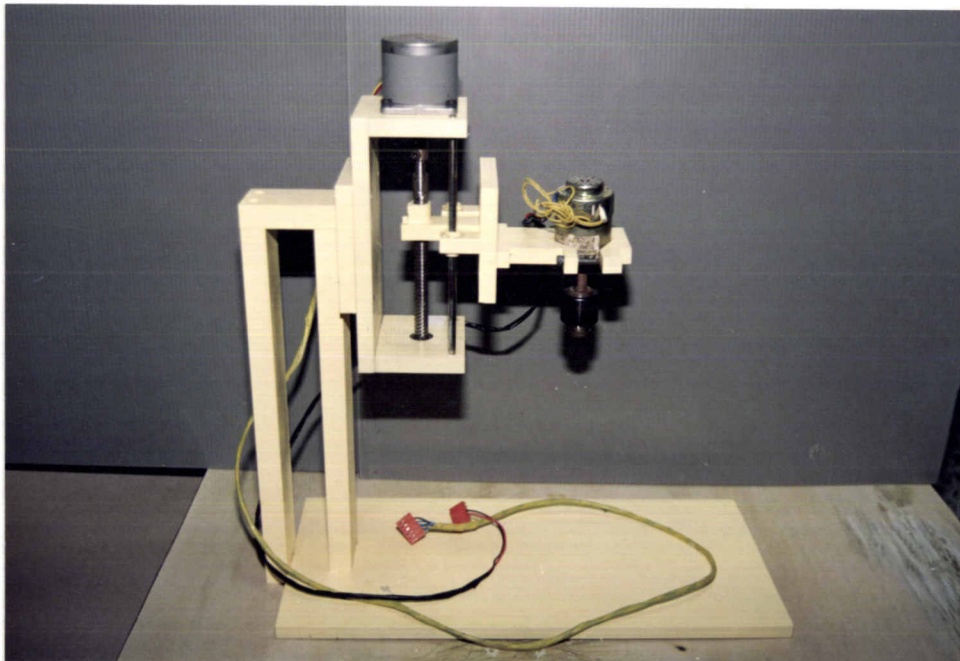
รูปที่ 3.2 ภาพเขียนของระบบขับเคลื่อนทางแกน X



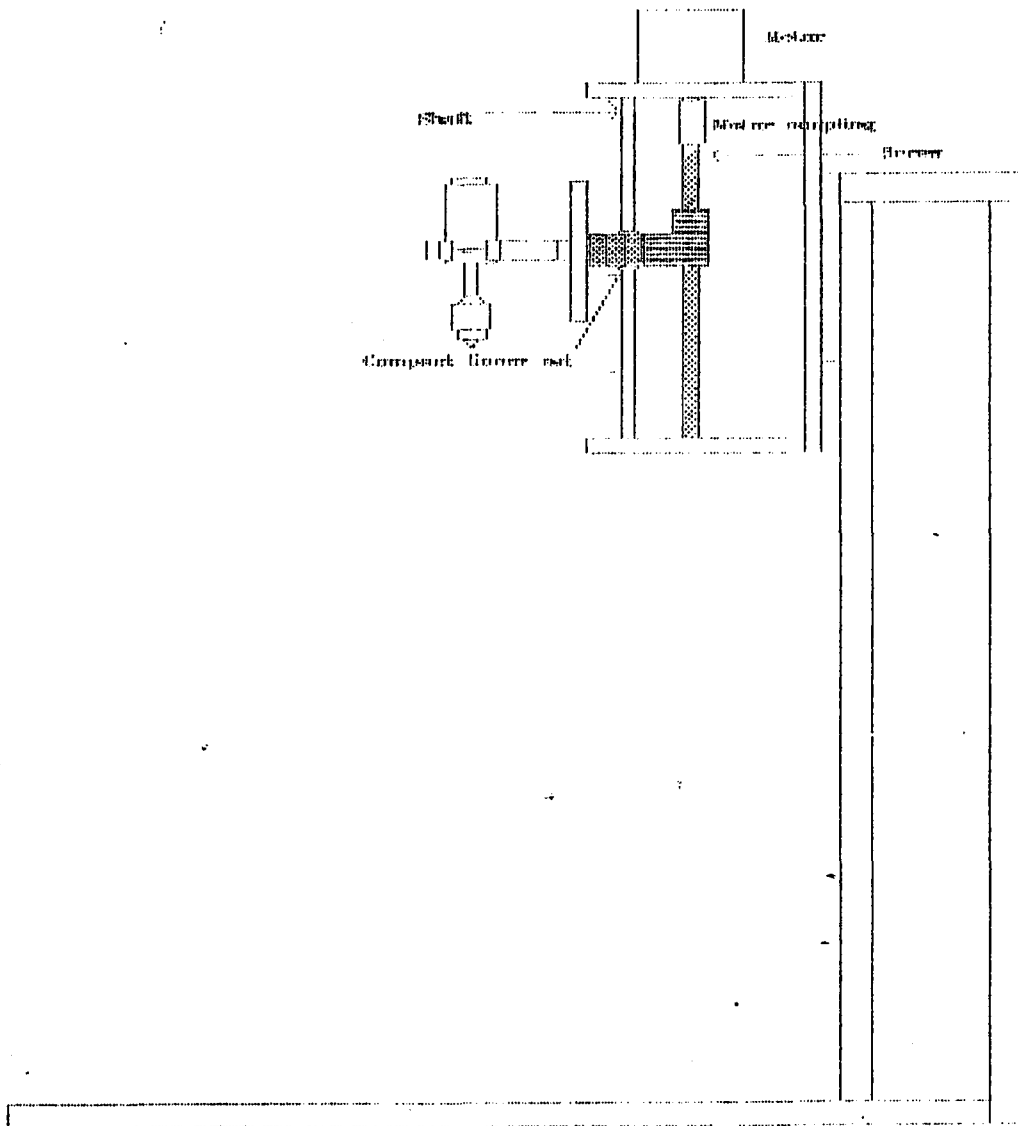
รูปที่ 3.3 ภาพเขียนของระบบขับเคลื่อนทางแกน Y



รูปที่ 3.4 ภาพถ่ายระบบขับเคลื่อน XY



รูปที่ 3.5 ภาพถ่ายระบบขับเคลื่อนทางแกน Z



รูปที่ 3.6 ภาพวาดของระบบขับเคลื่อนแกน Z

3.3 หลักการทำงานของระบบขับเคลื่อน

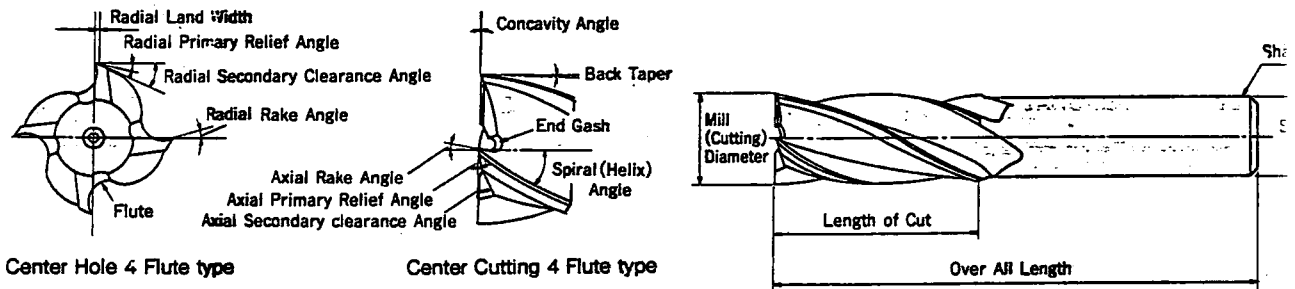
ระบบขับเคลื่อนที่จัดทำขึ้นนั้นจัดแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็นสองส่วนคือ

3.3.1 ทางแกน XY

หน้าที่ของระบบขับเคลื่อนในทางแกน XY นั้นมีหน้าที่เพื่อทำการเคลื่อนชิ้นงานไปในแนวแกน X และแกน Y ตามคำสั่งของโปรแกรมที่จัดทำขึ้น

3.3.2 ทางแกน Z

ทางแกน Z นี้ทำหน้าที่เพียงยึดตัวมอเตอร์ที่ใช้หมุนหัว endmill และใช้เป็นตัวเลื่อนหัว endmill ขึ้นลง ลักษณะของหัว endmill แสดงดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 ภาพแสดงลักษณะของหัว endmill

บทที่ 4

การออกแบบและสร้างส่วนควบคุมพร้อมระบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

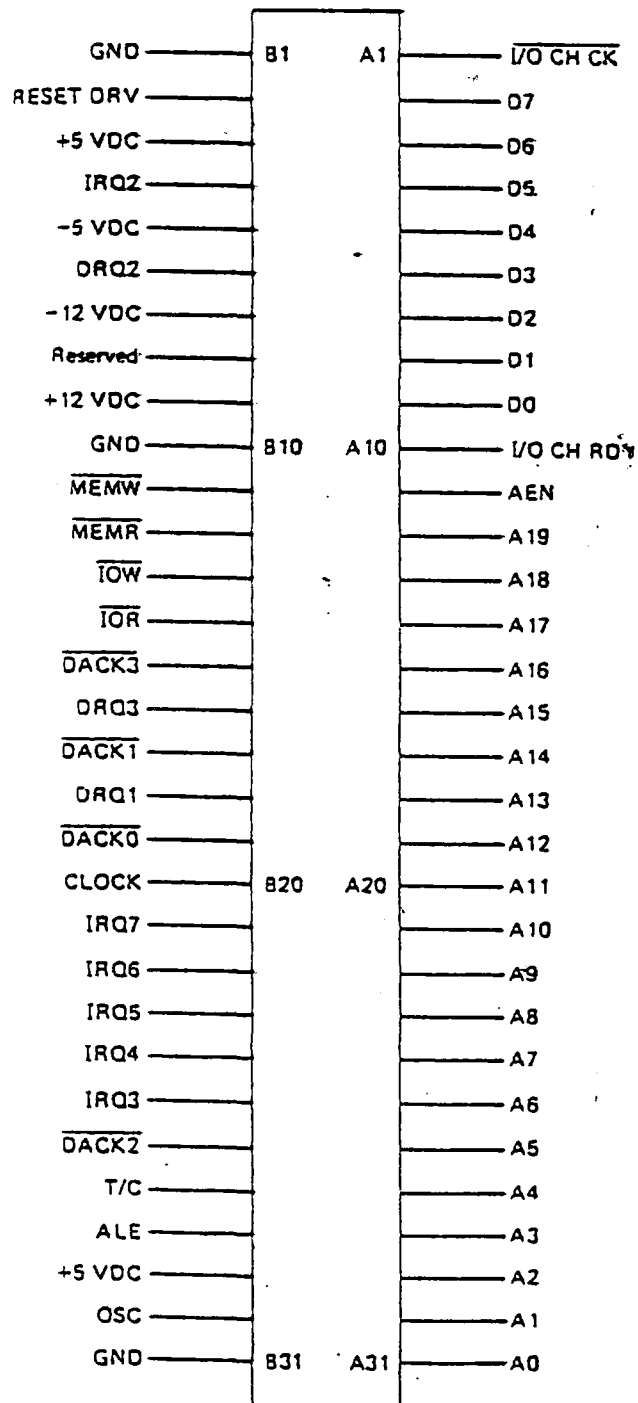
4.1 การเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์

IBM PC ได้มีการออกแบบให้สามารถที่จะเพิ่มเติมวงจรรีเลย์เฟส(interface circuit) เข้าไปในภายหลังได้ โดยผ่านทางสล๊อตที่อยู่บนเมนบอร์ดซึ่งมีจำนวน 8 สล๊อต แต่ละสล๊อตจะมีจำนวนขาทั้งสิ้น 62 ขา แบ่งออกเป็นสองด้าน ด้านละ 31 ขา แต่ละขาของสล๊อตเหล่านี้จะต่อเชื่อมขาสัญญาณต่างๆบนเมนบอร์ด ทำให้การสร้างวงจรรีเลย์เฟสกับ IBM PC สามารถทำได้สะดวก ซึ่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับขาของสล๊อตเหล่านี้จะประกอบไปด้วย สัญญาณของบัสแอดเดรส (Address Bus), บัสข้อมูล (Data Bus), บัสควบคุม สำหรับการอ่าน/เขียนข้อมูลจากหน่วยความจำ หรือ พอร์ต I/O , สัญญาณสำหรับการขออินเทอร์รัพท์ของวงจรรีเลย์เฟส , เส้นสัญญาณสำหรับการขอ DMA , สัญญาณฐานเวลา (Timing Signal) ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ, เส้นสัญญาณแสดงการขอรีเฟรชหน่วยความจำ และสัญญาณสำหรับตรวจสอบความผิดพลาด (I/O CHECK)

นอกจากเส้นสัญญาณเหล่านี้แล้ว สล๊อตบนเมนบอร์ดยังเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟต่างๆที่ใช้ในระบบด้วยคือ +5Vdc, -5Vdc, +12Vdc และ -12Vdc สัญญาณทั้งหมดบนสล๊อตจัดเรียงตำแหน่งตามรูปที่ 4.1

4.1.1 การแบ่งแอดเดรสของ IBM/PC

ใน IBM/PC มีการจัดสรรการจัดแอดเดรสต่าง ๆ ไว้แน่นอนซึ่งได้แสดงไว้ดังตารางที่ 4.1 ส่วนที่จะนำมาใช้ในการ decode address นั้นจะอยู่ในส่วนของ Prototype Card ซึ่งมีแอดเดรสอยู่ในช่วง 300-31F ทั้งหมด 32 พอร์ตแอดเดรส



รูปที่ 4.1 ระบบบัสของ IBM PC

ตารางที่ 4.1 การแบ่งแอดเดรสของ IBM/PC

Hex range	Usage	
000-00F	DMA chip 8237A-5	
020-021	Interrupt 8259A	
040-043	Timer 8253-5	Assigned to
060-063	PPI 8255A-5	system board
080-083	DMA page registers	components
0Ax	NMI mask register	
OCx	Reserved	
OEx	Reserved	
100-1FF	Not usable	
200-20F	Game control	
210-217	Expansion unit	
220-24F	Reserved	
278-27F	Reserved	
2F0-2F7	Reserved	Assigned to
2F8-2FF	Asynchronous communication(2)	feature card
300-31F	Phototype card	ports
320-32F	Fixed disk	
378-37F	Printer	
380-38C	SDLC communication	
380-389	Binary synchronous communication(2)	
3A0-3A9	Binary synchronous communication(1)	
380-38F	IBM monochrome display printer	
3C0-3CF	Reserved	

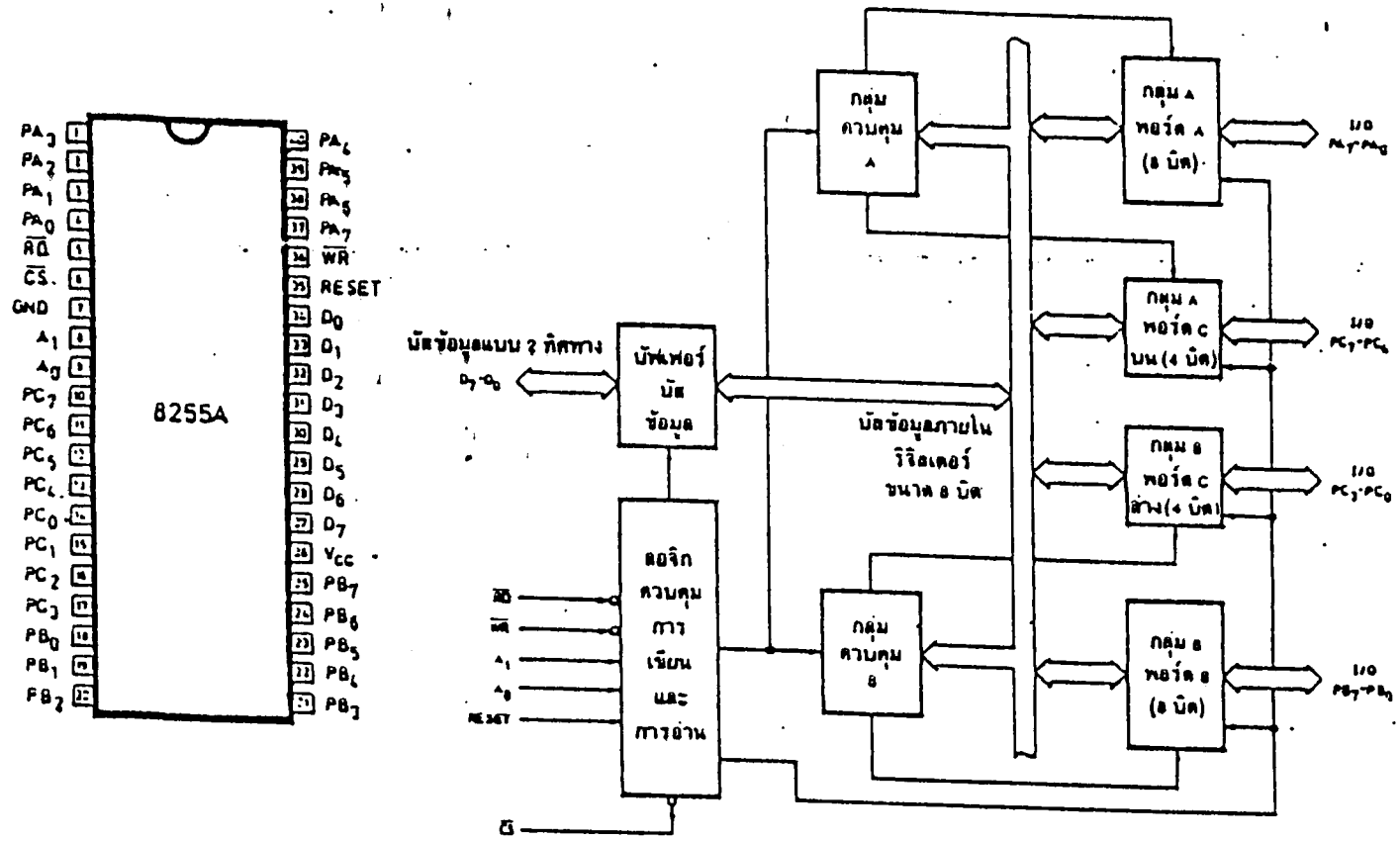
ตารางที่ 4.1 การแบ่งแอดเดรสของ IBM/PC (ต่อ)

Hex range	Usage
3D0-3DF	Colour/graphics
3E0-3E7	Reserved
3F0-3F7	Diskette
3F8-3FF	Asynchronous communications(1)

เมื่อทราบรายละเอียดภายในของ IBM/PC แล้วว่ามีสล็อตอะไรบ้าง และมีการจัดแบ่งแอดเดรสไว้อย่างไร ดังนั้นก็จะนำไปสู่การเชื่อมต่อ IBM/PC กับ 8255 ดังนี้

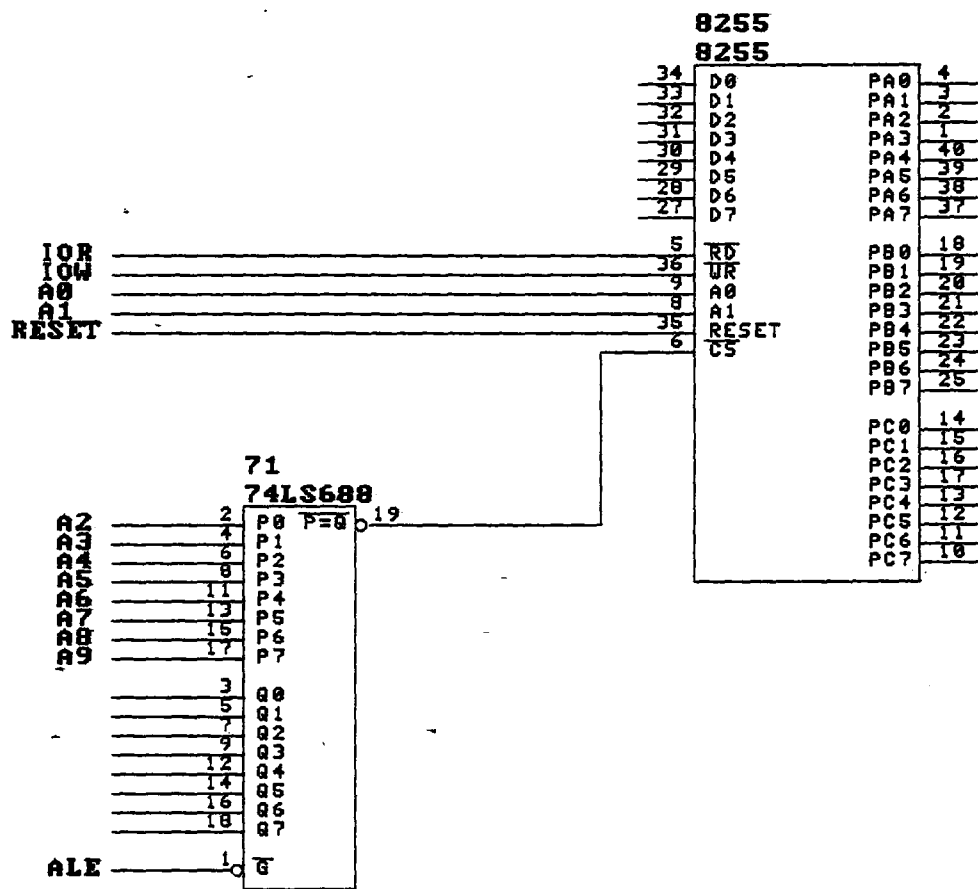
4.1.2 การ decode address

ในโครงงานนี้จะทำการ decode แอดเดรสที่ 300 นำมาใช้ในการเชื่อมต่อ กับ 8255 PPI ซึ่งแอดเดรสเหล่านี้อยู่ในส่วนของ prototype card หลังจากที่ได้วางจรรยาบรรณแล้วจึงนำวงจร decode นี้มาเชื่อมต่อกับ 8255 แต่ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกับ 8255 นี้จะต้องรู้จักโครงสร้างของมันคร่าวๆดังนี้คือ 8255 เป็นไอซีที่มี 40 ขา ได้รับการออกแบบให้มีสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อกับ 8088 ซึ่งตัว 8255 เองนั้นเป็นไอซีที่ต่อเป็นพอร์ตให้ไมโครโปรเซสเซอร์ได้ 3 พอร์ต คือ PORT A, PORT B และ PORT C สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วนคือ พอร์ต c ล่างและ พอร์ต c บน ที่พิเศษคือ พอร์ตทุกพอร์ตเป็นไปได้อินพุตและเอาต์พุต แผนผังโครงสร้างของไอซี 8255 แสดงดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 แผนผังโครงสร้างของไอซี 8255

เมื่อทราบลักษณะโครงสร้างภายในแล้วจึงนำเอาวงจร decode มาเชื่อมต่อกันเข้ากับ 8255 ดังแสดงวงจรดังรูปที่ 4.3



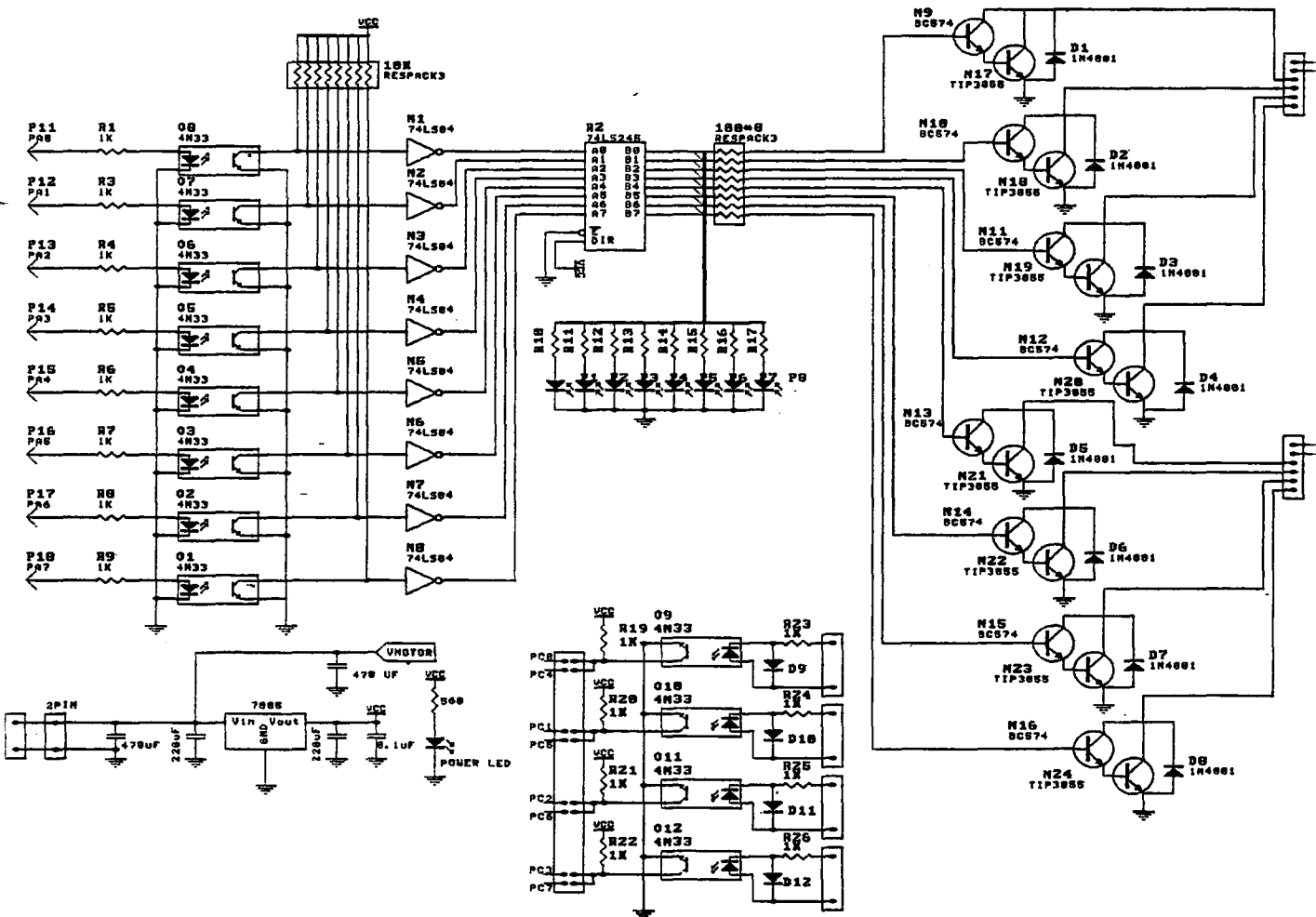
รูปที่ 4.3 การต่อ 8255 กับวงจร decode

ซึ่งวงจรดังกล่าวจะมีการใช้เรจิสเตอร์ของ 8255 ดังนี้

	A11.....	A0		
พอร์ท A	300H	0011	0000	0000
พอร์ท B	301H	0011	0000	0001
พอร์ท C	302H	0011	0000	0010
คอนโทรลพอร์ท	303H	0011	0000	0011

4.2 ชุดขับสแต็ปมิ่งมอเตอร์ (STEPPING MOTOR DRIVER)

4.2.1 ET-SMCC STEPPING MOTOR DRIVER CONTROL วงจรแสดงดังรูป 4.4

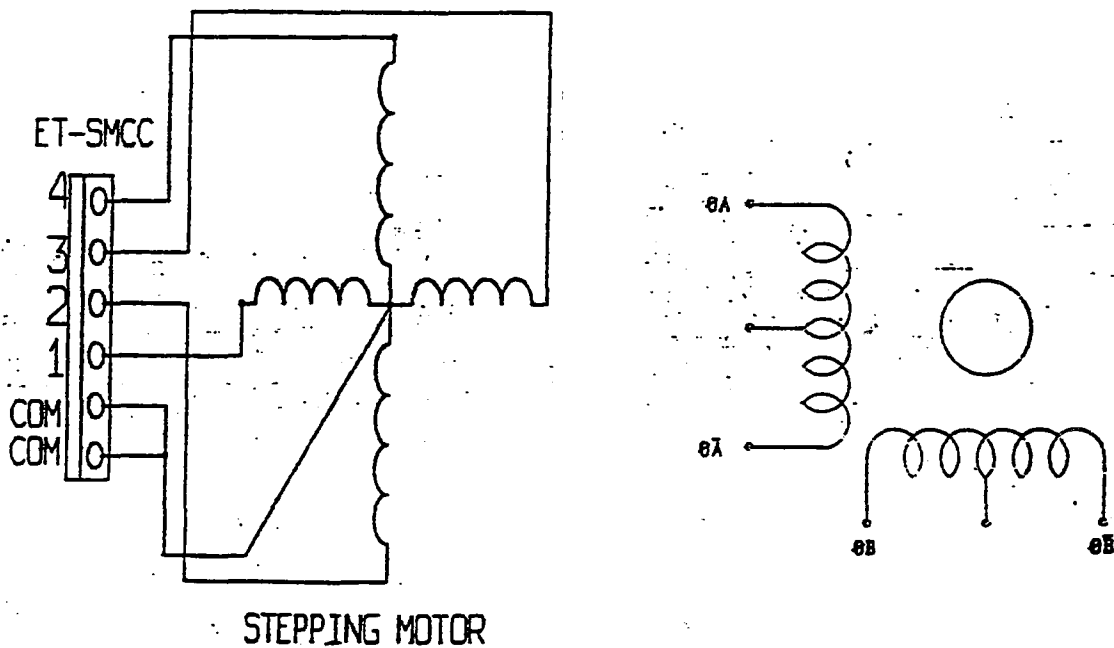


รูปที่ 4.4 แสดงวงจรของ ET-SMCC

ET-SMCC จะเป็นการ์ดต่อเข้ากับพอร์ตของ 8255 หรือพอร์ตอื่นๆด้วยก็ได้โดยใช้ในการต่อควบคุมการทำงานของสเต็ปปีงมอเตอร์ โดยจะสามารถต่อกับสเต็ปปีงมอเตอร์ได้ 2 ตัวต่อหนึ่งพอร์ต หรือจะต่อพ่วงอีกหนึ่งการ์ด เพื่อใช้กับสเต็ปปีงมอเตอร์ 4 ตัวต่อพอร์ต 8255 จำนวนหนึ่งตัวก็ได้ นอกจากนี้ ET-SMCC จะมีอินพุต ในรูปลักษณะของออปโตอีก 4 อินพุต สามารถต่อกับสวิทต่างๆได้อีกด้วย เช่นต่อกับไมโครสวิทตรวจการหมุนของสเต็ปปีงมอเตอร์ว่าถึงจุดที่ต้องการแล้วหรือยัง เป็นต้น

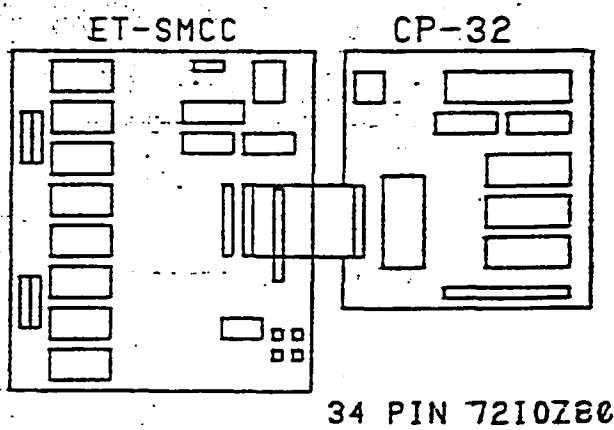
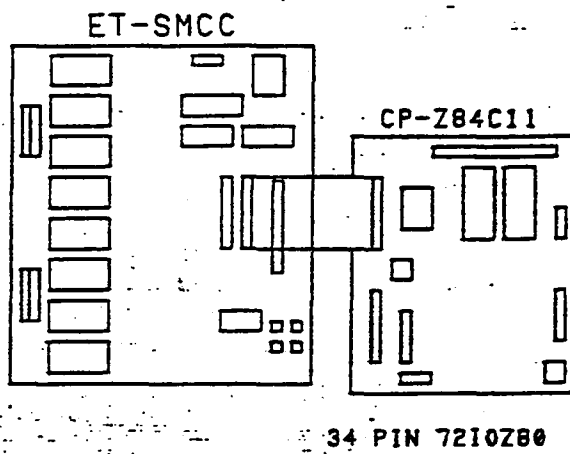
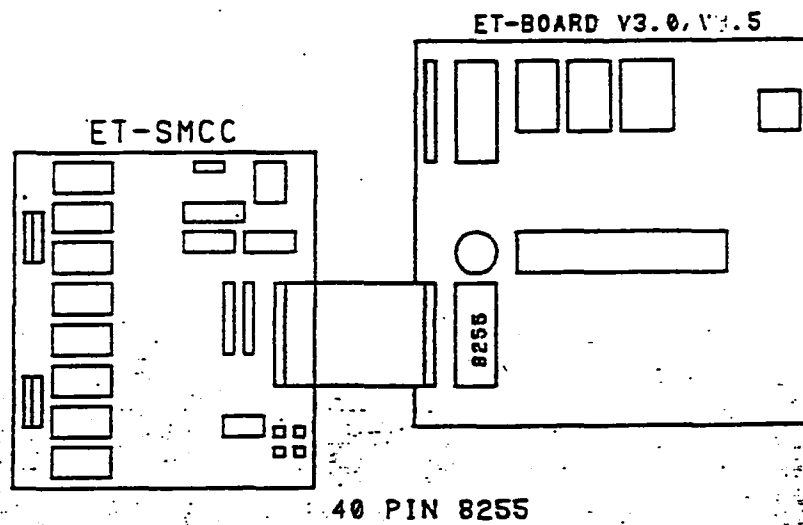
การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของ ETT

1. สามารถต่อกับสเต็ปปีงมอเตอร์ ตามรูปแบบขดของสเต็ปปีงนั้นได้ดังรูปที่ 4.5 โดยต่อมอเตอร์ได้ 2 ชุด



รูปที่ 4.4 การต่อสเต็ปปีงมอเตอร์กับ ET-SMCC

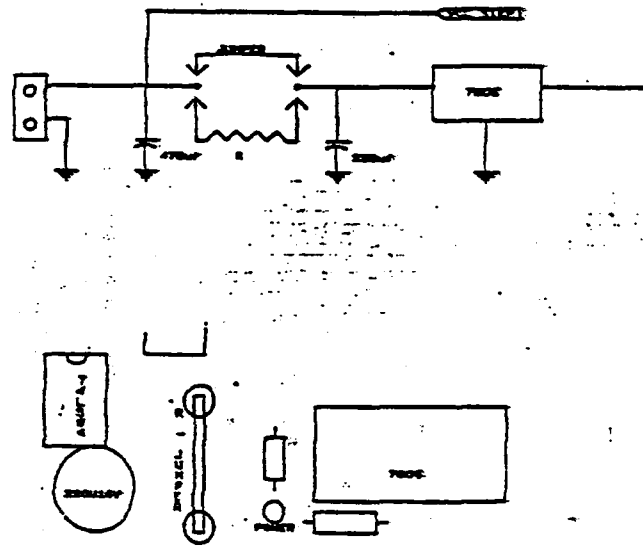
2. ต่อร่วมกับการ์ดต่างๆของบริษัท ETT ทาง connector 72IOZ80(32 พ) หรือ
ต่อกับ 8255 ดังรูป 4.5



-3-

รูปที่ 4.5 การต่อ ET-SMCC กับการ์ด 8255

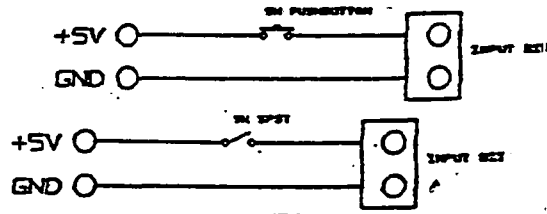
3. การต่อแหล่งจ่ายไฟ กับ ET-SMCC และ สเต็ปป์มอเตอร์จากการ์ด ET-SMCC นั้นจะมีส่วนจ่าย Power ให้กับอุปกรณ์บนบอร์ดจาก Power Supply ชุดเดียวกันกับที่จ่ายให้ สเต็ปป์มอเตอร์โดยจะต้องใช้ 7805 ปรับไฟจาก +12 โวลต์ หรือ +24 โวลต์ ตามลำดับไฟที่ป้อนให้สเต็ปป์มอเตอร์ โดยอาจจะต้องใช้ตัวความต้านทานต่อแทนสาย JUMP ถ้าในกรณีต่อกับสเต็ปป์มอเตอร์ที่ต้องการไฟมากกว่า 12 โวลต์โดยควรต่อตัวความต้านทานแทนสาย JUMP (ในกรณีที่ใช้ 24 โวลต์ ให้ต่อตัวความต้านทาน 50 โอห์ม 5 วัตต์) ดังแสดงตามรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 การต่อ Power Supply กับ ET-SMCC

โดยวงจรภายใน ET-SMCC (ไม่รวมสเต็ปป์มอเตอร์) ใช้กระแสไฟสูงสุด 250 mA

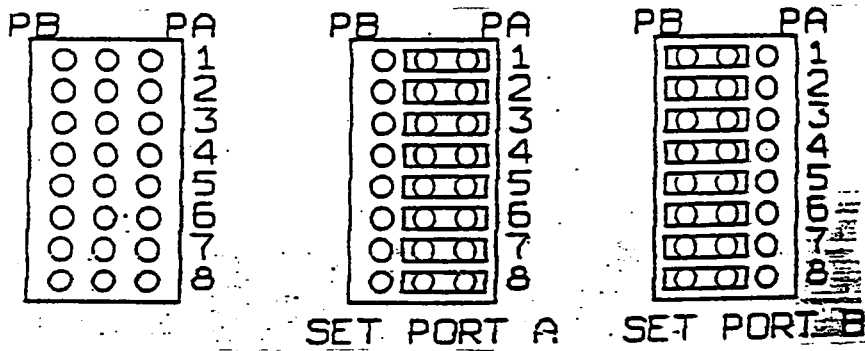
4. ถ้ามีอินพุตจะต้องต่อร่วมกับบอร์ด ET-SMCC โดยต่อกับอินพุตบอร์ดที่มีลักษณะเป็นลอบโตดังรูปที่ 4.7 โดยใช้ Power Supply +5 โวลต์ และถ้าต้องการใช้เป็นอินพุต 24 โวลต์ก็ให้เปลี่ยนเป็นความต้านทาน 1K ในส่วนของอินพุตเป็นความต้านทานค่า 3.3 K



รูปที่ 4.7 การใช้งานพอร์ตอินพุทของบอร์ด ET-SMCC

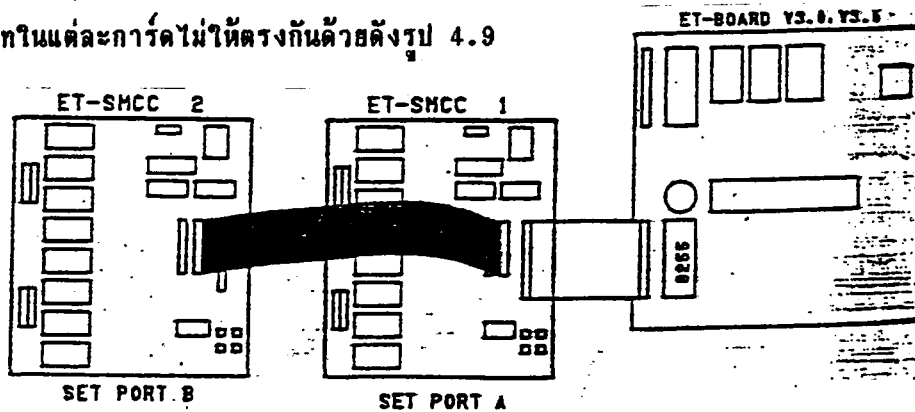
การ decode พอร์ต

บอร์ด ET-SMCC จะมี JUMPER อยู่ 2 ชุด โดยชุดแรกจะเป็นการเลือกว่าสแต็ปโป่งมอเตอร์จะใช้พอร์ตใดในการควบคุมคือจะใช้พอร์ต A หรือพอร์ต B ก็ได้ดังรูป 4.8



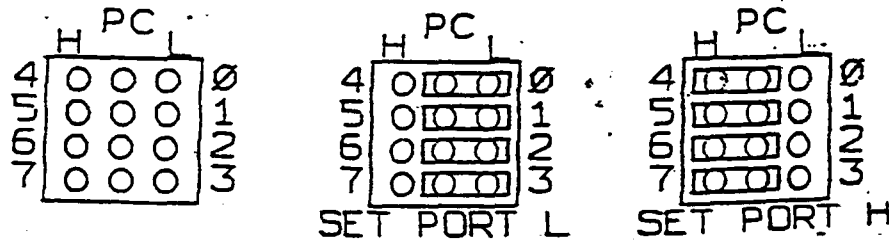
รูปที่ 4.8 การขีดจตำแหน่งของ JUMPER เพื่อเลือกพอร์ตใช้งาน

จากลักษณะนี้สามารถเลือกพอร์ต A หรือ B ได้ทำให้ ET-SMCC สามารถต่อพ่วง ET-SMCC อีกชุดหนึ่งได้จากขั้ว 34 ขา (72IOZ80) ได้อีกโดยต้องขีดการใช้พอร์ตในแต่ละพอร์ตในแต่ละการ์ดไม่ให้ตรงกันด้วยดังรูป 4.9



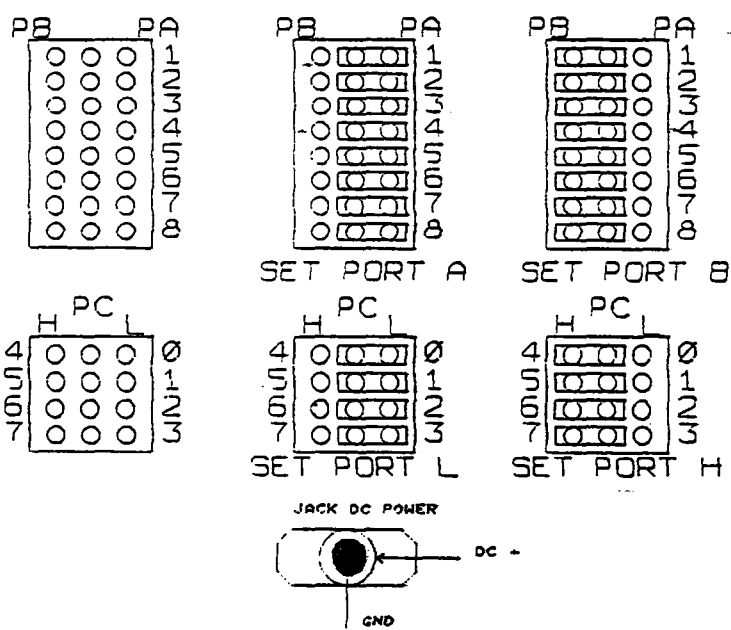
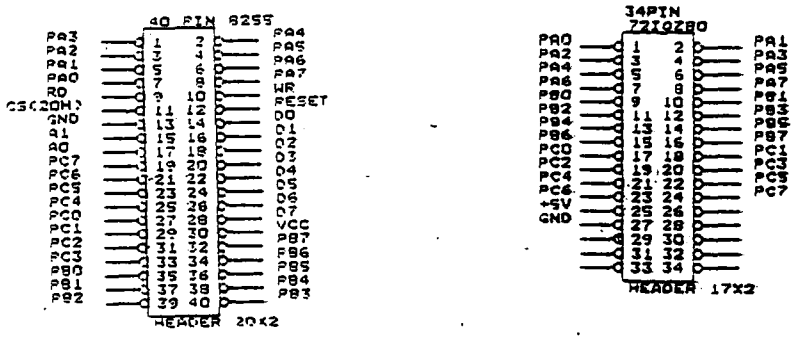
รูปที่ 4.9 การต่อบอร์ด ET-SMCC เพื่อใช้งานร่วมกัน

ชุดที่ 2 จะเป็นส่วนของอินพุทพอร์ต โดยสามารถเลือกที่จะรับอินพุทจากพอร์ต C ด้วย 4 บิตสูง หรือ 4 บิตต่ำ ดังรูป 4.10



รูปที่ 4.10 การเลือกตำแหน่งของพอร์ตอินพุท

การจัดวางตำแหน่งของ connector ที่ต่อกับ ET-SMCC แสดงดังรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 รายละเอียดของ connector ของ ET-SMCC

การควบคุมและใช้งานสแต็ปมอเตอร์
สามารถสั่งงานให้สแต็ปมอเตอร์หมุนได้ 3 แบบ ตามกระแสไฟที่ป้อนแก่เฟสต่างๆ
ดังนี้

1. แบบจ่ายกระแสไฟให้เฟสเดียววนเวียนกันไป หรือ ONE EXCITATION หรือแบบ HALF
DRIVE คือเอาท์พุทจะเป็น 0001, 0010, 0100, 1000

ตารางที่ 4.2 แสดงการขับแบบ Half step

	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0
4	1	0	0	0

การ EXCITATION แบบนี้แรงบิดจะน้อย

2. แบบจ่ายกระแสไฟที่เดียว 2 เฟส หรือ TWO-EXCITATION หรือ FULL STEP คือ 00
11, 0110, 1100, 1001 หมุนเวียนกันไปแบบนี้แรงบิดจะมาก

ตารางที่ 4.3 แสดงการขับแบบ Full step

	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1
1	0	0	1	1
2	0	1	1	0
3	1	1	0	0
4	1	0	0	1

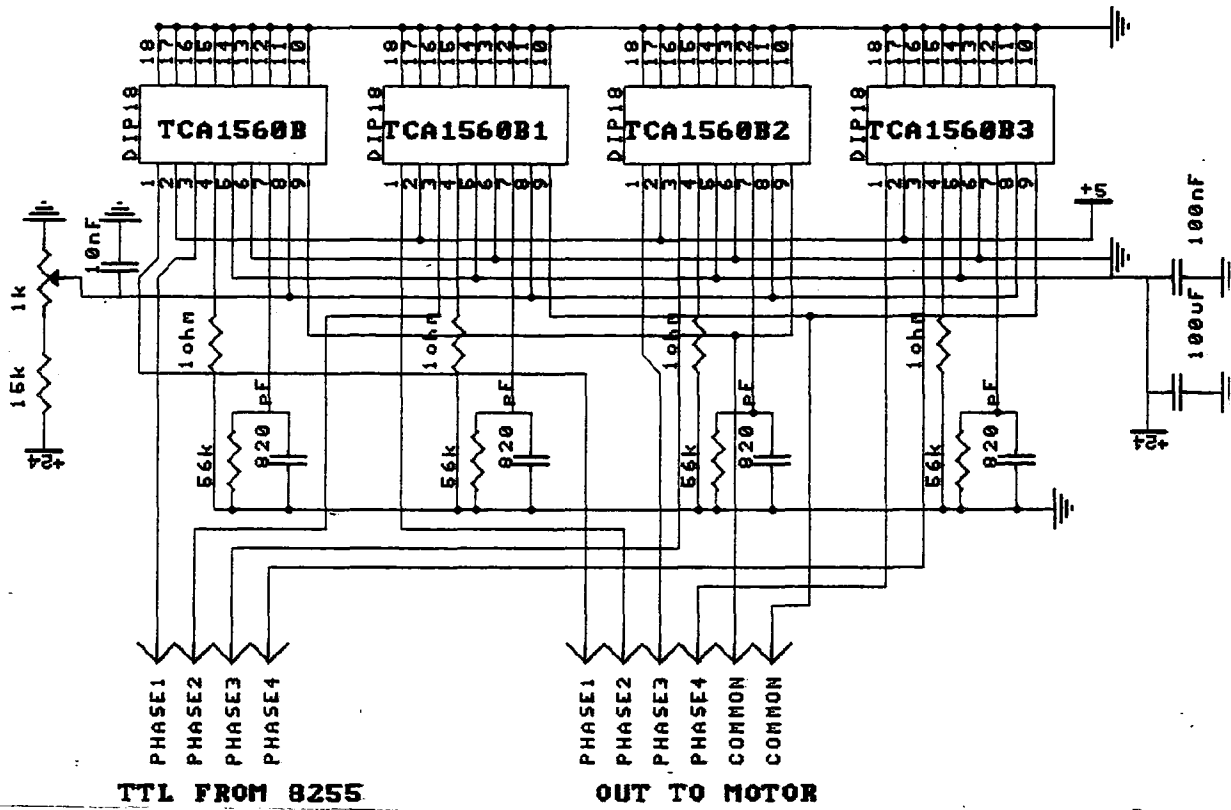
3.แบบจ่ายกระแสไฟ 1 เฟสสลับกับ 2 เฟสเรียกว่า แบบONE-TWO EXCITATION
 นี้จำนวนสแต็ปจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของสองแบบแรกแต่แรงบิดเฉลี่ยจะน้อย การหมุนจะเป็น
 0001,0011,0010,0110,0100,1100,1000,1001

ตารางที่ 4.4 แสดงการขับแบบ One-two motor driver

	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1
1	0	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	0	1	0
4	0	1	1	0
5	0	1	0	0
6	1	1	0	0
7	1	0	0	0
8	1	0	0	1

4.2.2 ใช้ IC TCA1560B เป็นชุดขับสแต็ปมอเตอร์

TCA1560B เป็นไอซีที่ใช้กับสแต็ปมอเตอร์ของบริษัท Siemen การใช้งานในโครงงานนี้แสดงตามวงจรในรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 วงจรของชุดขับสแต็ปมอเตอร์โดยใช้ TCA1560B

4.3 ภาคจ่ายกำลัง (POWER SUPPLY)

เนื่องจากการทำงานของสแต็ปมอเตอร์จะกำหนดกระแสที่สแต็ปมอเตอร์แต่ละตัวนั้นๆต้องการ ดังนั้นการทำภาคจ่ายกำลัง (POWER SUPPLY) จะต้องทำให้เพียงพอแก่ความต้องการของสแต็ปมอเตอร์ ในโครงงานนี้ใช้สแต็ปมอเตอร์ที่กินกระแส 0.22 แอมป์/เฟส ทั้งหมด 3 ตัว จึงกินกระแสประมาณ 3 แอมป์ จึงได้ทำการออกแบบภาคจ่ายกำลัง (POWER SUPPLY) ที่จ่ายประมาณ 3 แอมป์ ถึงจะเพียงพอแก่ความต้องการของสแต็ปมอเตอร์ ดังรูปที่ 4.13

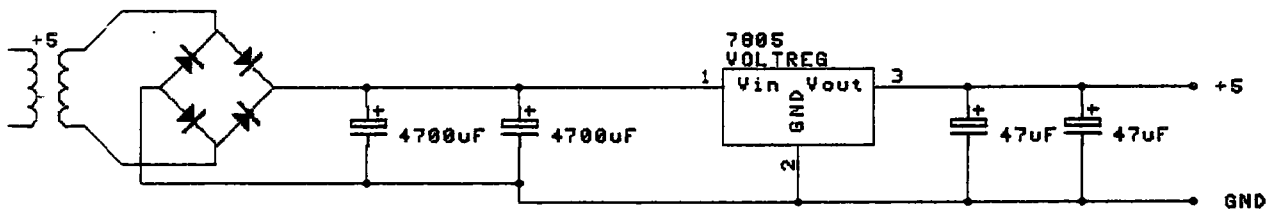
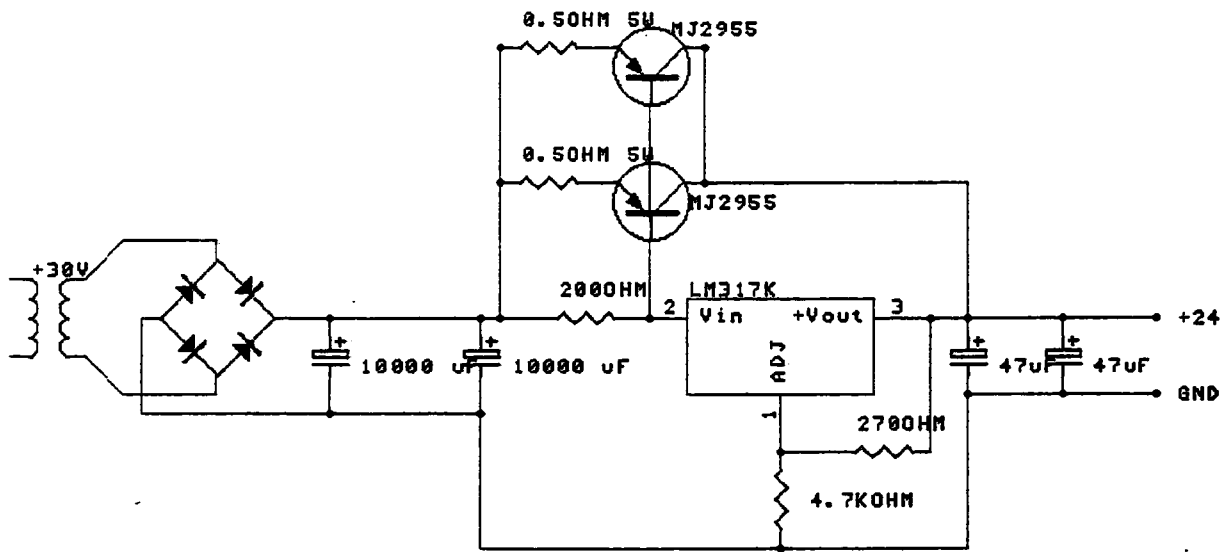


FIG 4.13 7805 POWER SUPPLY

บทที่ 5

ชุดโปรแกรมควบคุม

5.1 การทำงานของโปรแกรม

โปรแกรมที่ใช้ในโครงการนี้เขียนโคสให้ภาษาปาสคาล ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้งานง่าย และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ภาพโดยรวมของโปรแกรมจะทำงานตาม flowchart รูปที่ 5.1 ขนาดของลาฮวงจรที่สามารถนำมาใช้กับเครื่องต้องมีขนาดไม่เกิน 6.4" X 4.8" การทำงานในส่วนที่สำคัญสามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

- การ load file
- การวาดภาพของลาฮวงจร
- การหาขอบของภาพลาฮวงจร
- การควบคุมแท่นเพื่อทำแผ่น PCB

การ load file

เป็นส่วนการอ่านไฟล์ที่เป็นลาฮวงจรที่ผู้ใช้ออกแบบไว้บนโปรแกรมโปรเทล ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในส่วนนี้เป็นตาม flowchart รูปที่ 5.2 การทำงานโดยรวมของโปรแกรมในส่วนนี้ คือ การอ่านข้อมูลจากไฟล์ที่ต้องการ และจัดการกับข้อมูลที่อ่านเข้า เพื่อแยกข้อมูล ออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วนข้อมูลที่เป็นการลากเส้น การวางขาอุปกรณ์ เพื่อเป็นการใช้หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ให้ประสิทธิภาพสูงสุดการเก็บข้อมูลต่างที่อ่านเข้ามาจากไฟล์จึงใช้การนำข้อมูลมาจัดเก็บแบบ Links List

การวาดภาพของลาฮวงจร

เป็นส่วนการสร้างภาพของลาฮวงจรบนจอภาพจากข้อมูลที่อ่านเข้ามา ในการสร้างภาพของลาฮวงจรจะต้องเป็นภาพที่กลับจากซ้ายเป็นขวาจากภาพของวงจรที่ออกแบบบนโปรแกรมโปรเทลเพื่อให้ได้ตำแหน่งของขาอุปกรณ์ที่ถูกต้อง การสร้างภาพที่ใช้ในโปรเกรมนี้อาจสร้างเฉพาะส่วนที่สร้างจากคำสั่ง Place-Trace, Place-Via, Place-Fill, Place-Component จากโปรแกรมโปรเทล

การหาขอบของภาพลายวงจร

เป็นส่วนที่จัดการกับภาพของลายวงจรที่สร้างขึ้น เนื่องจากการทำงานในส่วนการทำแผ่น PCB ในโรงงานพิเศษนี้เป็นการตัดชิ้นของทองแดงที่เคลือบบนชิ้นงาน จึงต้องใช้วิธีหาขอบรอบเส้นของลายวงจร ส่วนของการหาขอบเนื่องจากภาพที่สร้างขึ้นเป็นภาพสีเดียวในการหาขอบจึงเลือกให้วิทีทดสอบสีกับจุดที่อยู่รอบ ๆ ว่าจุดนั้นเป็นขอบของลายวงจรหรือไม่ ขั้นตอนการทำงานในการขอบของลายวงจรแสดงดัง flowchart รูปที่ 5.3

การควบคุมแทนเพื่อทำแผ่น PCB

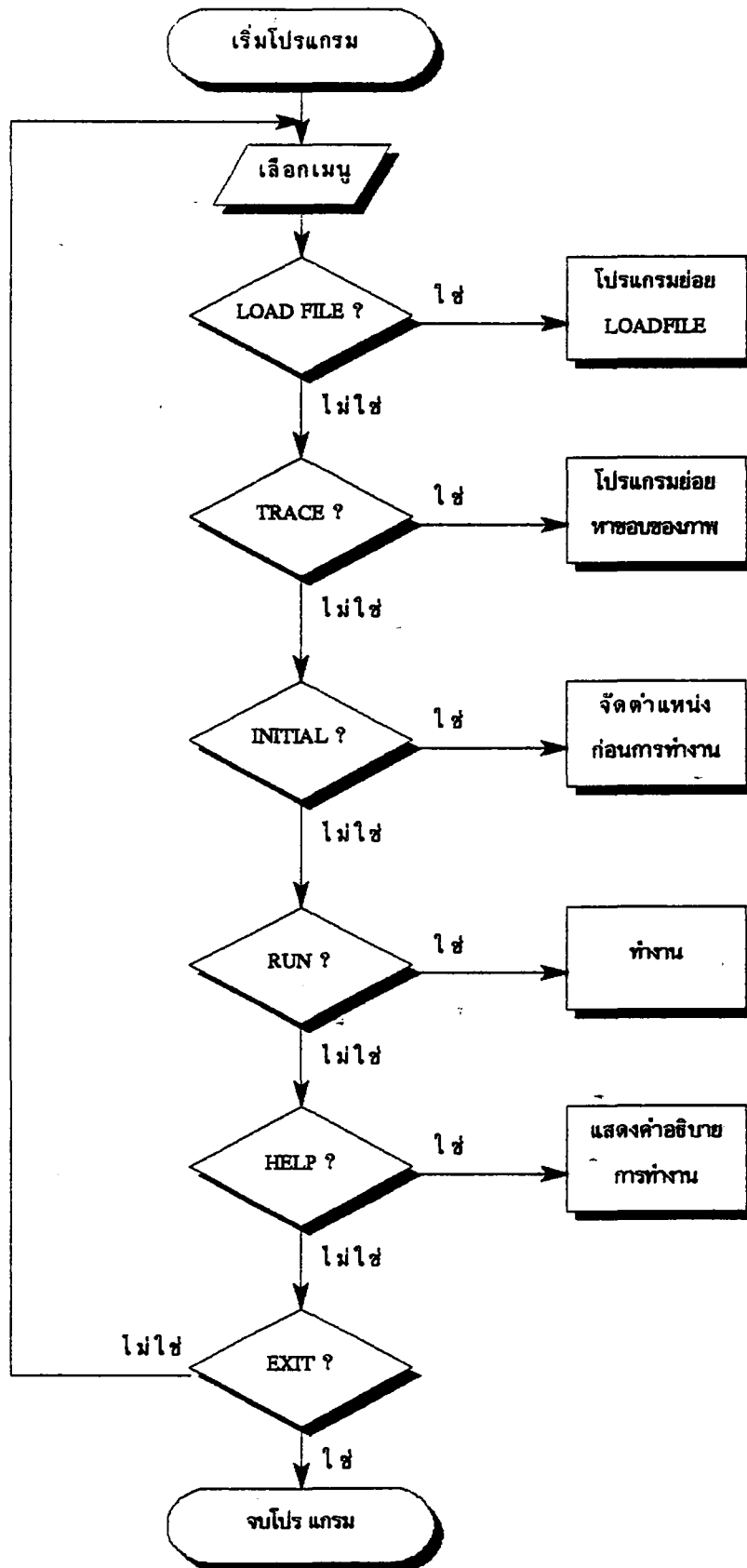
เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ทำแผ่น PCB จากภาพของลายวงจรที่ผ่านการหาขอบของภาพแล้วการทำงานของโปรแกรมในโรงงานนี้เพื่อสร้างเส้นตรงได้เท่านั้น คือ โปรแกรมจัดการกับภาพรูปทรงต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นเส้นตรงที่ยาวที่สุดต่อเนื่องกันจนเป็นรูปทรงต่าง ดังแสดงตาม flowchart รูปที่ 5.4

5.2 การใช้โปรแกรม

การใช้งานโปรแกรมสามารถทำได้โดยการสั่งงานทางเมนูดังรูปที่ 5.5 โดยมีตัวเลือกดังนี้

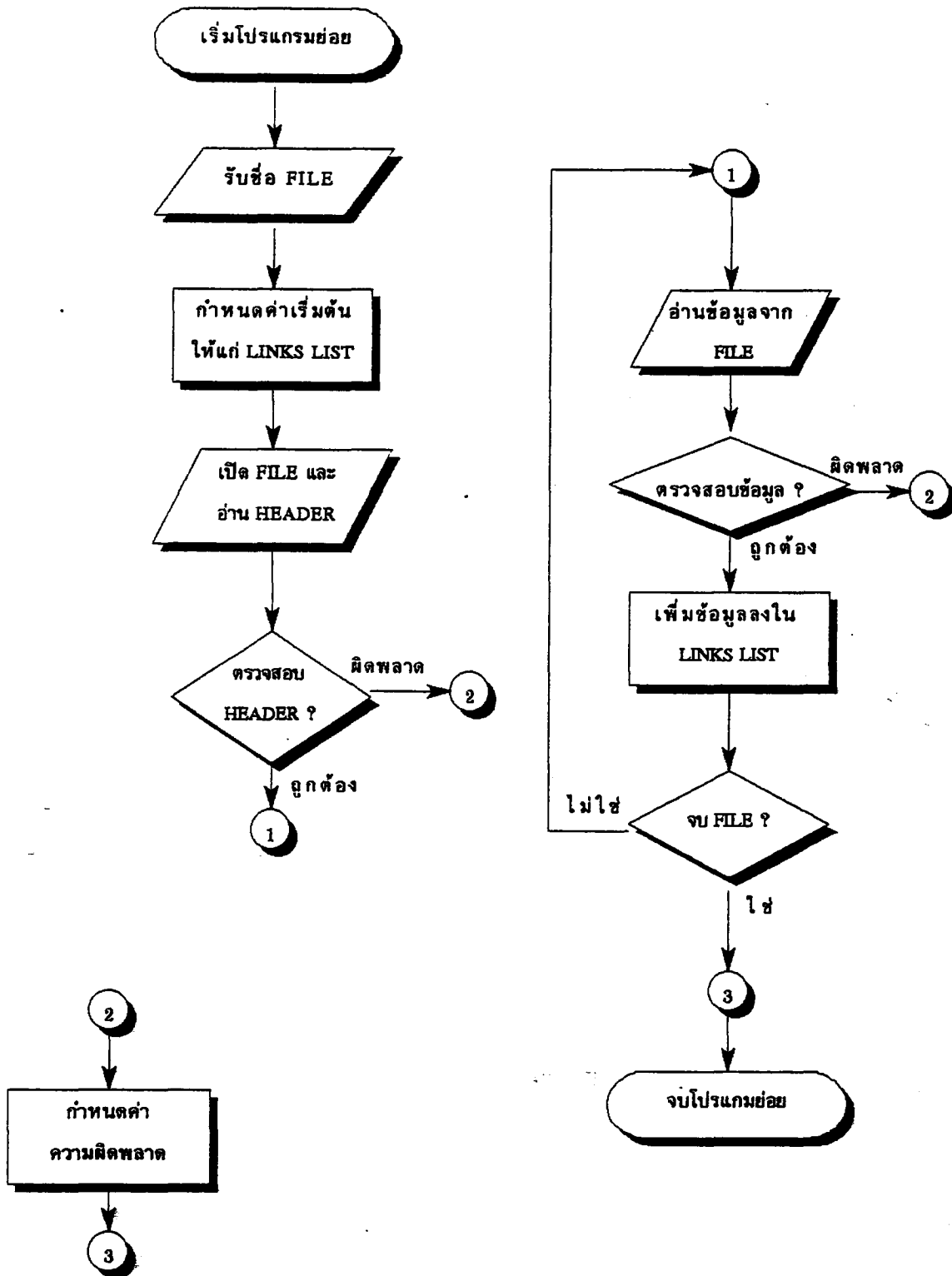
- ตัวเลือก File
- ตัวเลือก Trace
- ตัวเลือก Initial
- ตัวเลือก Run
- ตัวเลือก Dimension
- ตัวเลือก Help
- ตัวเลือก Exit

MAIN PROGRAM



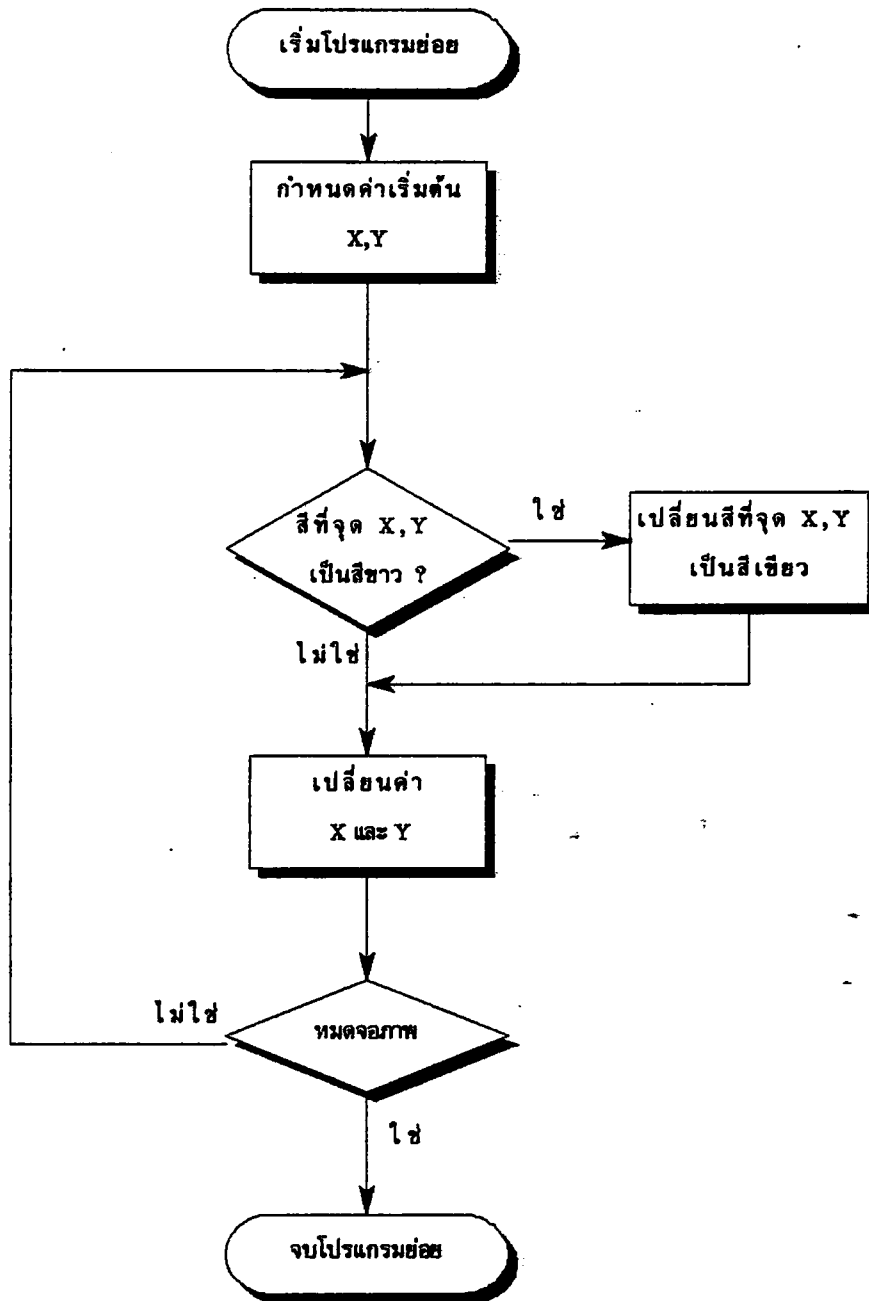
รูปที่ 5.1 Flowchart ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

โปรแกรมย่อย LOADFILE



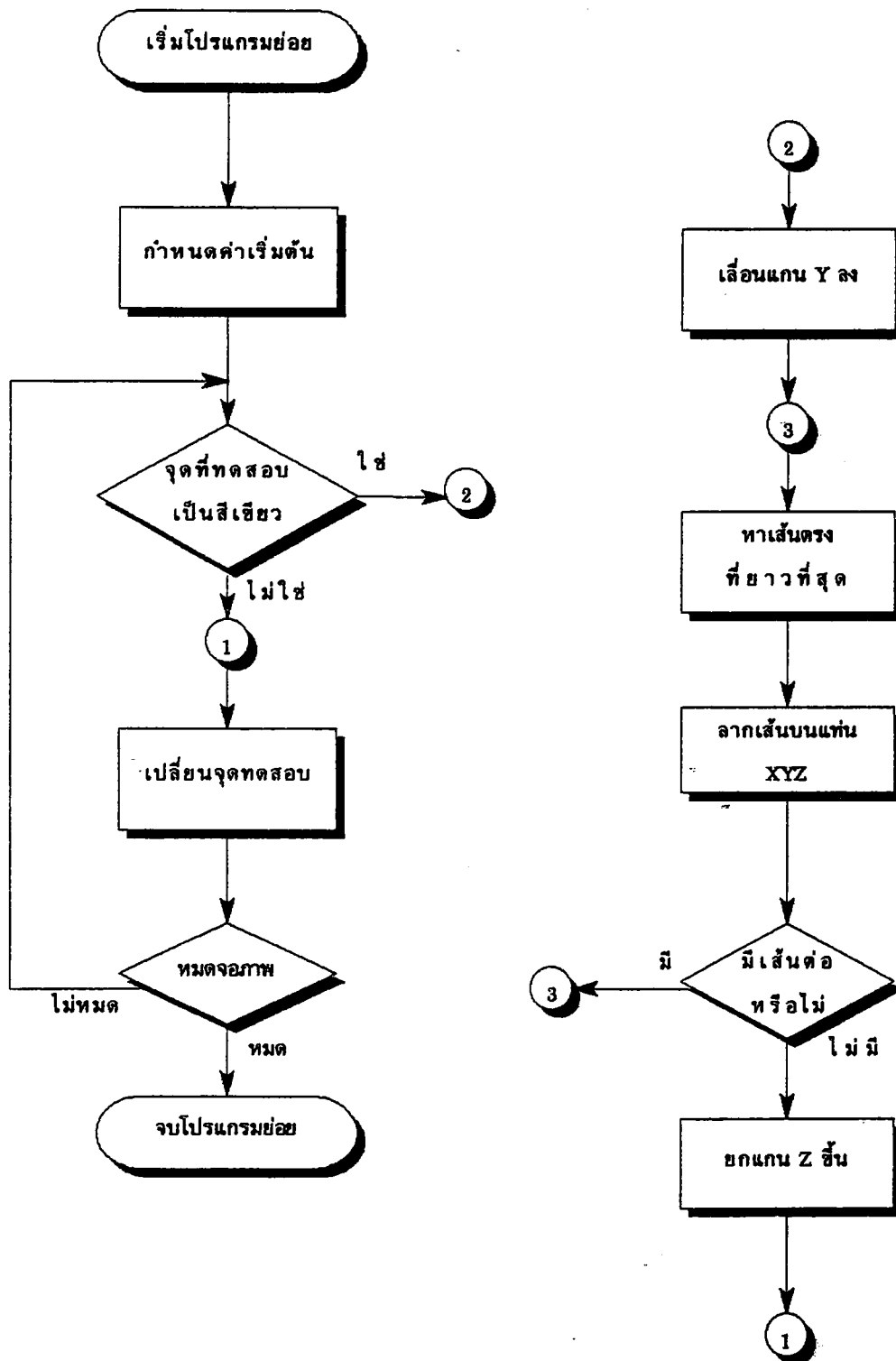
รูปที่ 5.2 Flowchart ของโปรแกรมในส่วนการ Load File

โปรแกรมย่อยหาขอบของภาพ

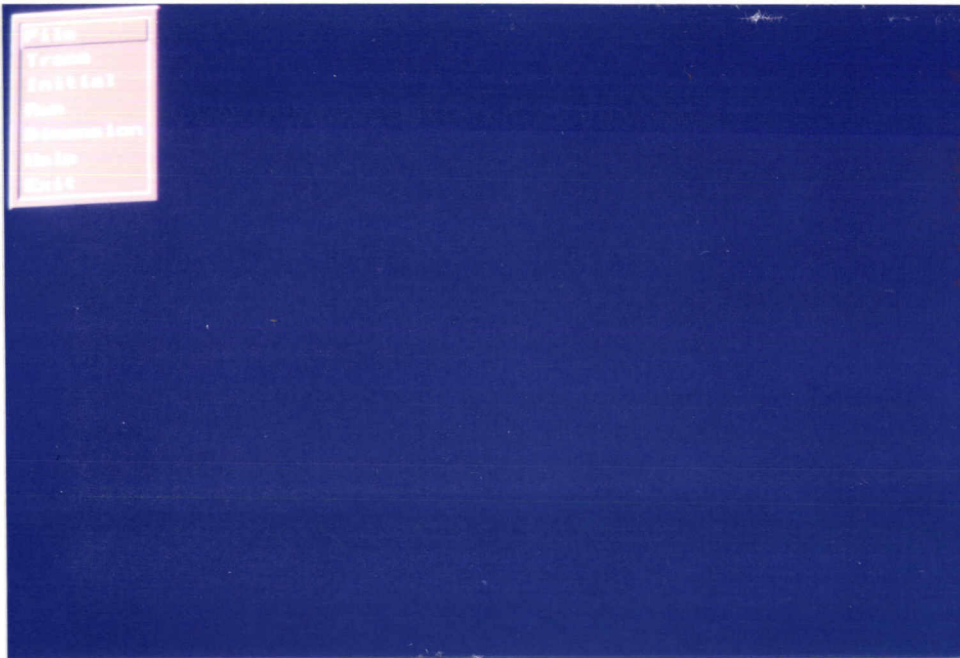


รูปที่ 5.3 Flowchart ของโปรแกรมในส่วนการหาขอบของภาพ

โปรแกรมย่อย RUN



รูปที่ 5.4 Flowchart ของโปรแกรมในส่วนการทำแผ่น PCB

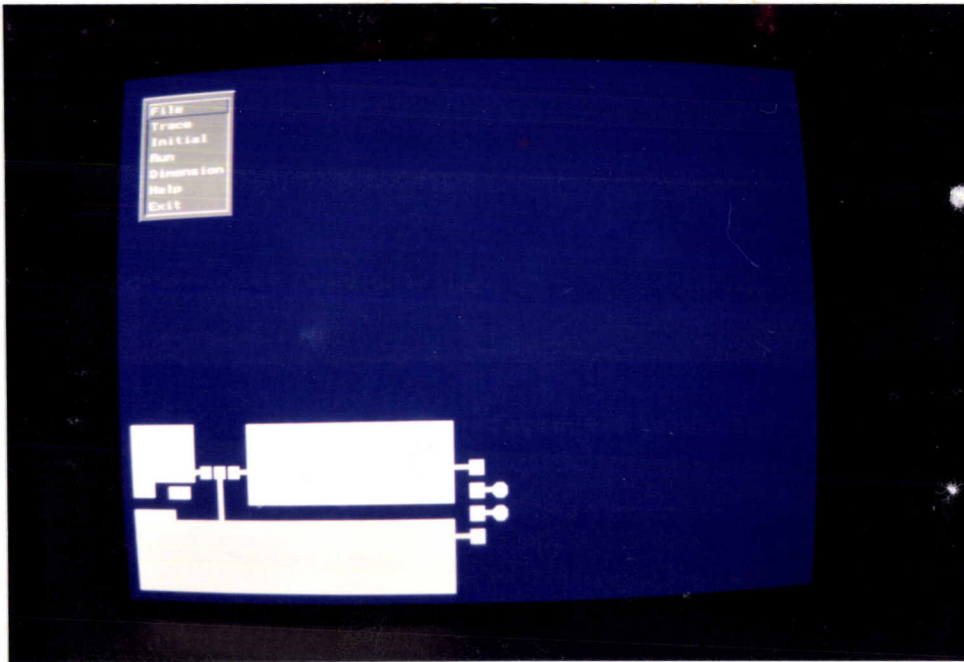


รูปที่ 5.5 รูปแสดงเมนูของโปรแกรม

ตัวเลือก File

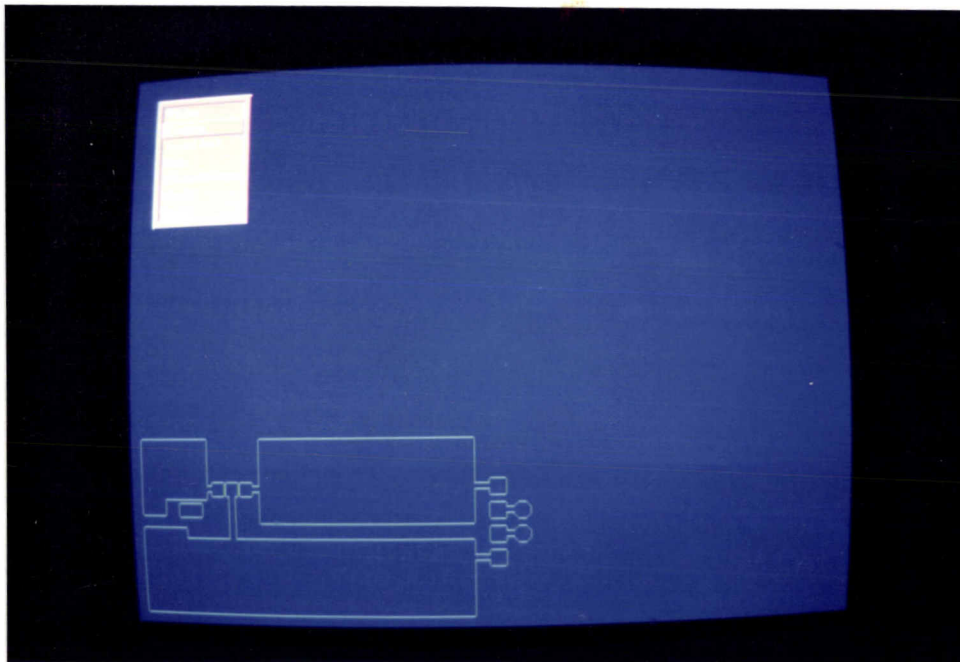
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้โปรแกรมจะรอรับชื่อไฟล์ที่ต้องการนำมาเป็นต้นแบบในการทำแผ่น PCB หากผู้ใช้ป้อนชื่อไฟล์ โดยไม่ระบุสกุลของไฟล์โปรแกรมจะกำหนดให้สกุลของไฟล์ที่ป้อนเข้ามาเป็น ".PCB" และหากชื่อไฟล์ที่ป้อนเข้ามามีเครื่องหมาย "*" หรือ "?" ซึ่งอาจทำให้มีไฟล์หลายไฟล์ที่สอดคล้องกับชื่อไฟล์ที่ป้อนเข้ามา โปรแกรมจะแสดงชื่อไฟล์ทั้งหมดนั้นออกมาให้ผู้เลือกใช้ไฟล์ที่จะอ่านเข้ามา เมื่ออ่านไฟล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วข้อผิดพลาดโปรแกรมจะแสดงลางวงจรบนจอภาพดังรูปที่ 5.6 ข้อผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการอ่านไฟล์เข้ามาคือ

- ไฟล์ที่อ่านเข้ามาไม่ใช่ไฟล์ของวงจรที่ออกแบบบนโปรแกรม Protel
- ไฟล์ที่อ่านเข้ามาไม่สมบูรณ์เมื่ออ่านเข้าไปแล้วไม่สามารถตีความข้อมูลได้



รูปที่ 5.6 แสดงการวาดรูปลวดวงจรบนจอภาพโดยกลับซ้ายเป็นขวา
ตัวเลือก Trace

เป็นตัวเลือกเพื่อหาขอบของลวดวงจรก่อนการทำแผ่น PCB ในการทำงานจะใช้
เวลาประมาณ 3 นาที แสดงดังรูป 5.7



รูป 5.7 แสดงภาพของลวดวงจรที่ผ่านขั้นตอนการหาขอบภาพแล้ว

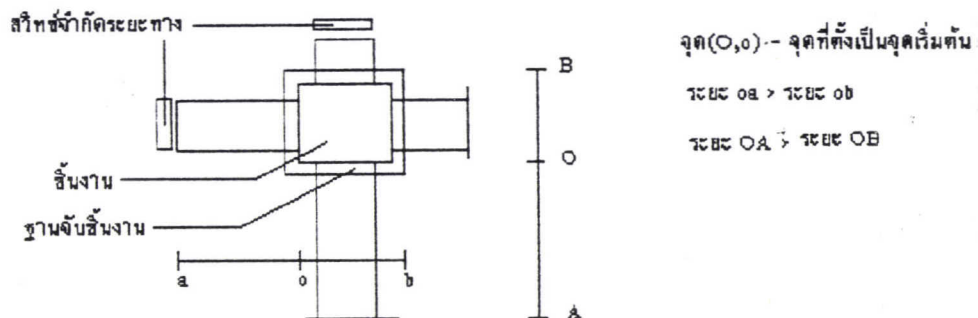
ตัวเลือก Initial

เป็นตัวเลือกที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนทำแผ่น PCB โดยก่อนเริ่มการทำแผ่น PCB ต้องทำตามขั้นดังนี้

- กำหนดตำแหน่งเริ่มต้น(มุมล่างซ้าย)ของชิ้นงานโดยโปรแกรมจะถือว่าตำแหน่งนั้นเป็นจุด (0,0) โดยต้องให้ระยะการเคลื่อนที่ของแกนด้านแกน Y ให้มากกว่าขนาดทางแกน Y ของลายวงจร และให้ระยะการเคลื่อนที่ของแกนด้านแกน X ให้มากกว่าขนาดทางแกน X ของลายวงจรหากระยะทางเหลือไม่พอจะทำให้แกนเคลื่อนที่ไปชน สวิตซ์ที่ใช้จำกัดการเคลื่อนที่ของแกนเพื่อป้องกันบอลสูทเสียหาย การเคลื่อนที่เพื่อกำหนดตำแหน่งควบคุมทางคีย์ลูกศร การจัดตำแหน่งในการ Initial แสดงดังรูปที่ 5.8

- กำหนดความลึกของหัวกัดที่จะใช้ในการทำงาน โดยควบคุมผ่านคีย์ Page Up (เลื่อนหัวกัดขึ้น) และ คีย์ Page Down (เลื่อนหัวกัดลง)

- กดคีย์ Enter เป็นการรับค่าทั้งหมดที่กำหนด

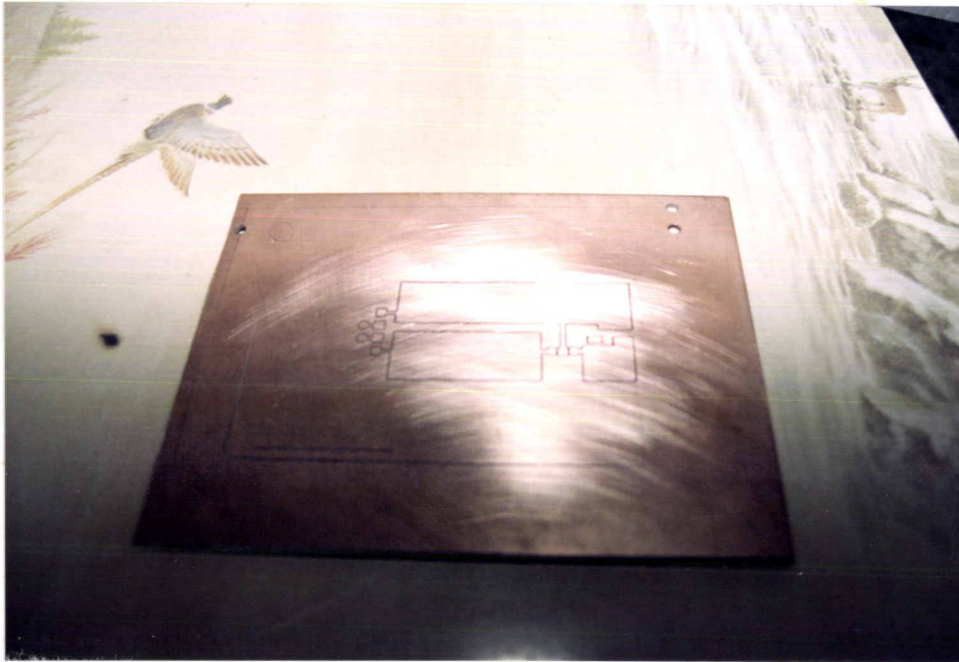


รูป 5.8 แสดงตำแหน่งในการ Initial

ตัวเลือก Run

เป็นการเริ่มทำแผ่น PCB จากรูปต้นแบบบนจอภาพ ระหว่างการทำงานหากแกนเคลื่อนที่ไปชนทำให้สวิตซ์ที่ใช้จำกัดระยะทางทำงานจะทำให้โปรแกรมหยุดทำงาน แต่ถ้าหากผู้ใช้ต้องการหยุดการทำงานสามารถหยุดได้โดยกดปุ่ม Ctrl-Break ระยะเวลาใน

การทำแผ่น PCB แต่ละครั้งจะขึ้นกับความละเอียดของลวดวงจรโดยที่ลวดวงจรที่มีขนาดใหญ่แต่มีรายละเอียดน้อยอาจใช้เวลาในการทำน้อยกว่าลวดวงจรที่มีขนาดเล็กกว่าแต่มีรายละเอียดมาก เมื่อการทำงานในส่วนนี้เรียบร้อยจะได้ชิ้นงานตามรูปที่ 5.9



รูปที่ 5.9 แสดงแผ่น PCB เมื่อสิ้นสุดการทำงาน

ตัวเลือก Dimension

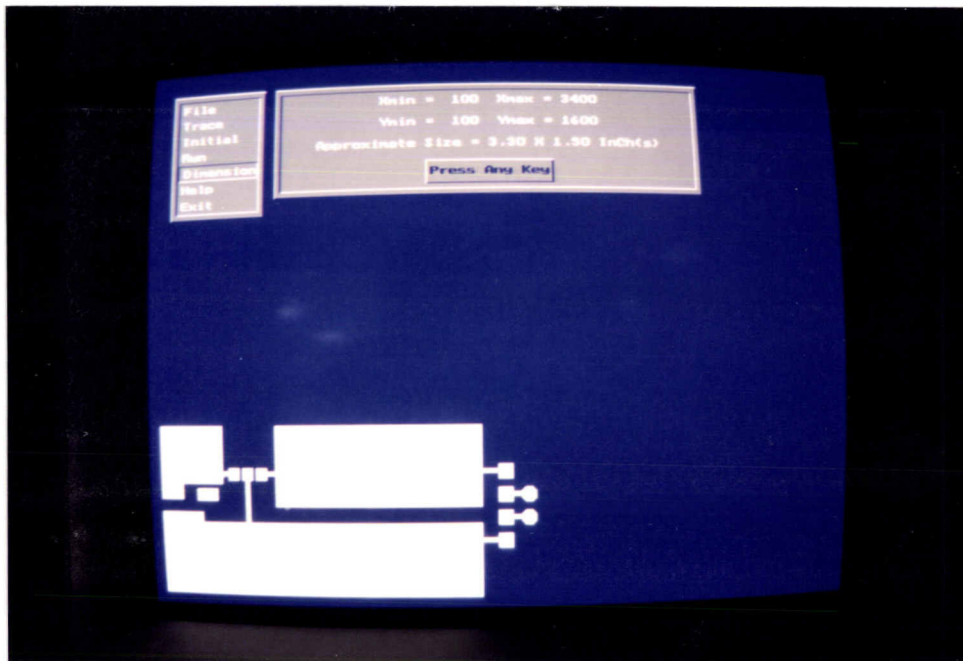
เป็นตัวเลือกให้โปรแกรมแสดงขนาดโดยประมาณของลวดวงจรที่วาดบนจอภาพ เพื่อนำขนาดไปใช้ในขั้นตอนการ Initial แสดงดังรูปที่ 5.10

ตัวเลือก Help

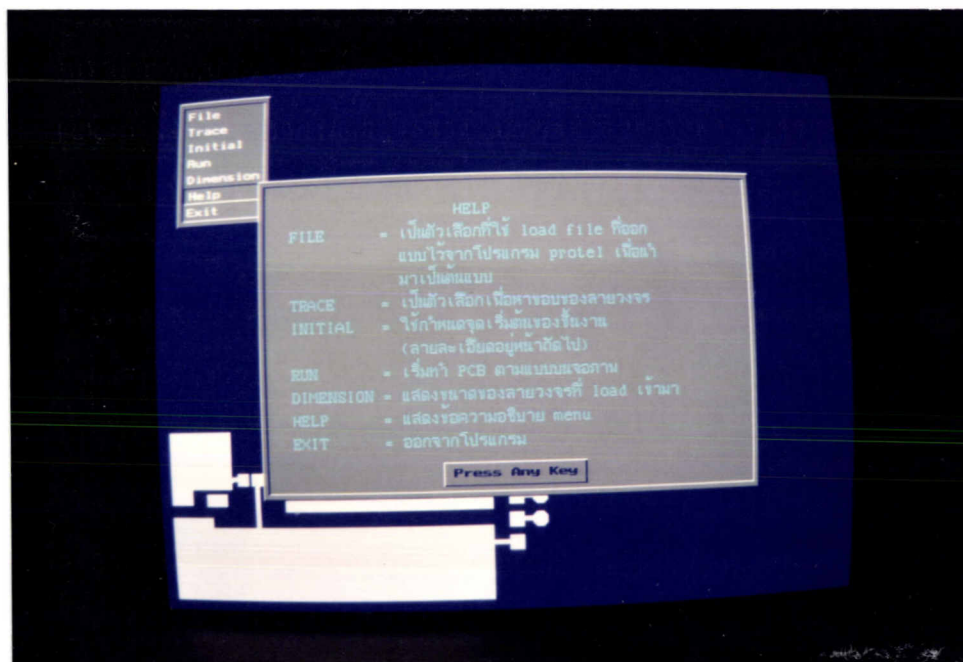
ตัวเลือกนี้จะแสดงรายละเอียดอย่างคร่าว ๆ ของตัวเลือกต่าง ๆ ในการใช้โปรแกรมดังรูปที่ 5.11

ตัวเลือก EXit

ใช้เมื่อต้องการออกจากโปรแกรม



รูปที่ 5.10 ขนาดของลายวงจรที่แสดงบนจอภาพ



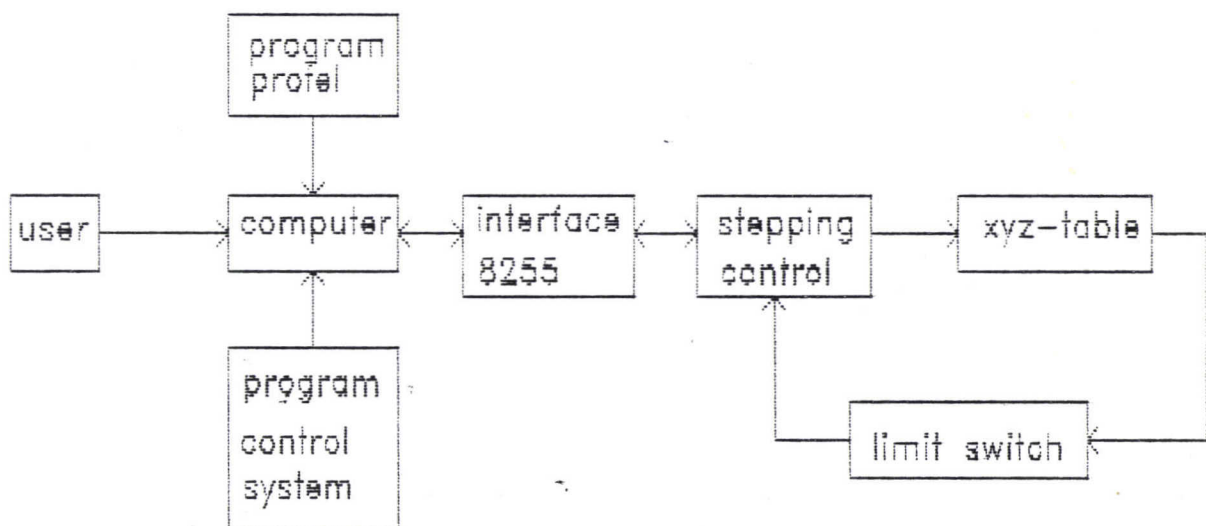
รูปที่ 5.11 แสดงจอภาพเมื่อเลือกตัวเลือก Help

บทที่ 6

การทดลองและผลการทดลอง

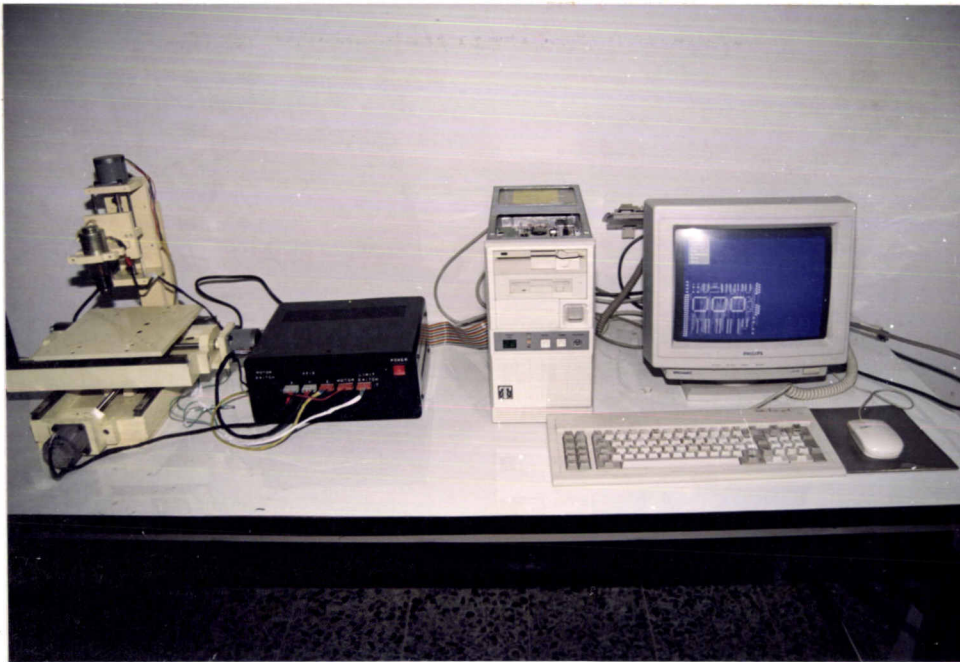
6.1 การติดตั้งและทดสอบระบบขับเคลื่อน(XYZ-table)

หลังจากที่ทำการออกแบบและสร้างระบบขับเคลื่อนรวมถึงระบบควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการติดตั้งส่วนต่างๆเข้าด้วยกันเป็นระบบที่สมบูรณ์ เพื่อทำการทดสอบการทำงานต่อไป



รูปที่ 6.1 ภาพถ่ายของ XYZ-TABLE พร้อมระบบขับเคลื่อน
ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

จากรูปที่ 6.1 จะทำการทดสอบการทำงานของชุดขับเคลื่อนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนในการทำงานจะมีไดอะแกรมดังนี้



รูปที่ 6.2 โดอะแกรมของระบบควบคุมการทำงานของระบบ

6.1.1 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

1. ผู้ใช้จะต้องทำการออกแบบลายวงจรให้เรียบร้อยผ่านทางโปรแกรม Protel ให้เรียบร้อย (โดยการออกแบบนี้มีข้อจำกัดคือต้องออกแบบให้อยู่ในด้านเดียวกัน)
2. ต่อจากนั้นลายวงจรที่ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว จะถูกนำไปสู่ขั้นตอนของโปรแกรมที่ทำการเขียนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนของโปรแกรมได้อธิบายไว้แล้วในข้างต้น
3. หลังจากนั้นจะเป็นการส่งผ่านข้อมูลออกทางชุดอินเทอร์เฟซ 8255 เพื่อเป็นการควบคุมการทำงานของชุดขับเคลื่อนทั้ง 3 แกน
4. ขั้นสุดท้ายนั้นจะเป็นการใช้หัวกักเอ็นมิลกัลคาลายของทองแดง งานสำเร็จเรียบร้อยตามที่ต้องการ

ส่วนของ feed back นี้มีไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ของแท่น ออกนอกขอบเขตที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องมาจากการทำงานของแท่น โดยในกรณีที่มีการเคลื่อนที่เกินความยาวของแท่น อุปกรณ์ที่เป็นไมโครสวิทช์ที่ติดอยู่ที่แกน X และ Y โดยถ้าแท่นเคลื่อนที่ชนกับสวิทช์จะไปทำการอินเทอร์รัปต์บอกให้ระบบหยุดทำงาน

6.2 การทดสอบการทำงานร่วมกันทั้ง 3 แกน

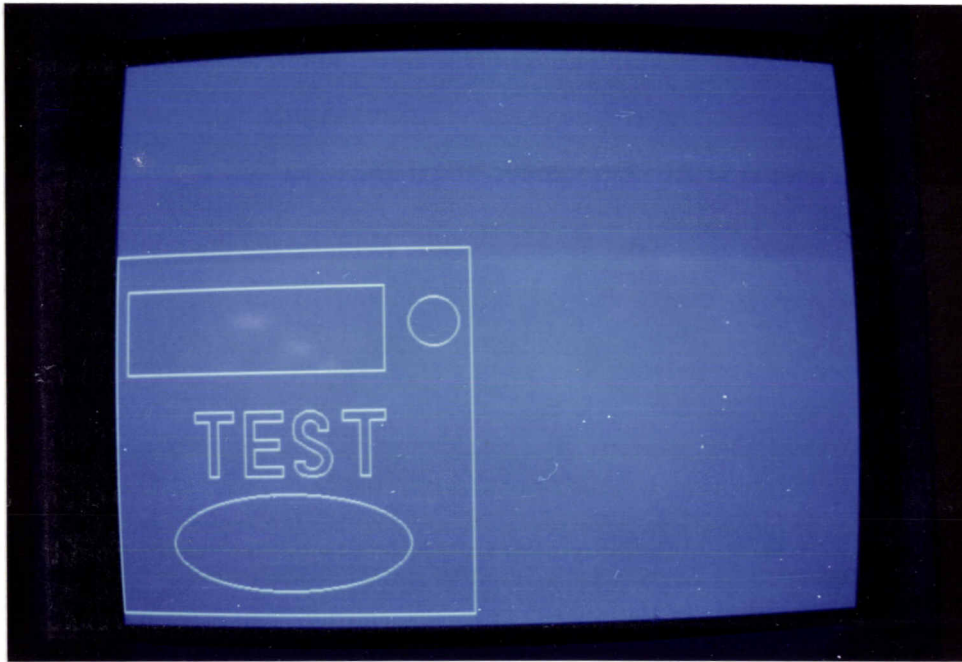
ในขั้นตอนของการทดสอบนี้สามารถที่จะทำการทดสอบ โดยการสร้างภาพที่ต้องการขึ้นบนจอภาพแล้วทดลองส่วนของโปรแกรมในส่วนการทำแผ่น PCB สร้างภาพหลายเส้นที่เหมือนบนจอภาพรูปที่ 6.3 แสดงภาพหลายเส้นต้นแบบที่ใช้ในการทดสอบ และรูปที่ 6.4 แสดงผลของการทดสอบสร้างภาพหลายเส้นตามต้นแบบ

6.3 การทดสอบความถูกต้องของการลากเส้น

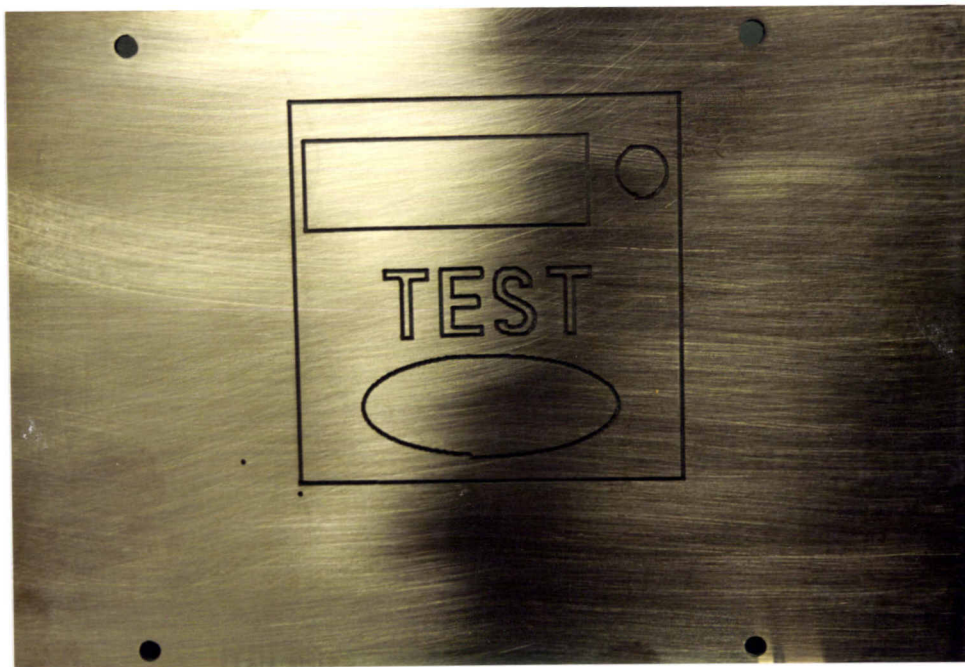
การทดสอบนี้เป็น การทดสอบความถูกต้องในการลากเส้นจาก XYZ-Table โดยสร้างภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3", 2" และ 1" ซ้อนกันตามลำดับ จากนั้นใช้โปรแกรมในส่วนการทำแผ่น PCB สร้างภาพตามแบบบนจอภาพและวัดความยาวของเส้นที่ลาก รูปที่ 6.5 แสดงภาพหลายเส้นต้นแบบที่ใช้ทดสอบ รูปที่ 6.6 แสดงผลการทดสอบที่ได้

6.4 การทดลองสร้างแผ่น PCB

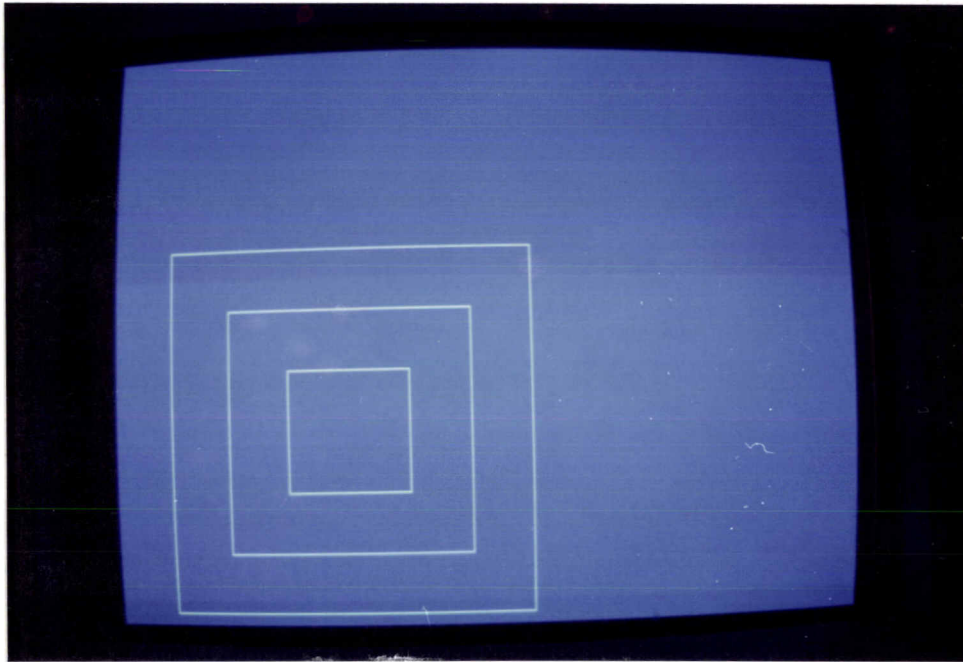
เป็นการทดสอบระบบทั้ง Hardware และ Software ในโครงการนี้ โดยนำลายวงจรที่ออกแบบจากโปรแกรม Protel และทำงานทดสอบการทำงานของโปรแกรมทุกส่วน รูป 6.7 แสดงลายวงจรที่นำมาทดสอบ และรูป 6.8 แสดงแผ่น PCB ที่ได้จากการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้น



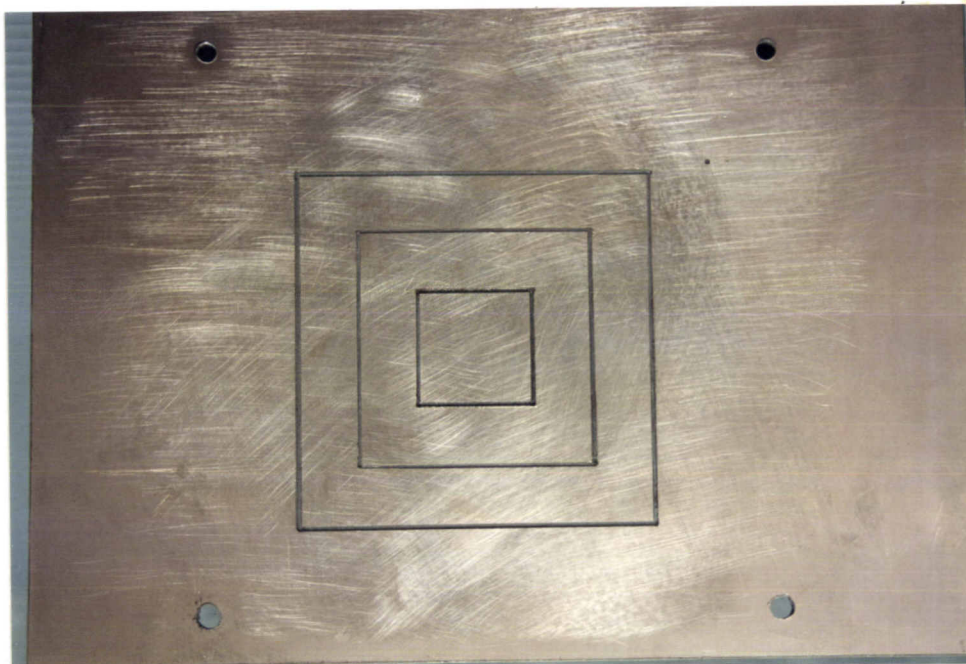
รูปที่ 6.3 ภาพลายเส้นที่ใช้ในการทดสอบการทำงานของแท่น



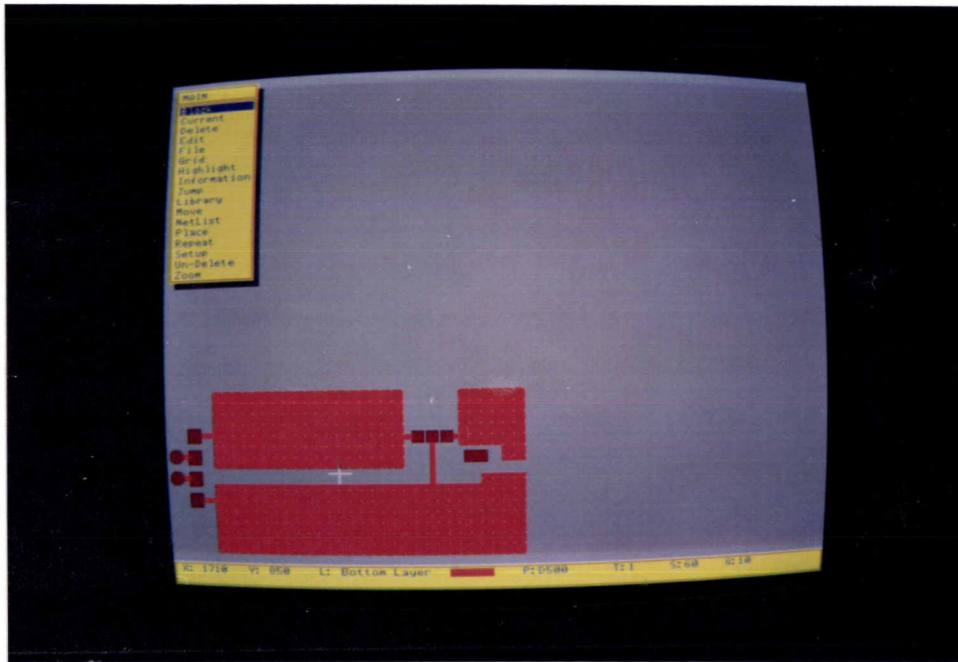
รูปที่ 6.4 ผลการทดสอบจากภาพต้นแบบรูปที่ 6.3



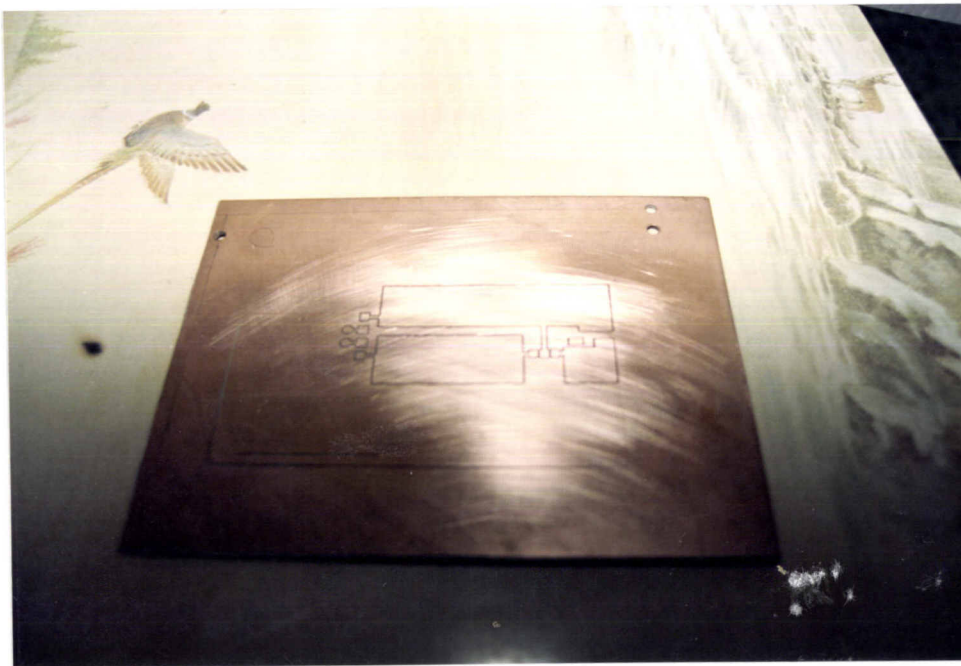
รูปที่ 6.5 ภาพฉายเส้นสีเหลืองมจตุรัส ขนาด 3", 2" และ 1" ตามลำดับ



รูปที่ 6.6 ผลการทดลองที่ได้จากต้นแบบรูป 6.5



รูปที่ 6.7 ภาพหน้าจอที่ออกแบบบนโปรแกรม Protel



รูปที่ 6.8 แผ่น PCB ที่ได้จากการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้น

บทที่ 7

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการสร้างและพัฒนาเครื่องต้นแบบ ชุดขับเคลื่อน 3 แกนซึ่งขับเคลื่อนด้วย Ball Screw (ระยะ Pitch 2mm) พร้อมระบบควบคุมมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนได้ออกแบบสร้างให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของสเต็ปมอเตอร์ 400 สเต็ปต่อรอบ ทำให้ความละเอียดในการเคลื่อนที่ของแท่นเท่ากับ 5 um พบว่าในการทดสอบความแม่นยำของตำแหน่งในการเคลื่อนที่ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งทดสอบโดยการสร้างภาพต้นแบบให้เครื่องลากเส้นตามภาพต้นแบบนั้น ส่วนในการทดสอบด้วยการใช้ทำแผ่น PCB ผลที่ได้ดีพอสมควร แต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นดังนี้

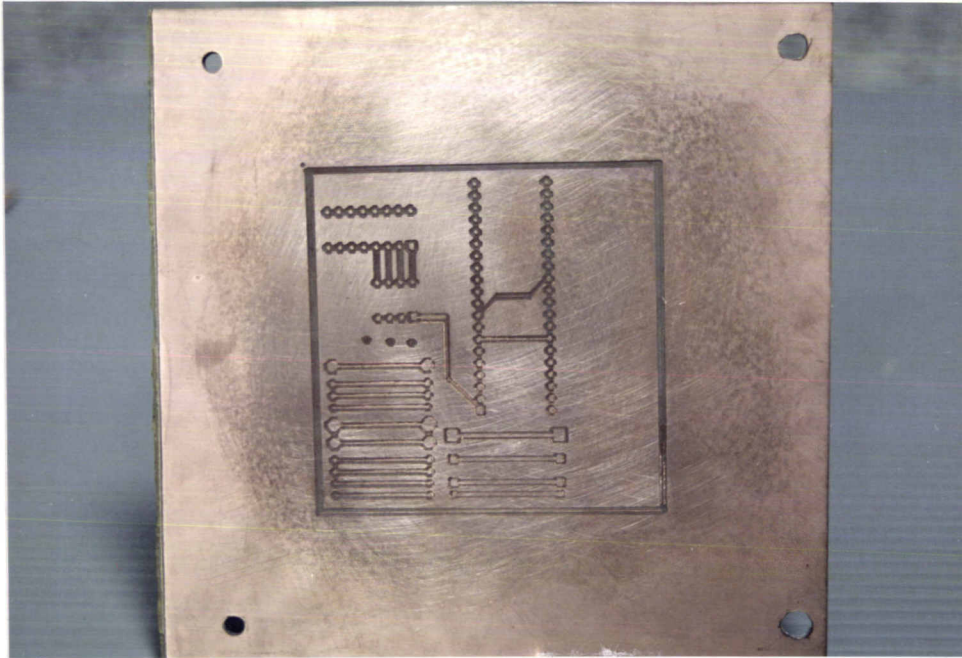
1. จากการทดลองพบว่าการติดตั้งแผ่น PCB ลงบนแท่นเพื่อปฏิบัติงานหากแผ่น PCB ที่ติดตั้งไม่ได้ระดับจะทำให้ความลึกของการกัดเจาะไม่คงที่อาจทำให้ผิวทองแดงที่เคลือบอยู่ไม่ขาดออกจากกัน และระดับความลึกของการกัดเจาะยังมีผลกับขนาดของเส้นบนชิ้นงาน ดังแสดงตามรูปที่ 7.1 จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายขนาดของเส้นที่ลากจะมีขนาดใหญ่กว่าเส้นด้านขวา ซึ่งเกิดจากความลึกของการกัดเจาะไม่เท่ากัน และทำให้ลายเส้นด้านซ้ายมีความละเอียดมากกว่าด้านขวาโดยดูจากเส้นขอบทางขวาของทองแดงระหว่างเส้นที่เป็นขอบรูปถูกกัดออกจนหมดแต่ด้านซ้ายของทองแดงระหว่างเส้นยังคงเหลืออยู่

2. ความเร็วของแท่นในการเคลื่อนที่ถ้ามากเกินไปจะทำให้เส้นที่ได้ไม่คมชัด และอาจทำให้หัวกัดเกิดความเสียหายได้

3. ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ใช้เมื่อติดตั้งส่วนจับหัวกัดแล้วลดลงจาก คุณสมบัติที่ระบุไว้ทำให้หัวกัดเกิดความเสียหายได้

4. ความร้อนที่เกิดขึ้นในการทำแผ่น PCB ทำให้หัวกัดเกิดความเสียหาย(หัวกัดที่ใช้ในโครงการนี้ไม่ใช่หัวกัดแผ่น PCB โดยตรง)

แต่อย่างไรก็ตามโครงการพิเศษนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในระดับหนึ่ง กล่าวคือถ้าได้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวได้คาดว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ



รูปที่ 7.1 แสดงเส้นที่เกิดจากความลึกในการกัดเซาะไม่เท่ากัน

ภาคผนวก

ส่วนของโปรแกรม
Auto pcb.pas

Program Auto_PCB;

Uses Crt,Graph,Menu2,Thai2,Dos;

Const Header : String = 'PCB FILE 4';

```
Type TrackPtr = ^TrackType;
TrackType = Record
    x1,y1,x2,y2,width,Layer : Integer;
    Next : TrackPtr;
End;
HeadTrackType = Record
    Num : Word;
    First : TrackPtr;
End;

PadPtr = ^PadType;
PadType = Record
    x,y,lx,ly,form,Layer : Integer;
    Next : PadPtr;
End;
HeadPadType = Record
    Num : Word;
    First : PadPtr;
End;

ViaPtr = ^ViaType;
ViaType = Record
    x,y,Outside,Inside : Integer;
    Next : ViaPtr;
End;
HeadViaType = record
    Num : Word;
    First : ViaPtr;
End;

FillPtr = ^FillType;
FillType = Record
    x1,y1,x2,y2,Layer : Integer;
    Next : FillPtr;
End;
HeadFillType = Record
    Num : Word;
    First : FillPtr;
End;
```

```
Var
    Fi : Text;
    FileRead,Select: Byte;
    FileName : String;
    Heap,Bitmap : Pointer;
    TrackNode,TrackDat : TrackPtr;
    PadNode,PadDat : PadPtr;
    ViaNode,ViaDat : ViaPtr;
    FillNode,FillDat : FillPtr;
    HeadTrack : HeadTrackType; {Head Of Track-Link}
```

```

HeadPad      : HeadPadType;      {Head Of Pad-Link}
HeadVia      : HeadViaType;      {Head Of Via-Link}
HeadFill     : HeadFillType;     {Head Of Fill-Link}
Xmin,Ymin,Xmax,Ymax : Word; {Dimension Of PCB}
XOfPlane,YOfPlane : Word; {location of Top-Right For EaCh Plane}
BeginXofPlane,
BeginYofPlane : Integer; {location of Bottom-Left of EaCh Plane}
CurXPlane,CurYPlane : Byte; {Current X & Current Y Plane}
NumXPlane,NumYPlane : Byte; {Number of X & Number of Y Plane}
Divider,CheckMake : Byte; { 1 = 0.025 um }
                    { ..... }
                    { ..... }
                    {10 = 0.25 um }

ScreenWidth,Screendepth : Word;
Menu : MenuType;
PCBFileFlag,TraceFlag,InitialFlag : Byte;
MakeExit,Ch : Char;
Size : Word;
Behide,Old1b : Pointer;

```

```

{$i Trace.icl}
{$i Makepcb2.icl}
{$i Ptform2.icl}

```

```

Procedure InitAllHead;

```

```

Begin
  headTrack.Num := 0;
  headTrack.First := Nil;
  HeadPad.Num := 0;
  HeadPad.First := Nil;
  headVia.Num := 0;
  headVia.First := Nil;
  headFill.Num := 0;
  headFill.First := Nil;
End;

```

```

Procedure AddTrackNode(P1,P2,P3,P4,P5,P6 : Integer);

```

```

Begin
  Inc(HeadTrack.Num);
  New(TrackDat);
  With TrackDat^ Do
  Begin
    x1 := P1;
    y1 := P2;
    x2 := P3;
    y2 := P4;
    Width := P5;
    Layer := P6;
    If x1 < Xmin Then Xmin := x1;
    If y1 < Ymin Then Ymin := y1;
    if x2 > Xmax Then Xmax := x2;
    If y2 > Ymax Then Ymax := y2;
  End;
  If HeadTrack.First = nil Then HeadTrack.First := TrackDat Else
  TrackNode^.Next := TrackDat;
  TrackNode := TrackDat;

```

End;

Procedure AddPadNode(P1,P2,P3,P4,P5,P6 : Integer);

```
Begin
  Inc(HeadPad.Num);
  New(PadDat);
  With PadDat^ Do
    Begin
      x      := P1;
      y      := P2;
      Lx     := P3;
      Ly     := P4;
      form   := P5;
      Layer  := P6;
      If x < Xmin Then Xmin := x Else If x > Xmax Then Xmax := x;
      If y < Ymin Then Ymin := y Else If y > Ymax Then Ymax := y;
    End;
  If HeadPad.First = nil Then HeadPad.first := PadDat
  Else PadNode^.Next := PadDat;
  PadNode := PadDat;
End;
```

Procedure AddViaNode(P1,P2,P3,P4 : Integer);

```
Begin
  Inc(HeadVia.Num);
  New(ViaDat);
  With ViaDat^ Do
    Begin
      x      := P1;
      y      := P2;
      OutSide:= P3;
      Inside := P4;
      If x < Xmin Then Xmin := x Else If x > Xmax Then Xmax := x;
      If y < Ymin Then Ymin := y Else If y > Ymax Then Ymax := y;
    End;
  If HeadVia.First = nil Then HeadVia.first := ViaDat
  Else ViaNode^.Next := ViaDat;
  ViaNode := ViaDat;
End;
```

Procedure AddFillNode(P1,P2,P3,P4,P5: Integer);

```
Begin
  Inc(HeadFill.Num);
  New(FillDat);
  With FillDat^ Do
    Begin
      x1     := P1;
      y1     := P2;
      x2     := P3;
      y2     := P4;
      Layer  := P5;
      If x1 < Xmin Then Xmin := x1;
      If y1 < Ymin Then Ymin := y1;
      if x2 > Xmax Then Xmax := x2;
      If y2 > Ymax Then Ymax := y2;
    End;
End;
```

```

If HeadFill.first = nil Then headFill.first := FillDat
Else FillNode^.Next := FillDat;
FillNode := FillDat;
End;

```

```

Function FindParameter(NPara,command : Integer):Byte ; {Find N parameter}
Var
Parameter : Array[1..10] Of Word;           {0 - NoError}
Ch         : Char;                          {1 - Error}
i,j,n     : Byte;
paraStr   : String;
Code      : Integer;
Begin
For i := 1 To NPara Do
Begin
n := 0;
ParaStr := '';
Repeat
Read(fi,Ch);
If ((Ch <> #10) And (Ch <> #32)) Then
Begin
ParaStr := ParaStr+Ch;
inc(n);
End;
Until (Ch = #10) Or (Ch = #32);
If Ch = #10 Then Delete(ParaStr,n,1);
Val(ParaStr,Parameter[i],Code);
If (Code <> 0) And (i <> 9) Then Begin
FindParameter := 1;
Exit;
End;
End;
End;
Case Command Of
{Track} 1 : AddTrackNode(Parameter[1],Parameter[2],Parameter[3],
Parameter[4],Parameter[5],Parameter[6]);
{Pad} 2 : AddPadNode(Parameter[1],Parameter[2],Parameter[3],
Parameter[4],Parameter[5],Parameter[8]);
{Via} 3 : AddViaNode(Parameter[1],Parameter[2],Parameter[3],
Parameter[4]);
{Fill} 4 : AddFillNode(Parameter[1],Parameter[2],Parameter[3],
Parameter[4],Parameter[5]);
End;
End;

```

```

Function ReadPCB(Finame : String) : Byte; {Read PCB File }
Var
command : String; { 0 - No Error }
error   : Byte;   { 1 - Not ProtelFormat }
                    { 2 - File Not Found }
                    { 3 - File Error }
Begin
{$i-}
Assign(Fi,Finame);
Reset(fi);

```

```

{Si+}
If Ioresult <> 0 Then Begin ReadPCB := 2;Exit; End;
Readln(Fi,Command);
If Command <> Header Then Begin ReadPCB := 1;Close(fi);Exit;End;
If PCBFileFlag = 1 Then
Begin
  Release(Heap);
End;
Mark(Heap);
TrackNode := NIL;PadNode := NIL;ViaNode := NIL;FillNode := NIL;
InitAllHead;
Xmin := $FFFF;Xmax := $0;
Ymin := $FFFF;Ymax := $0;
While Not Eof(Fi) Do
Begin
  Error := 0;
  Readln(fi,Command);
  If (Command = 'FT') Or (Command = 'CT')
  Then Error := FindParameter(6,1) Else
  If (Command = 'FP') Or (Command = 'CP')
  Then Error := FindParameter(9,2) Else
  If (Command = 'FV') Then Error := FindParameter(4,3) Else
  If (Command = 'FF') Then Error := FindParameter(5,4);
  If Error = 1 Then Begin ReadPCB := 3;Close(fi);Exit;End;
End;
Close(fi);
If HeadTrack.Num <> 0 Then TrackNode^.Next := NIL;
If HeadPad.Num <> 0 Then PadNode^.Next := NIL;
If HeadVia.Num <> 0 Then ViaNode^.Next := NIL;
If HeadFill.Num <> 0 Then FillNode^.Next := NIL;
PCBFileFlag := 1;
ReadPCB := 0;
End;

Procedure OpenGraph;
Var Gd,Gm : Integer;
Begin
  DetectGraph(Gd,Gm);
  Initgraph(Gd,Gm,'');
End;

Procedure DrawPCB(Layer : Byte);
Begin
  SetColor(15);
  SetFillStyle(1,15);
  TrackNode := HeadTrack.First;
  PadNode := HeadPad.First;
  ViaNode := HeadVia.First;
  FillNode := HeadFill.First;

  While (TrackNode <> Nil) Do
  Begin
    If TrackNode^.Layer = Layer Then Track(TrackNode^.x1,TrackNode^.y1,
      TrackNode^.x2,TrackNode^.y2,
      TrackNode^.Width);
    TrackNode := TrackNode^.Next
  End
End;

```

```

End;
While (FillNode <> Nil) Do
  Begin
    If FillNode^.Layer = Layer Then Fill(FillNode^.x1,Fillnode^.y1,
                                           FillNode^.x2,Fillnode^.y2);
    Fillnode := Fillnode^.Next;
  End;

```

```

While(PadNode <> Nil) Do
  Begin
    Pad(PadNode^.x,PadNode^.y,
        PadNode^.lx,PadNode^.ly,PadNode^.form);
    PadNode := PadNode^.Next;
  End;

```

```

While(ViaNode <> Nil) Do
  Begin
    Via(Vianode^.x,Vianode^.y,vianode^.Outside,Vianode^.inside);
    ViaNode := Vianode^.Next;
  End;

```

```

End;

```

```

Procedure ShowDimension;

```

```

Var

```

```

  XminStr,YminStr,XmaxStr,YmaxStr,WidthStr,HightStr : String;

```

```

  Size : Word;

```

```

  Behide : Pointer;

```

```

  Ch : Char;

```

```

Begin

```

```

  If PCBFileFlag = 1 Then

```

```

    Begin

```

```

      Str(Xmin:4,XminStr);

```

```

      Str(Ymin:4,YminStr);

```

```

      Str(Xmax:4,XmaxStr);

```

```

      Str(Ymax:4,YmaxStr);

```

```

      Str((Xmax - Xmin)/1000:3:2,WidthStr);

```

```

      Str((Ymax-Ymin)/1000:3:2,hightStr);

```

```

      size := Imagesize(120,20,500,120);

```

```

      Getmem(Behide,size);

```

```

      GetImage(120,20,500,120,Behide^);

```

```

      BoxUp(120,20,500,120,7);

```

```

      BoxDown(125,25,495,115,7);

```

```

      SetTextjustify(centertext,centertext);

```

```

      OutTextXy(310,35,'Xmin = '+Xminstr+ ' Xmax = '+XmaxStr);

```

```

      OutTextXY(310,55,'Ymin = '+YminStr+ ' Ymax = '+YmaxStr);

```

```

      OutTextxy(310,75,'Approximate Size = '+WidthStr+ ' X '+hightStr+
        ' InCh(s)');

```

```

      Ch := ShowMessage(255,90,365,110,7,'Press Any Key','');

```

```

      PutImage(120,20,Behide^,normalput);

```

```

      Freemem(Behide,size);

```

```

    End Else Ch := ShowMessage(120,20,300,50,7,'Load File First !','');

```

```

End;

```

```

Procedure ShowHelp;

```

```

Var Behidge : Pointer;

```

```
size : Word;
Pindex,res : Byte;
```

```
Procedure Draw;
```

```
Begin
```

```
SetFillStyle(1,10);Bar(300,230,310,240);Bar(260,260,270,270);
Bar(426,288,436,298);
SetFillStyle(1,1);Bar(275,245,345,300);
SetFillStyle(8,yellow);Bar(290,260,330,285);
SetColor(15);
Line(400,230,400,340);Line(260,340,400,340);
SetColor(0);
Line(290,315,332,315);Line(345,315,400,315);
Line(290,310,290,320);Line(332,310,332,320);Line(400,310,400,320);
Line(345,310,345,320);
Line(245,260,245,290);Line(245,300,245,340);
Line(240,260,250,260);Line(240,290,250,290);Line(240,340,250,340);
Line(240,300,250,300);
OutThaiXY(225,265,'A',11);OutThaiXY(227,310,'C',11);
OutThaiXY(306,320,'B',11);OutThaiXY(370,320,'D',11);
SetColor(green);Line(325,273,422,273);Line(215,293,291,293);
SetFillStyle(1,11);Bar(430,310,530,340);
OutThaiXY(435,315,'C>A <A! D>B',0);
```

```
End;
```

```
Function ShowPage(page:Byte):Byte;{0-Ready,1-no help file,2-quit}
```

```
Var helpfi : text;
```

```
  i : Byte;
```

```
  ShowStr,pagestr: String;
```

```
  yy : Integer;
```

```
  Ch : Char;
```

```
Begin
```

```
Assign(helpfi,'project.hlp');
```

```
{$i-}
```

```
reset(helpfi);
```

```
{$i+}
```

```
If IOResult = 0 Then
```

```
Begin
```

```
  str(page,pagestr);
```

```
  Repeat
```

```
  Readln(helpfi,showstr);
```

```
  Until showStr = 'P'+pagestr;
```

```
  yy := 0;
```

```
  BoxDown(105,105,535,375,7);
```

```
  For i := 1 To 11 Do
```

```
  Begin
```

```
    Readln(helpfi,showstr);
```

```
    If ShowStr = 'DRAW' Then Draw Else OutThaiXY(130,120+yy,showStr,11);
```

```
    yy := yy +20;
```

```
  End;
```

```
  ShowPage := 0;
```

```
  close(helpfi);
```

```
  Ch := ShowMessage(260,350,380,370,7,'Press Any Key','');
```

```
  if Ch = #27 Then showpage := 2;
```

```
End Else
```

```
Begin
```

```

Ch := ShowMessage(260,350,380,370,7, 'No Help File', '');
ShowPage := 1;
End;
End;

```

```

Begin
  pindex := 0;
  size := Imagesize(100,100,540,380);
  GetMem(Behide,Size);
  GetImage(100,100,540,380,Behide^);
  BoxUp(100,100,540,380,7);
  BoxDown(105,105,535,375,7);
  Repeat
    inc(pindex);
    res := showpage(pindex);
  Until (res = 2) or (res = 1) or (pindex = 2);
  PutImage(100,100,Behide^,normalput);
  Freemem(Behide,size);
End;

```

```

Procedure DoTraceItem;
Begin
  If PCBFileFlag = 1 Then
  Begin
    RestoreScr(Menu);
    DoTrace(0,0,ScreenWidth-1,ScreenDepth-1,0);
    TraceFlag := 1;
  End Else Ch := ShowMessage(120,20,300,50,7, 'Load File First !', '');
End;

```

```

Procedure DoInitial;
Var Size : Word;
    Behide : Pointer;
    key : Char;
Begin
  If TraceFlag = 1 Then
  Begin
    size := Imagesize(100,100,540,380);
    GetMem(Behide,Size);
    GetImage(100,100,540,380,Behide^);
    BoxUp(100,100,540,380,7);
    BoxDown(105,105,535,375,7);
    OutThaixy(130,120, '      ชะงាប់เป๋',11);
    OutThaixy(130,140, ' - .ฉะฆากฎ "ศกทลข่าบ" .ภ'ฎ.ศ'ฎบ๑นร๑นโฉ๑ปส +Y',11);
    OutThaixy(130,160, ' - .ฉะฆากฎ "ศกทลศฉ" .ภ'ฎ.ศ'ฎบ๑นร๑นโฉ๑ปส -Y',11);
    OutThaixy(130,180, ' - .ฉะฆากฎ "ศกทลขสโ" .ภ'ฎ.ศ'ฎบ๑นร๑นโฉ๑ปส +X',11);
    OutThaixy(130,200, ' - .ฉะฆากฎ "ศกทลหุโฉ" .ภ'ฎ.ศ'ฎบ๑นร๑นโฉ๑ปส -X',11);
    OutThaixy(130,220, ' - .ฉะฆากฎ "Page Up" .ภ'ฎ.ศ'ฎบ๑นร๑นโฉ๑ปส',11);
    OutThaixy(130,240, ' - .ฉะฆากฎ "Page Down" .ภ'ฎ.ศ'ฎบ๑นร๑นโฉ๑ปส',11);
    OutThaixy(130,260, ' - .ฉะฆากฎ "Enter" .ภ'ฎ.ศ'ฎบ๑นร๑นโฉ๑ปส',11);
  End;

```

```

Repeat
Key := Readkey; If key = #0 Then key := Readkey:
Case key Of
#72 : Begin
    For stt := 1 To 400 Do
    Begin
        Port[Pa] := Data_out1[IndexMotor1] Or
        Data_out2[IndexMotor2];
        Update(IndexMotor1,1);
        Delay(1);
    End;
End;
#80 : Begin
    For stt := 1 To 400 Do
    Begin
        Port[PA] := Data_out1[IndexMotor1]
        Or Data_out2[IndexMotor2];;
        Update(IndexMotor1,0);
        Delay(1);
    End;
End;
#75 : Begin
    For stt := 1 To 400 Do
    Begin
        Port[PA] := Data_out2[IndexMotor2]
        Or Data_out1[IndexMotor1];
        Update(IndexMotor2,1);
        Delay(1);
    End;
End;
#77 : Begin
    For stt := 1 To 400 Do
    Begin
        Port[PA] := Data_out2[IndexMotor2]
        Or Data_out1[IndexMotor1];
        Update(IndexMotor2,0);
        Delay(1);
    End;
End;
#81 : Begin
    For stt := 1 To 5 Do
    Begin
        Port[Pb] := Data_out1[IndexMotor3];
        Update(IndexMotor3,1);
        DELAY(7);
    End;
End;
#73 : Begin
    For stt := 1 To 5 Do
    Begin
        Port[Pb] := Data_out1[IndexMotor3];
        Update(IndexMotor3,0);
        DELAY(7);
    End;
End;
End;

```

```

Until key = #13;
PutImage(100,100,Behide^,normalput);
Freemem(Behide,size);
Initialflag := 1;
End Else Ch := ShowMessage(120,20,300,50,7,'Trace First !','');
End;

Procedure DoRun;
Var Result : Byte;
Begin
  If InitialFlag = 1 Then
  Begin
    Restorescr(menu);
    Result := MakePCB;
    If Result <> 0 Then Ch := ShowMessage(50,20,350,50,7,
      'criticla error or interrupt by user !','');
    If PCBFileflag = 1 Then
    Begin
      Release(heap);
      PCBFileflag := 0;
    End;
    TraceFlag := 0;
    InitialFlag := 0;
  End Else Ch := ShowMessage(120,20,300,50,7,'Initial First !','');
End;

```

```

{$F+,S-,W-}
Procedure New1b;Interrupt;
Begin
  critical := true;
End;
{$F-,S+}

```

```

Begin
  {***Initial Value***}
  GetIntVec($1b,Old1b); -
  SetIntvec($1b,Addr(new1b));
  Select := loadfont('Normal.fon');
  If Select <> 0 Then Begin
    Writeln('Thai font Not Found!');
    Halt;
  End;
  PCBFileFlag := 0;TraceFlag := 0;InitialFlag := 0;
  Xmin := $ffff;Ymin := $ffff;
  Xmax := 0;Ymax := 0;
  Divider := 10;
  port[pcc] := $89;
  IndexMotor1 := 1;IndexMotor2 := 1;IndexMotor3 := 1;
  AddMenuItem(Menu,1,'File');
  AddMenuItem(Menu,2,'Trace');
  AddMenuItem(Menu,3,'Initial');
  AddMenuItem(Menu,4,'Run');
  AddMenuItem(Menu,5,'Dimension');

```

```

AddMenuItem(Menu,3,'Help');
AddMenuItem(Menu,7,'Exit');
InitMenu(Menu,20,20,7);
OpenGraph;
ScreenWidth := GetMaxX + 1;
ScreenDepth := GetMaxY + 1;
Repeat
  Select := DoMenu(Menu,7);
  Case Select Of
    1{File} : Begin
      size := Imagesize(120,20,300,60);
      Getmem(Behide,size);
      Getimage(120,20,300,60,Behide^);
      WriteinboxUp(120,20,300,60,7,190,35,
        'Enter File name');
      EnterString(130,45,18,11,filename);
      PutImage(120,20,Behide^,normalput);
      Freemem(Behide,size);
      If filename <> '' Then
        Begin
          filename := Showload(120,20,filename);
          If filename = 'FILENOTFOUND' Then
            Ch := ShowMessage(120,20,300,50,7,
              'File Not Found!', ''); Else
          If filename = 'PATHNOTFOUND' Then
            Ch := ShowMessage(120,20,300,50,7,
              'Path Not Found!', '') Else
          If filename = 'ESCAPE' Then Else
            Begin
              FileRead := ReadPCB(filename);
              Case FileRead of
                1 : Ch := ShowMessage(120,20,300,50,7,
                  'Not Protel Format!', '');
                3 : Ch := ShowMessage(120,20,300,50,7,
                  'Data Error!', '');
                0 : Begin
                      RestoreScr(Menu);
                      Cleardevice;
                      DrawPCB(6);
                    End;
              End;
            End;
          End;
        End;
      End;
    2{Trace} : Begin
      DoTraceItem;
      End;
    3{Initial} : Begin
      DoInitial;
      End;
    4{Run} : Begin
      DoRun;
      End;
    5{Dimension}: ShowDimension;
    6{help} : ShowHelp;
  End;
End;

```

```
7,0(Exit) : Begin
            MakeExit := ShowMessage(120,20,300,50,7,
            'Are you sure ! (Y/N)', 'YN');
            End;
```

```
End;
```

```
Until MakeExit = 'Y';
If PCBFileflag = 1 Then Release(heap);
CloseGraph;
SetIntVec($1b,Old1b);
Port[Pa] := $00;
Port[pb] := $00;
```

```
End.
```

ส่วนของโปรแกรม
Make pcb2.icl

```

TYPE      AR_DATA = Array[1..8] Of Byte;
         Point    = Record
                   x : integer;
                   y : integer;
                 End;

CONST     PA = $0300;
         PB = $0301;
         PC = $0302;
         PCC = $0303;

         Data_out1 : Ar_Data = ($01,$03,$02,$06,$04,$0c,$08,$09);
         Data_out2 : Ar_Data = ($10,$30,$20,$60,$40,$c0,$80,$90);

Const     MaxX = 639;
         MaxY = 479;

Var       Gd,gm,i :Integer;
         out,Index,di,offset:Byte;
         st,slt   : integer;
         indexMotor1,indexMotor2,indexMotor3 : Integer;
         checktable : Byte;
         key : char;
         Dx,dy,loop : Integer;
         curxpos,curypos : Integer;
         Bfont : Integer;
         Oldm : point;
         critical : Boolean;

Procedure Update(Var index:Integer;mode:Byte);
Begin
  If Mode = 1 Then
    Begin
      Inc(index);
      If index > 8 Then index := 1;
    End
  Else
    Begin
      Dec(index);
      If index < 1 Then index := 8;
    End;
  End;
End;

procedure Penup;
Var i : Byte;
Begin
  For i := 1 To 50 Do
    Begin
      Port[Pb] := Data_out1[IndexMotor3];
      Update(IndexMotor3,0);
      DELAY(7);
    End;
  End;
End;

Procedure PenDown;

```

```

Var i : Byte;
Begin
  For i := 1 To 50 Do
    Begin
      Port[Pb] := Data_out1[IndexMotor3];
      Update(IndexMotor3,1);
      DELAY(7);
    End;
  Delay(1500);
End;

```

```

Procedure Outtable(m : Point);

```

```

Var
  i : Integer;
  D_out : Byte;
Begin
  If (m.y = 1) And (m.x = 0) Then {dir =1 }
  Begin
    For i := 1 To 5 Do
      Begin
        D_out := Data_out1[indexmotor1] or Data_out2[indexmotor2];
        port[PA] := D_out;
        update(indexmotor1,0);
        delay(3);
      End;
    End Else
    If (m.y = 1) And (m.x = 1) then {dir =2}
    Begin
      For i := 1 To 5 Do
        Begin
          D_out := Data_out1[indexmotor1] or Data_out2[indexmotor2];
          port[PA] := D_out;
          update(indexmotor1,0);
          update(indexmotor2,1);
          delay(3);
        End;
      End Else
      If (m.y = 0) And (m.x = 1) then {dir =3}
      Begin
        For i := 1 To 5 Do
          Begin
            D_out := Data_out1[indexmotor1] or Data_out2[indexmotor2];
            port[PA] := D_out;
            update(indexmotor2,1);
            delay(3);
          End;
        End Else
        If (m.y = -1) And (m.x = 1) then {dir =4}
        Begin
          For i := 1 To 5 Do
            Begin
              D_out := Data_out1[indexmotor1] or Data_out2[indexmotor2];

```



```

Var
  Step,Error,dx,dy,temp : integer;
  mv1,mv2                : point;
  Endoutline : Boolean;
  Check : Byte;
  Label Stop;
Begin
  mv1.x := 1;mv1.y := 1;mv2 := mv1;
  y1 := (479-y1) * 10;y2 := (479-y2) * 10;    { Change Y Coordinate}
  x1 := x1 * 10;x2 := x2 * 10;
  dx := x2-x1;
  dy := y2-y1;
  If (dx < 0) Then Begin
      mv1.x := -1;
      mv2 := mv1;
      dx := -1 *dx;
  End;
  If (dy < 0) Then Begin
      mv1.y := -1;
      mv2 := mv1;
      dy := -1 *dy;
  End;
  If (dx >= dy) Then mv2.y := 0 Else Begin
      mv2.x := 0;
      Temp := dx;
      dx := dy;
      dy := Temp;
  End;

  Step := dx + dy;
  error := -1*dx;
  dx := 2 * dx;
  dy := 2 * dy;
  Endoutline := False;
  critical := False;
  {Putpixel(x1,y1,15);}
Repeat
  If Step = 0 Then Endoutline := True Else
  Begin
    error := error + dy;
    if error > 0 Then
    Begin
      x1 := x1 + Mv1.x;
      y1 := y1 + mv1.y;
      {putpixel(x1,y1,15);}
      outtable(mv1);
      error := error -dx;
      step := Step -2;
    End Else
    Begin
      x1 := x1 + Mv2.x;
      y1 := y1 + mv2.y;
      {putpixel(x1,y1,15);}
      outtable(mv2);
      step := Step -1;
    End;
  End;
End;

```

```

Check := Port[Po];
If Check <> $F0 Then critical := True;
Until Endoutline Or critical;
If critical = True Then outline := Check Else outline := 0;
End;

```

```

Function GetDir(ax,ay:integer):Byte;
{Retrun Direction series point}
{
  8   1   2
   \  |  /
  7 - x - 3
   /  |  \
  6   5   4
}
{ 0 = no series point }

```

```

Var
  N,S,E,W : Boolean;
  aN,aS,aE,aW : Integer;
Begin
  aN := ay + 1;
  aS := ay - 1;
  aE := ax + 1;
  aW := ax - 1;
  If ( aN <= MaxY) Then N := True Else N := False;
  If ( aS >= 0)          Then S := True Else S := False;
  If ( aE <= MaxX)Then E := True Else E := False;
  If ( aW >= 0)          Then W := True Else W := False;

  If ((GetPixel(ax,an) = 2) And N)          Then GetDir := 1 Else
  If (((GetPixel(ae,an) = 2) And N) And E) Then GetDir := 2 Else
  If ((GetPixel(ae,ay) = 2) And E)          Then GetDir := 3 Else
  If (((GetPixel(ae,as) = 2) And E) And S) Then GetDir := 4 Else
  If ((GetPixel(ax,as) = 2) And S)          Then GetDir := 5 Else
  If (((GetPixel(aw,as) = 2) And W) And S) Then GetDir := 6 Else
  If ((GetPixel(aw,ay) = 2) And W)          Then GetDir := 7 Else
  If (((GetPixel(aw,an) = 2) And W) And N) Then GetDir := 8 Else
  GetDir := 0;
End;

```

```

Procedure NewPoint(Var px,py : integer;Dir : Byte);
Begin
  Case Dir Of
    1 : Inc(Py);
    2 : Begin
        Inc(px);inc(py);
      End;
    3 : inc(px);
    4 : Begin
        Inc(px);Dec(py);
      End;
    5 : Dec(py);
    6 : Begin
        Dec(px);Dec(py);
      End;
    7 : dec(px);

```

```

      3 : Begin
          Dec(px);
          inc(py);
      End;
  End;
End;

```

```

Procedure Findline(fx1,fy1: Integer;Var fx2,fy2 : Integer);

```

```

Var

```

```

  Tempfx,Tempfy,num : Integer;
  Endline : Boolean;
  Dir,OldDir      : Byte;

```

```

Begin

```

```

  Tempfx := fx1;
  Tempfy := fy1;
  Endline := False;
  num := 1;
  Repeat
    Dir := GetDir(Tempfx,Tempfy);
    If Dir <> 0 Then
      Begin
        inc(num);
        If num > 2 Then
          Begin
            If Dir = OldDir Then
              Begin
                OldDir := Dir;
                PutPixel(TempFx,TempFy,0);
                NewPoint(TempFx,TempFy,Dir);
              End Else
              Begin
                EndLine := True;
              End;
            End;
          End Else
          Begin
            OldDir := Dir;
            {PutPixel(TempFx,TempFy,0);}
            NewPoint(TempFx,TempFy,Dir);
          End;
        End Else EndLine := True;
      End;
    Until EndLine;
    PutPixel(TempFx,TempFy,0);
    fx2 := Tempfx;
    fy2 := Tempfy;

```

```

End;

```

```

Function MakePCB:Byte;
Var x,y,x2,y2 : Integer;
    xloop,yloop : integer;
    EndSeries,critical : Boolean;
    Test,Lineclose      : Byte;
    label Error;

Begin
    curxpos := 0;curypos := 479;
    PenUp;
    For yloop := MaxY Downto 0 Do
    Begin
        For xloop := 0 To MaxX Do
        Begin
            If GetPixel(xloop,yloop) = 2 Then
            Begin
                x := xloop;y := yloop;
                EndSeries := False;
                critical := false;
                CheckTable := outline(curxpos,curypos,x,y);
                If CheckTable <> 0 Then
                Begin
                    critical := true;
                    Goto Error;
                End;
                PenDown;
                Repeat
                    Delay(200);
                    findline(x,y,x2,y2);
                    checktable := outline(x,y,x2,y2);
                    If CheckTable <> 0 Then
                    Begin
                        critical := True;
                        xloop := maxx;
                        yloop := maxy;
                    End;
                    Test := GetDir(x2,y2);
                    If Test = 0 Then EndSeries := True
                    Else
                    Begin
                        x := x2;y := y2;
                    End;
                Until EndSeries Or critical;
                PenUP;
                curxpos := x2;
                curypos := y2;
            End;
        End;
    End;
    Error:If critical Then Makepcb := 1 Else makepcb := 0;
End;

```

ส่วนของโปรแกรม

Trace.icl

```

Procedure doTrace(x1,y1,x2,y2:Word;Mode:Byte);
Var tx,ty,tc : Integer;
    TD : Byte;
    c1,c2 : Byte;

Function TestAround(x,y:Integer):Byte;
Var top,left,bottom,right:integer;
Begin
    top := y-1;left := x-1;bottom := y+1;right := x+1;
    If (Top >= 0) And (GetPixel(x,y-1) = c2) Then TestARound := 1 Els
    If (Left >= 0) And (GetPixel(x-1,y) = c2) Then TestARound := 1 Els
    If (Bottom <= 479)And (GetPixel(x,y+1) = c2) Then TestARound := 1 Els
    If (right <= 639)And (GetPixel(x+1,y) = c2) Then TestARound := 1 Els
    TestARound := 0;
End;

Begin
Case mode Of
    0 : Begin {detect Outside}
        c1 := 0;
        c2 := 15;
        End;
    1 : Begin {detect Inside}
        c1 := 15;
        c2 := 0;
        End;
End;
For ty := y1 To y2 Do
    For tx := x1 To x2 Do
        Begin
            IF GetPixel(tx,ty) = c1 Then
                Begin
                    td := TestAround(tx,ty);
                    If td <> 0 {= 1} Then PutPixel(tx,ty,Green);
                End;
            End;
        End;
    For ty := 0 To GetMaxy Do
        For tx := 0 To GetMaxX Do
            Begin
                tc := GetPixel(tx,ty);
                If tc = 15 Then PutPixel(tx,ty,0);
            End;
        End;
    End;
End;

```

ส่วนของโปรแกรม

Ptform2.icl

```

Procedure ChangeY(Var Y : Integer);
Begin
  {Y := (YofPlane -Y) Div Divider;}
  Y := ScreenDepth -(Y Div Divider);
End;

```

```

Procedure ChangeX(Var X : Integer);
Begin
  {X := (X-BeginXofPlane) Div Divider;}
  X := ((Xmax - X) + Xmin) Div Divider;
End;

```

```

Function Angel(Slop : Real):Real;
Begin
  If Slop <> 2.0 Then Angel := ArcTan(Slop)*180/Pi
  Else Angel := 90;
End;

```

```

Procedure Track(x1,y1,x2,y2:Integer;Width:integer);
Var
  ac : Integer;
  slop,Ang,Accos,AcSin: Real;
  FT : Array[1..4] Of PointType;
Begin
  Ac := Trunc((Width / 2) / Divider);
  If (x2-x1) <> 0 Then Slop := (y2-y1)/(x2-x1) Else Slop := 2.0;
  Ang := 90-Angel(Slop);
  ChangeY(y1);
  ChangeY(y2);
  ChangeX(x1);
  Changex(x2);
  Accos := Ac*cos(Ang);
  AcSin := Ac*sin(Ang);

  FT[1].x := Trunc((X1+AcCos));
  FT[1].y := Trunc((y1-AcSin));

  FT[2].x := Trunc((x2+AcCos));
  Ft[2].y := Trunc((y2-AcSin));

  FT[3].X := Trunc((x2-AcCos));
  FT[3].y := Trunc((y2+AcSin));

  FT[4].X := Trunc((x1-AcCos));
  Ft[4].y := Trunc((y1+AcSin));

  FillPoly(4,FT);
  FillEllipse(x1,y1,Ac,Ac);FillEllipse(x2,y2,Ac,Ac);
End;

```

```

Procedure Via(x,y,outside,inside : Integer);
Var OutS,InS : Integer;

```

```

Begin
  changeY(y);
  ChangeX(x);
  OutS := Trunc((OutSide/2) / Divider);
  InS := Trunc((InSide/2) / Divider);
  FillEllipse(x,y,outs,outs);
  SetfillStyle(1,0);
  FillEllipse(x,y,ins,ins);
  SetfillStyle(1,15);
End;

```

```

Procedure Fill(x1,y1,x2,y2:Integer);
Begin
  ChangeY(y1);
  ChangeY(y2);
  ChangeX(x1);
  Changex(x2);
  Bar(x1,y1,x2,y2);
End;

```

```

Procedure Pad(x,y,lx,ly,form:Integer);{ No TagetType And Moire Type}

```

```

Var Rx,Ry,xx : Integer;
    Oct : Array[1..8] Of PointType;
Begin
  changeY(Y);
  ChangeX(X);
  Rx := Trunc((lx/2) / Divider);Ry := Trunc((ly /2)/divider);
  Case form Of
    1 : FillEllipse(x,y,rx,ry);
    2 : Bar(x-rx,y-ry,x+rx,y+ry);
    3 : Begin {OctType}
        xx := Trunc((lx / Divider) / 4);
        Oct[1].x := x - xx;
        Oct[1].y := y - ry;

        Oct[2].x := x + xx;
        Oct[2].y := y - rx;

        Oct[3].x := x + rx;
        Oct[3].y := y - xx;

        Oct[4].x := x + rx;
        Oct[4].y := y + xx;

        Oct[5].x := x + xx;
        Oct[5].y := y + rx;

        Oct[6].x := x - xx;
        Oct[6].y := y + rx;

        Oct[7].x := x - rx;
        Oct[7].y := y + xx;

        Oct[8].x := x - rx;
        Oct[8].y := y - xx;
      End;
  End;

```

```
Fillpoly(8,Oct):  
End;  
4 : Begin  
  xx := rx-ry;  
  Bar(x-xx,y-ry,x+xx,y+ry);  
  pieslice(x-xx,y,90,270,ry);  
  pieslice(x+xx,y,0,360,ry);  
End;  
End;  
End;
```

บอลสกรู(Ball screw)

หัวกุดเอ็นมิลล์

คําศัพท์(Data sheet)

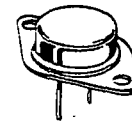
MOTOROLA
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA

PNP
2N5875, 2N5876*
NPN
2N5877, 2N5878*

*Motorola preferred device

10 AMPERE
COMPLEMENTARY SILICON
POWER TRANSISTORS

60-80 VOLTS
150 WATTS



COMPLEMENTARY SILICON
HIGH-POWER TRANSISTORS

... designed for general-purpose power amplifier and switching applications.

- Low Collector-Emitter Saturation Voltage –
 $V_{CE(sat)} = 1.0 \text{ Vdc (Max) @ } I_C = 5.0 \text{ Adc}$
- Low Leakage Current –
 $I_{CEX} = 0.5 \text{ mAdc (Max) @ Rated Voltage}$
- Excellent DC Current Gain –
 $h_{FE} = 20 \text{ (Min) @ } I_C = 4.0 \text{ Adc}$
- High Current Gain – Bandwidth Product –
 $f_T = 4.0 \text{ MHz (Min) @ } I_C = 0.5 \text{ A}$

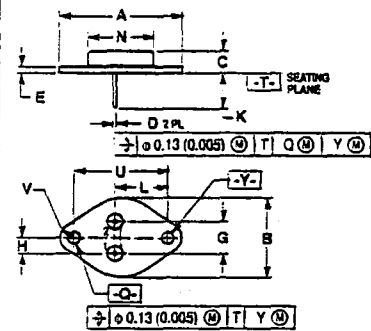
MAXIMUM RATINGS (1)

Rating	Symbol	2N5875 2N5877	2N5876 2N5878	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	80	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CB}	60	30	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EB}		5.0	Vdc
Collector Current – Continuous	I_C	10	20	Adc
Collector Current – Peak				
Base Current	I_B		4.0	Adc
Total Device Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D		150 0.857	Watts W/ $^\circ\text{C}$
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}		-65 to +200	$^\circ\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction to Case	θ_{JC}	1.17	$^\circ\text{C/W}$

(1) Indicates JEDEC Registered Data



- NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1992.
 2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
 3. ALL RULES AND NOTES ASSOCIATED WITH REFERENCED TO-204AA OUTLINE SHALL APPLY.
 4. 001-05 AND -06 OBSOLETE. NEW STANDARD 301-07.

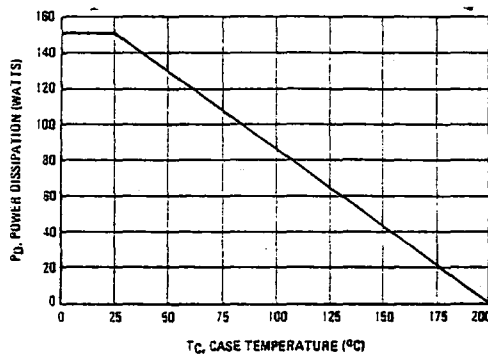
DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	29.27 REF	—	1.150 REF	—
B	—	20.67	—	0.812
C	5.25	5.51	0.207	0.217
D	0.97	1.09	0.038	0.043
E	1.40	1.77	0.055	0.070
G	10.92 BSC	—	0.430 BSC	—
H	5.48 BSC	—	0.215 BSC	—
K	11.18	12.19	0.440	0.480
L	19.83 BSC	—	0.781 BSC	—
M	—	21.09	—	0.830
Q	1.94	4.19	0.076	0.165
U	30.15 BSC	—	1.187 BSC	—
V	3.33	4.77	0.131	0.188

STYLE 1:
PIN 1, BASE
2, EMITTER
CASE, COLLECTOR

CASE 1-07
TO-204AA
(TO-3)

3

FIGURE 1 – POWER DERATING



2N5875, 2N5876 PNP, 2N5877, 2N5878 NPN

*ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Collector-Emitter Sustaining Voltage (1) ($I_C = 200 \text{ mA dc}, I_B = 0$)	$V_{CE(sus)}$	50 80	- -	Vdc
Collector Cutoff Current ($V_{CE} = 30 \text{ Vdc}, I_B = 0$) ($V_{CE} = 40 \text{ Vdc}, I_B = 0$)	I_{CEO}	- -	1.0 1.0	mA dc
Collector Cutoff Current ($V_{CE} = 60 \text{ Vdc}, V_{BE(off)} = 1.5 \text{ Vdc}$) ($V_{CE} = 80 \text{ Vdc}, V_{BE(off)} = 1.5 \text{ Vdc}$) ($V_{CE} = 60 \text{ Vdc}, V_{BE(off)} = 1.5 \text{ Vdc}, T_C = 150^\circ\text{C}$) ($V_{CE} = 80 \text{ Vdc}, V_{BE(off)} = 1.5 \text{ Vdc}, T_C = 150^\circ\text{C}$)	I_{CEX}	- - - -	0.5 0.5 5.0 5.0	mA dc
Collector Cutoff Current ($V_{CB} = 60 \text{ Vdc}, I_E = 0$) ($V_{CB} = 80 \text{ Vdc}, I_E = 0$)	I_{CBO}	- -	0.5 0.5	mA dc
Emitter Cutoff Current ($V_{EB} = 5.0 \text{ Vdc}, I_E = 0$)	I_{EBO}	-	1.0	mA dc

ON CHARACTERISTICS

DC Current Gain (1) ($I_C = 1.0 \text{ A dc}, V_{CE} = 4.0 \text{ Vdc}$) ($I_C = 4.0 \text{ A dc}, V_{CE} = 4.0 \text{ Vdc}$) ($I_C = 10 \text{ A dc}, V_{CE} = 4.0 \text{ Vdc}$)	h_{FE}	35 20 4.0	- 100 -	-
Collector-Emitter Saturation Voltage (1) ($I_C = 5.0 \text{ A dc}, I_B = 0.5 \text{ A dc}$) ($I_C = 10 \text{ A dc}, I_B = 2.5 \text{ A dc}$)	$V_{CE(sat)}$	- -	1.0 3.0	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage (1) ($I_C = 10 \text{ A dc}, I_B = 2.5 \text{ A dc}$)	$V_{BE(sat)}$	-	2.5	Vdc
Base-Emitter On Voltage (1) ($I_C = 4.0 \text{ A dc}, V_{CE} = 4.0 \text{ Vdc}$)	$V_{BE(on)}$	-	1.5	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Current-Gain - Bandwidth Product (2) ($I_C = 0.5 \text{ A dc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}, f_{test} = 1.0 \text{ MHz}$)	f_T	4.0	-	MHz
Output Capacitance ($V_{CB} = 10 \text{ Vdc}, I_E = 0, f = 1.0 \text{ MHz}$)	C_{ob}	- -	500 300	pF
Small-Signal Current Gain ($I_C = 1.0 \text{ A dc}, V_{CE} = 4.0 \text{ Vdc}, f = 1.0 \text{ kHz}$)	h_{fe}	20	-	-

SWITCHING CHARACTERISTICS

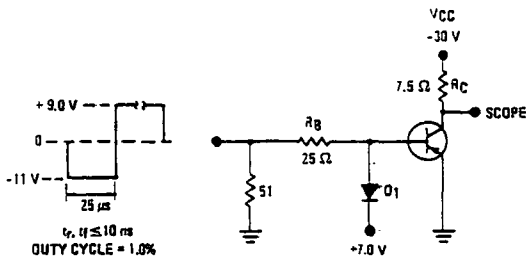
Rise Time	t_r	-	0.7	μs
Storage Time	t_s	-	1.0	μs
Fall Time	t_f	-	0.8	μs

*Indicates JEDEC Registered Data.

(1) Pulse Test: Pulse Width $\leq 300 \mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2.0\%$.

(2) $f_T = |h_{fe}| \cdot f_{test}$

FIGURE 2 - SWITCHING TIME TEST CIRCUIT

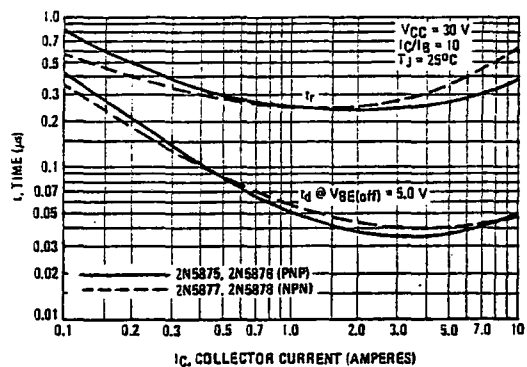


FOR CURVES OF FIGURES 3 and 6,
 R_B and R_C ARE VARIED TO OBTAIN
DESIRED CURRENT LEVELS

- For NPN test circuit,
reverse all polarities.

D_1 MUST BE FAST RECOVERY TYPE, eg:
1N5825 USED ABOVE $I_B = 100 \text{ mA}$
MSD8100 USED BELOW $I_B = 100 \text{ mA}$

FIGURE 3 - TURN-ON TIME



2N5875, 2N5876 PNP, 2N5877, 2N5878 NPN

FIGURE 4 - THERMAL RESPONSE

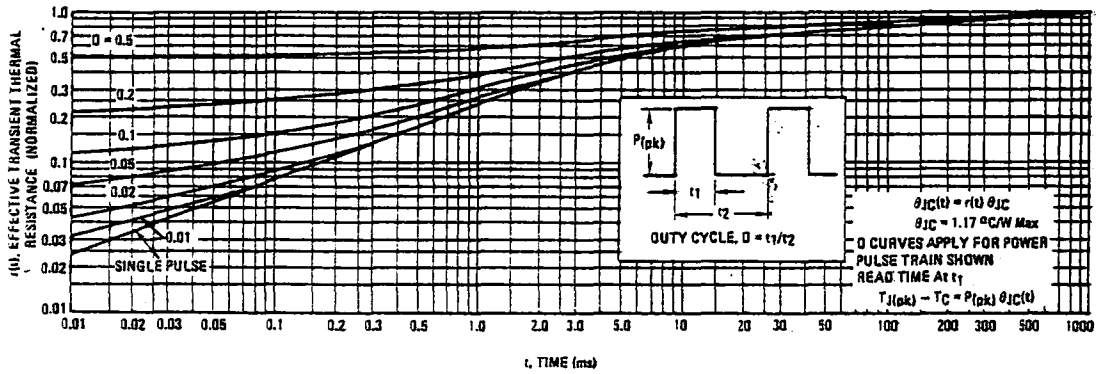
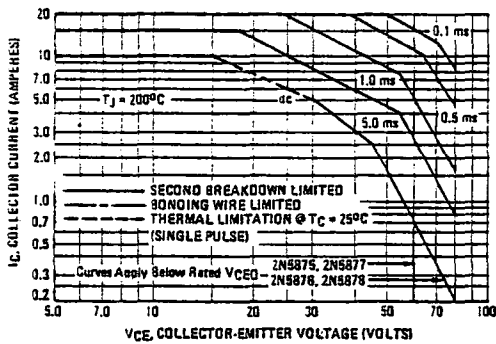


FIGURE 5 - ACTIVE REGION SAFE OPERATING AREA



There are two limitations on the power handling ability of a transistor: average junction temperature and second breakdown. Safe operating area curves indicate $I_C - V_{CE}$ limits of the transistor that must be observed for reliable operation, i.e., the transistor must not be subjected to greater dissipation than the curves indicate.

The data of Figure 5 is based on $T_{J(pk)} = 200^\circ\text{C}$; T_C is variable depending on conditions. Second breakdown pulse limits are valid for duty cycles to 10% provided $T_{J(pk)} < 200^\circ\text{C}$. $T_{J(pk)}$ may be calculated from the data in Figure 4. At high case temperatures, thermal limitations will reduce the power that can be handled to values less than the limitations imposed by second breakdown.

3

FIGURE 6 - TURN-OFF TIME

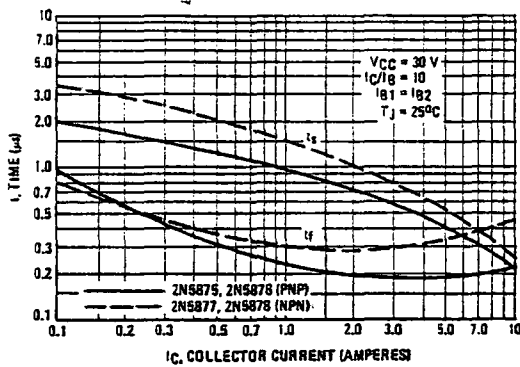
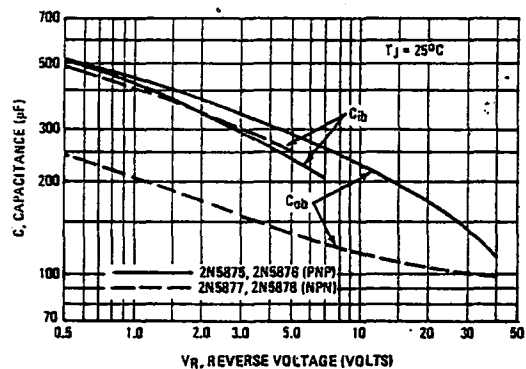


FIGURE 7 - CAPACITANCE



2N5875, 2N5876: PNP; 2N5877, 2N5878: NPN

FIGURE 4 — THERMAL RESPONSE

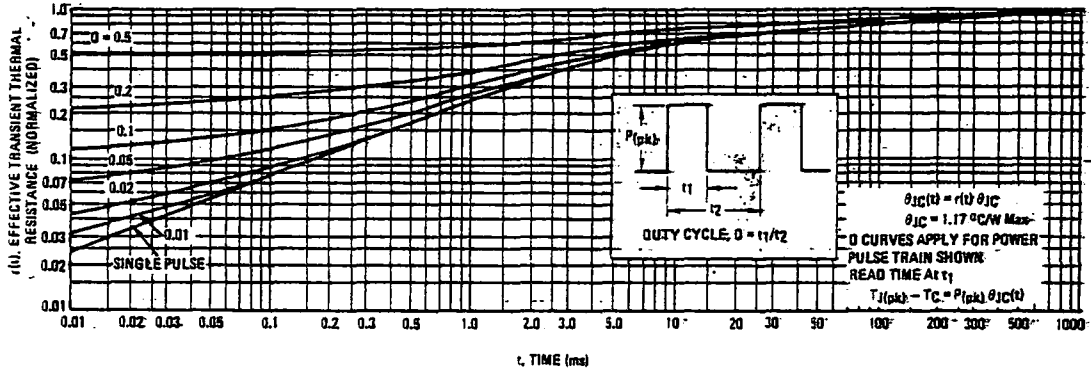
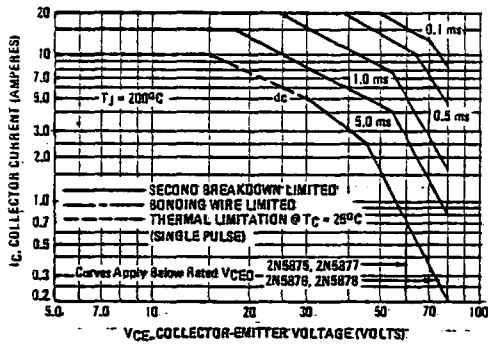


FIGURE 5 — ACTIVE REGION SAFE OPERATING AREA



There are two limitations on the power handling ability of a transistor: average junction temperature and second breakdown. Safe operating area curves indicate $I_C - V_{CE}$ limits of the transistor that must be observed for reliable operation, i.e., the transistor must not be subjected to greater dissipation than the curves indicate.

The data of Figure 5 is based on $T_J(pk) = 200^\circ\text{C}$; T_C is variable depending-on conditions. Second-breakdown pulse limits are valid for duty cycles to 10% provided $T_J(pk) < 200^\circ\text{C}$; $T_J(pk)$ may be calculated from the data in Figure 4. At high case temperatures, thermal limitations will reduce the power that can be handled to values less than the limitations imposed by second breakdown.

3

FIGURE 6 — TURN-OFF TIME

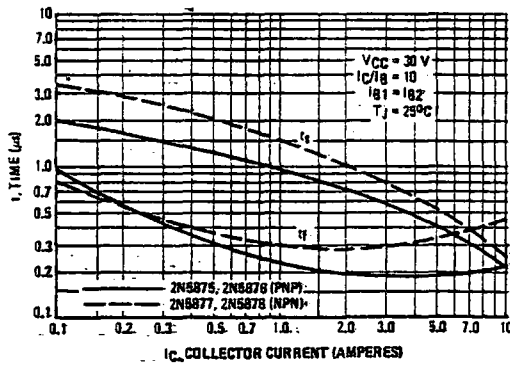
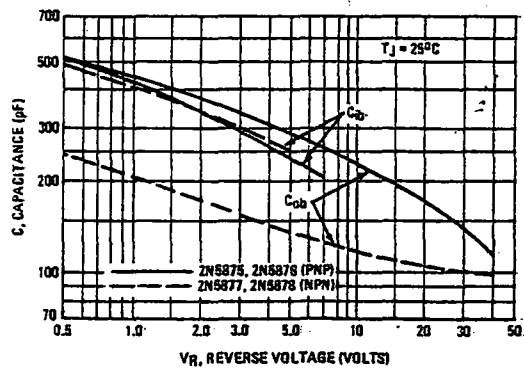


FIGURE 7 — CAPACITANCE



Operation

Level sync signal is fed to pin 7, the negative edge sets the RS flipflop, via the trigger/monoflop combination, provided that the voltage at pin 4 is below the nominal value at pin 8. As in the free-running operation mode, the relevant output transistors become conducting. Similarly they are cut off by resetting the RS flipflop once the voltage at pin 4 is higher than the nominal value at pin 8.

Pulse Suppression

In all cases the pulse suppression circuit eliminates positive pulses, typically of 0.5 μ s duration, at pin 4. These can result from cross-over currents in chopper operation through the integrated free-wheel diodes. As a result, the voltage at pin 4 rises well above the nominal value, and without pulse suppression this would lead to dynamic current limiting. The duration of these basically unavoidable cross-over currents is of the same order of magnitude as the reverse-recovery time of the free-wheel diodes.

Temperature Safeguard

When the temperature of the IC rises to approx. 150°C, the final stages are turned off. At approx. 130°C they are turned on again.

Logic Table

enable		L	L	H	H
phase		L	H	L	H
Output	Q1	/	/	L	H
Output	Q2	/	/	H	L
transistor	T1	X	X	X	..
transistor	T2	X	X	..	X
transistor	T3	X	X	..	X
transistor	T4	X	X	X	..

at:
 $V_i > 10 \text{ mV}$
 $R_i > 0 \Omega$

- Low voltage level, input open
- High voltage level
- Transistor turned off
- Transistor conducting
- Transistor conducting with current limiting turned on
- Output high-impedance

Maximum Ratings

$T_C = -25^\circ\text{C}$ to $+85^\circ\text{C}$

Description	Symbol	min	max	Unit
Supply voltage, pin 5	V_S	-0.3	45	V
Supply current, pin 5	I_S	0	2.5	A
Peak current in output transistors, pin 1, 9	I_O	-2.5	2.5	A

Diode currents

Diode to $+V_S$	I_{IH}		2.5	A
Diode to ground	I_{IL}		2.5	A
Input voltage, pins 2, 3, 7, 8	V_i	-0.3	6	V
Output current, pin 4	I_A	-2.5		A
Voltage, pin 4	V_A	-0.3	6	V
Ground current, pin 6	I_0		2.5	A
Junction temperature	T_j		150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-40	125	$^\circ\text{C}$
Thermal resistance system - ambient	$R_{th \text{ SA}}$		70	K/W
Thermal resistance system - case	$R_{th \text{ JC}}$		8	K/W

Operating Range

Supply voltage, pin 5	V_S	0	40	V
Package temperature	T_C	-25	85	$^\circ\text{C}$
Input voltage, pins 2, 3, 7	V_i		5	V
Output current	I_O	-2	2	A

Characteristics
 $T_C = 25^\circ\text{C}$

Description	Symbol	Test conditions	min	typ	max	Unit
Supply current, pin 5	I_S	$V_{D3} = V_{D4}$		10	30	mA
Supply current, pin 5	I_S	$V_{D3} = V_{D4}$		0.5	1	mA
Output characteristics, pins 1, 9						
Output voltage, source	V_{OH}	$I_{O1} = 1\text{A}$		1.7	1.9	V
Output voltage, source	V_{OH}	$I_{O1} = 1.5\text{A}$		1.9	2.1	V
Output voltage, sink	V_{OL}	$I_{O1} = 1\text{A}$		1.2	1.4	V
Output voltage, sink	V_{OL}	$I_{O1} = 1.5\text{A}$		1.5	1.7	V
Output current	I_{O1}				300	mA
Propagation delay	t_p	Figure 1	0.1	0.3	1.0	μs
Forward voltage of diodes	V_{FH}	$I_{FH} = 1\text{A}$		1.0	1.2	V
Reverse voltage of diodes	V_{FL}	$I_{FL} = 1.5\text{A}$		1.1	1.3	V
Forward voltage of diodes	V_{FL}	$I_{FL} = 1\text{A}$		1.1	1.3	V
Reverse voltage of diodes	V_{FL}	$I_{FL} = 1.5\text{A}$		1.3	1.5	V
Timing characteristics, pin 8						
Propagation delay, pin 2	t_{p2}		2			V
Output voltage	V_{L2}				0.8	V
Supply current	I_{S2}	$V_{L2} = 5\text{V}$		50	100	μA
Supply current	$-I_{S2}$	$V_{L2} = 0\text{V}$			100	μA
Fall time	t_{f2}				2	μs
Input characteristics, pin 8						
Input voltage	V_{i8}	$V_{i8} = 0\text{V}$	0		2	V
Input current	$-I_{i8}$	Figure 5			5	μA
Input voltage	$V_{i8,4}$		0			mV
Input characteristics, pin 4						
Input voltage	V_{i4}	Figure 5	0		2	V
Input current	I_{i4}	Figure 3		2	3	μs
Timing characteristics, pin 7						
Frequency	f	Duty cycle: 0.5	1		100	kHz
Period	D	$f = 40\text{kHz}$	0.1		0.9	
Input current	I_{i7}				2	μs
Output current, pin 7	$-I_{O7}$		1.2	1.6	2.0	mA
Output voltage, pin 7	V_{O7}	Figure 2		0.6	0.6	V
Output current	I_{O7}		2.2	2.4		V
Output current	I_{O7}	Figure 4		0.4		μs
Output resistance	R_{O7}	$V_{O7} = 1.5\text{V}$		1		k Ω

Maximum Ratings
 $T_C = 25^\circ\text{C}$ bis $+05^\circ\text{C}$

Description	Symbol	min	max	Unit
Supply voltage, pin 5	V_B	-0.3	45	V
Supply current, pin 5	I_S	0	1.25	A
Peak current in output transistors, pins 1, 9	I_O	-1.25	1.25	A
Diode currents, pins 1, 9				
Diode against $+V_S$	I_{FH}		1.25	A
Diode against ground	I_{FL}		1.25	A
Input voltage, pins 2, 3, 7, 8	V_i	-0.3	6	V
Output current, pin 4	I_4	-1.25		A
Voltage, pin 4	V_4	-0.3	6	V
Ground current, pin 6	I_6		1.25	A
Junction temperature	T_j		150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-40	125	$^\circ\text{C}$
Thermal resistance system - ambient	$R_{th, \mu A}$		70	K/W
Thermal resistance system - case (measured at pin 14)	$R_{th, EC}$		15	K/W
Operating Range				
Supply voltage, pin 5	V_B	0	40	V
Package temperature measured at pin 14	T_C	-25	85	$^\circ\text{C}$
Input voltage, pins 2, 3, 7	V_i		6	V
Output current, pins 1, 9	I_O	-1	1	A

100 ns
 $V_i, T_c = 25^\circ\text{C}$

Description	Symbol	Test conditions	min	typ	max	Unit
Supply current, pin 5	I_{S1}	$V_{i3} = V_{i11}$		18	30	mA
Supply current, pin 5	I_{S2}	$V_{i3} = V_{iL}$		0.5	1	mA

Output, pins 1, 9

Description	Symbol	Test conditions	min	typ	max	Unit
Output voltage: source	V_{OH}	$I_{OL} = 0.5\text{ A}$		1.6	1.8	V
Output voltage: source	V_{OH}	$I_{OL} = 0.75\text{ A}$		1.65	1.90	V
Output voltage: sink	V_{OL}	$I_{OL} = 0.5\text{ A}$		1.0	1.2	V
Output voltage: sink	V_{OL}	$I_{OL} = 0.75\text{ A}$		1.1	1.4	V
Reverse current	I_{OS1}				300	μA
Phase dead time	t_f	Figure 1	6.1	0.3	1.0	μs
Forward voltage of diodes to +V _S	V_{FH}	$I_{FH} = 0.5\text{ A}$		0.9	1.1	V
Forward voltage of diodes to ground	V_{FL}	$I_{FL} = 0.75\text{ A}$		0.95	1.15	V
Forward voltage of diodes to ground	V_{FL}	$I_{FL} = 0.5\text{ A}$		0.95	1.15	V
Forward voltage of diodes to ground	V_{FL}	$I_{FL} = 0.75\text{ A}$		1.0	1.2	V

Inputs: enable, pin 3 and phase, pin 2

Description	Symbol	Test conditions	min	typ	max	Unit
H input voltage	V_{IH}		2			V
L input voltage	V_{IL}			50	0.8	V
H input current	I_{IH}	$V_{IH} = 5\text{ V}$			100	μA
L input current	$-I_{IL}$	$V_{IL} = 0\text{ V}$			100	μA
Rise and fall time	t_r, t_f				2	μs

Nominal current, pin 8

Description	Symbol	Test conditions	min	typ	max	Unit
Control range	V_{i8}	$V_{i8} = 0\text{ V}$	0		2	V
Input current	$-I_{i8}$	Figure 5			5	μA
Input offset voltage	$V_{i(b-4)}$	Figure 5		0		mV

Actual current, pin 4

Description	Symbol	Test conditions	min	typ	max	Unit
Regulating range	V_{i4}	Figure 5	0		2	V
Turn-off delay	t_D	Figure 3		2	3	μs

Sync Input/R_C, pin 7

Description	Symbol	Test conditions	min	typ	max	Unit
Sync frequency	f	Duty cycle: 0.5	1		100	kHz
Duty cycle	D	$f = 10\text{ kHz}$	0.1		0.9	
Rise and fall time	t_r, t_f				2	μs
Output current, pin 7	$-I_{O7}$	Figure 2	1.2	1.6	2.0	mA
Trigger threshold, pin 7	V_{L7}			0.6	0.8	V
Charging limit C ₇	V_{C7}		2.2	2.4		V
Off period	t_{OFF}	Figure 4		64		μs
Dynamic input resistance, pin 7	R_{i7}	$V_i = 1.5\text{ V}$		1		k Ω

Internal Wiring of Pins

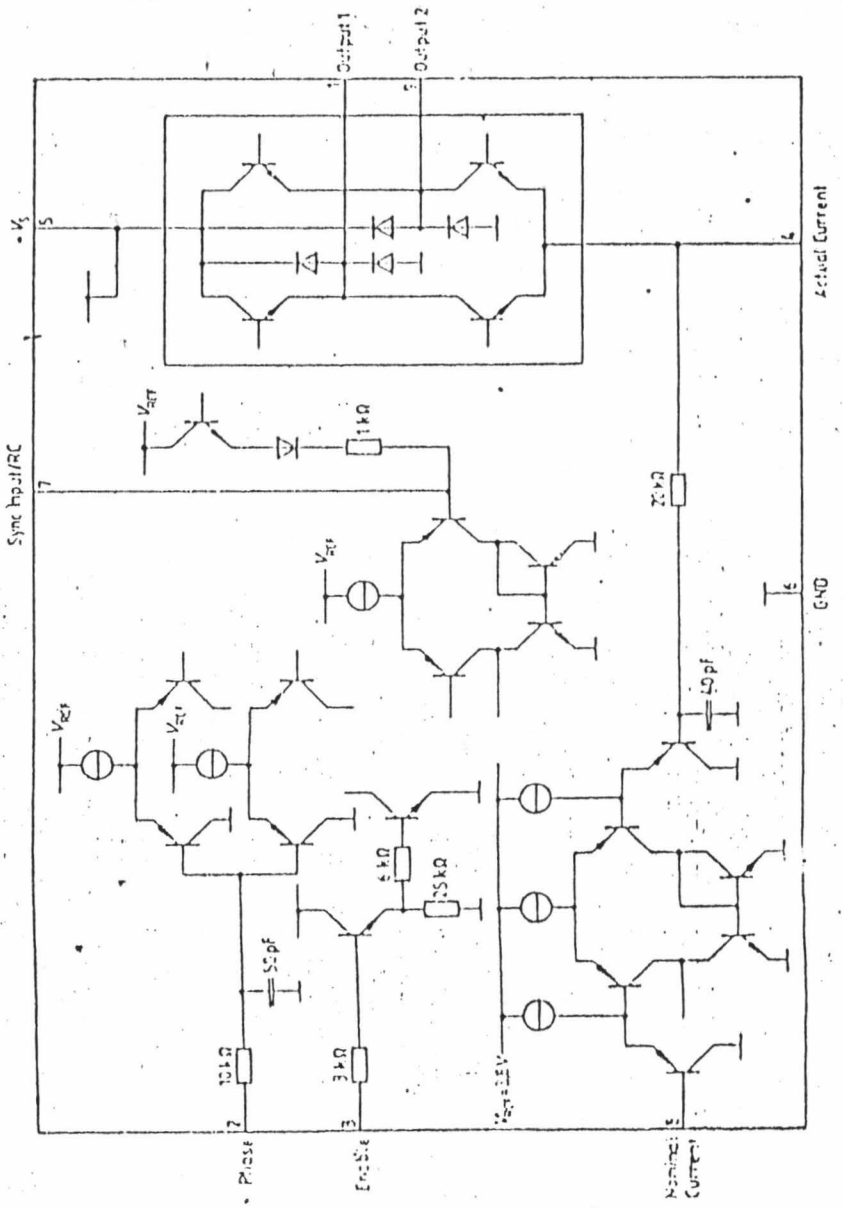


Figure 2

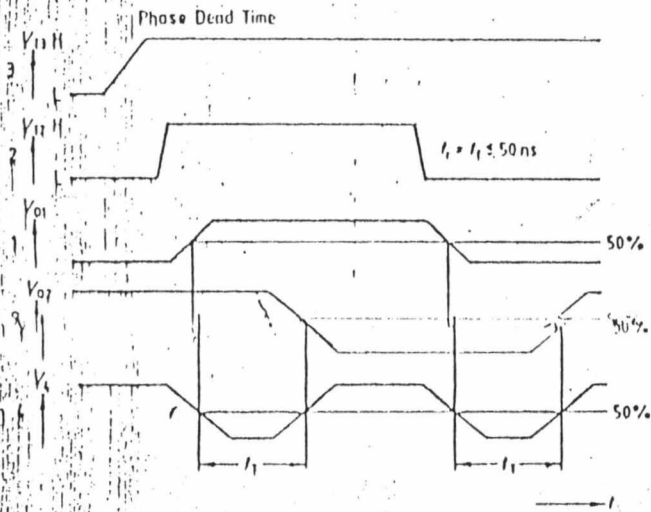


Figure 2
Upper Threshold

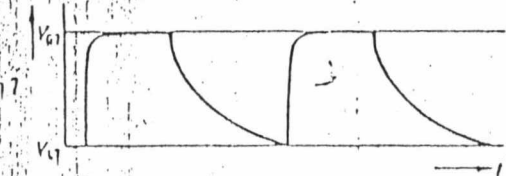


Figure 3
Turn-OFF Delay

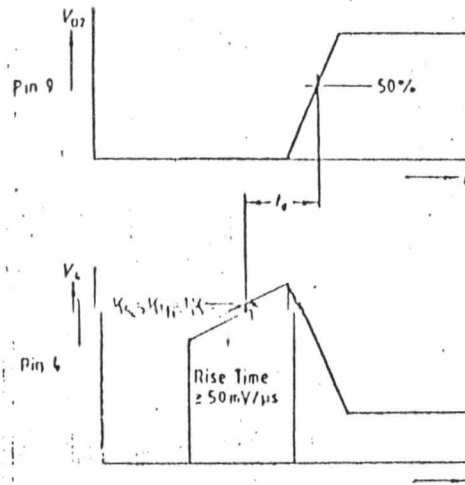
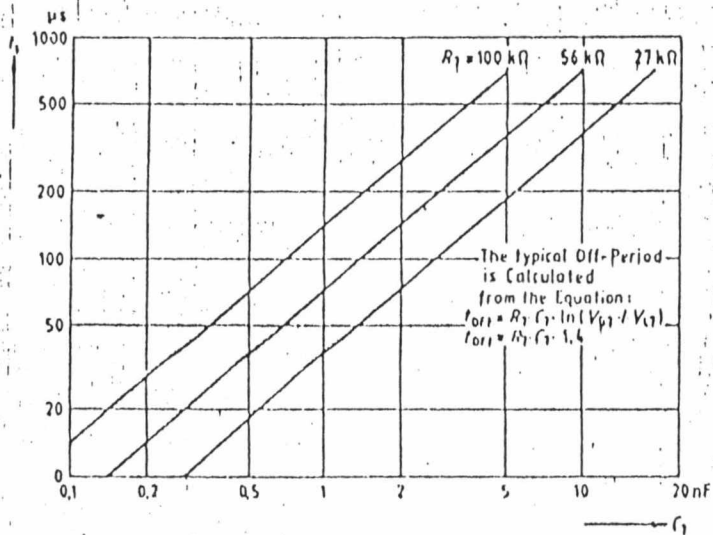
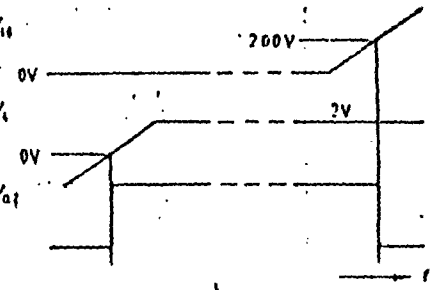


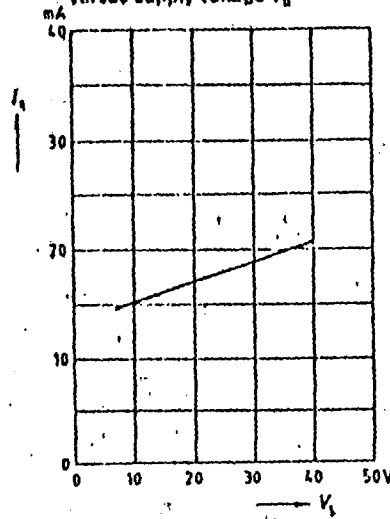
Figure 4
OFF Period versus Capacitance



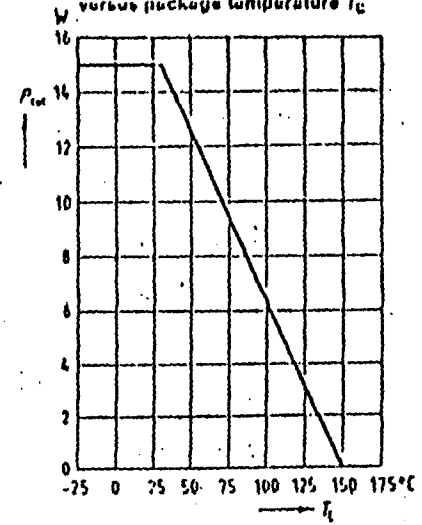
Range, Input Offset Voltage



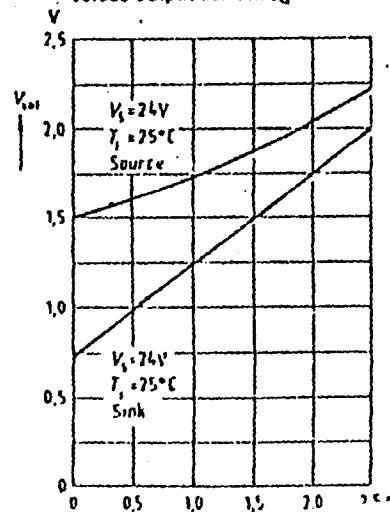
Quiescent current I_Q versus supply voltage V_S



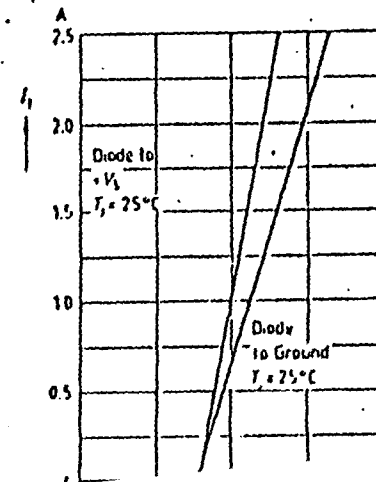
Permissible power dissipation P_{Tot} versus package temperature T_C



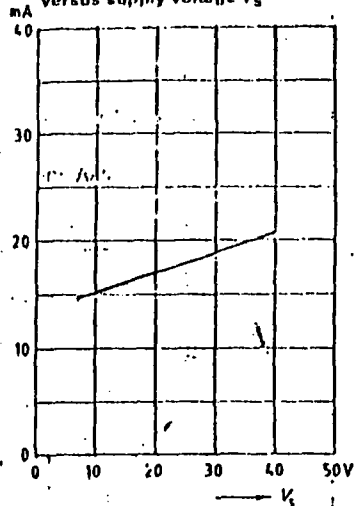
Output saturation voltages V_{sat} versus output current I_O



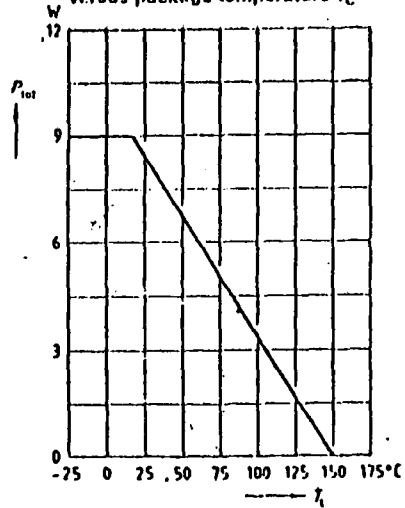
Forward current I_f of free-wheel diodes versus forward voltages V_f



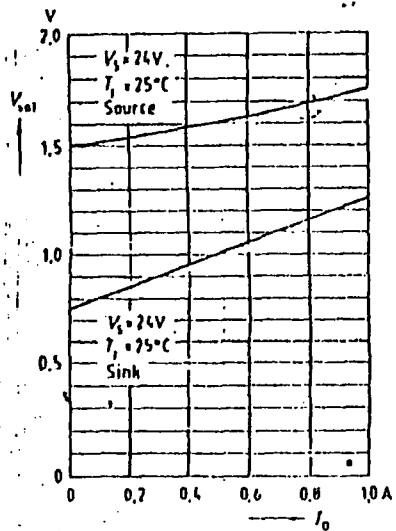
Quiescent current I_Q versus supply voltage V_S



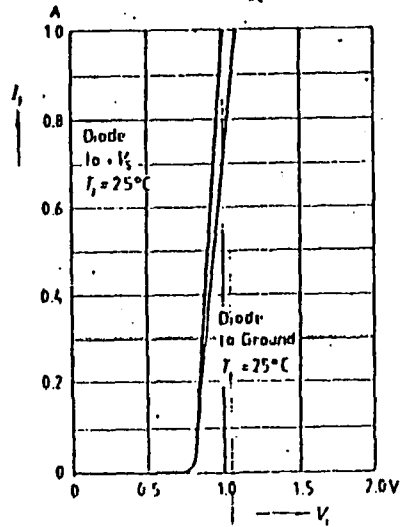
Permissible power dissipation P_{tot} versus package temperature T_c



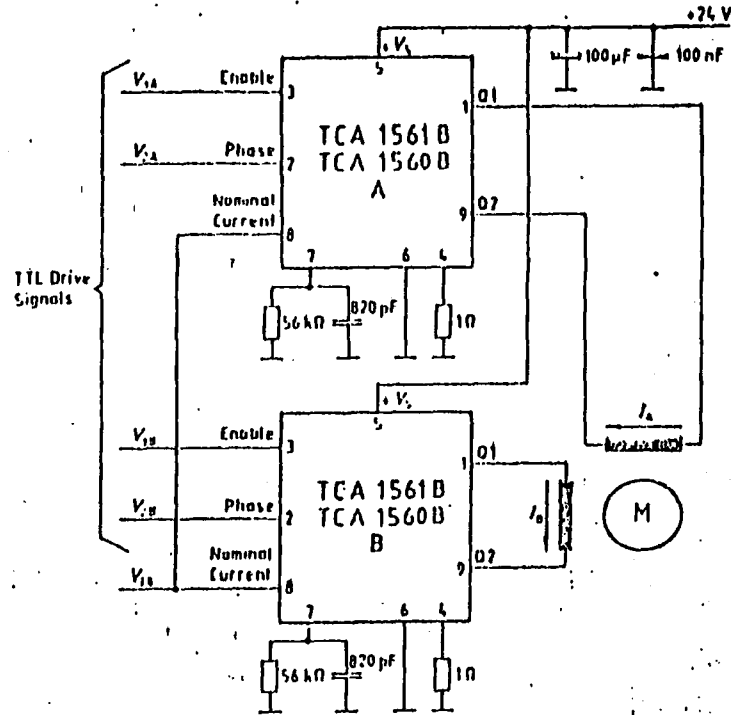
Output saturation voltages V_{sat} versus output current I_O



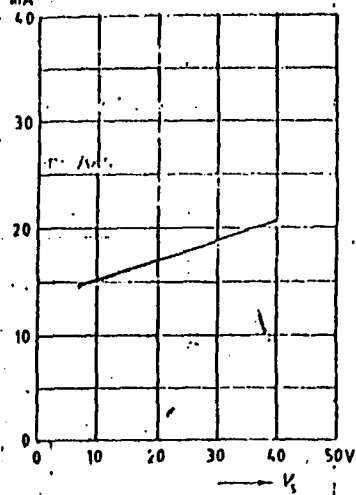
Forward current I_F of free-wheel diodes versus forward voltage V_F



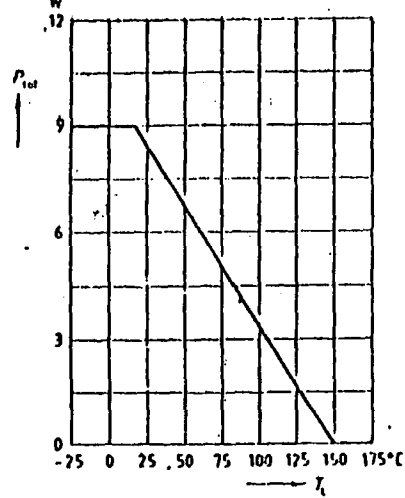
Application Circuit



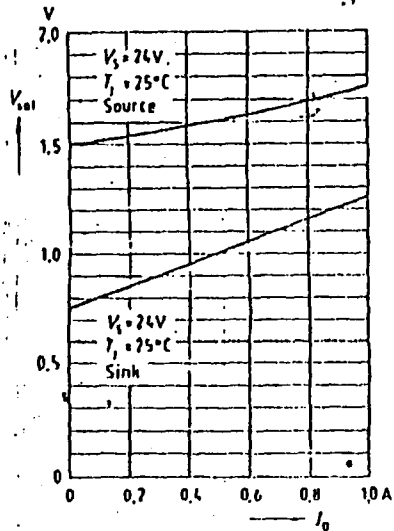
Quiescent current I_q versus supply voltage V_s



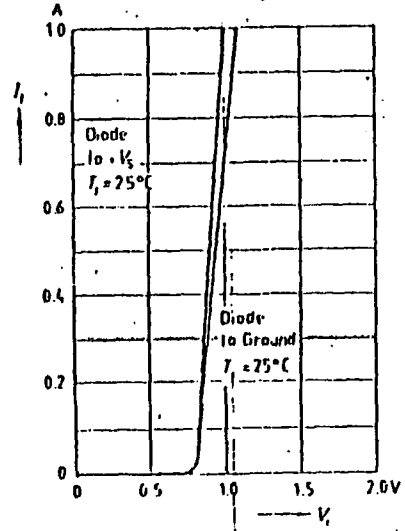
Permissible power dissipation P_{tot} versus package temperature T_c



Output saturation voltages V_{sat} versus output current I_o



Forward current I_f of free-wheel diodes versus forward voltage V_f



Application Circuit

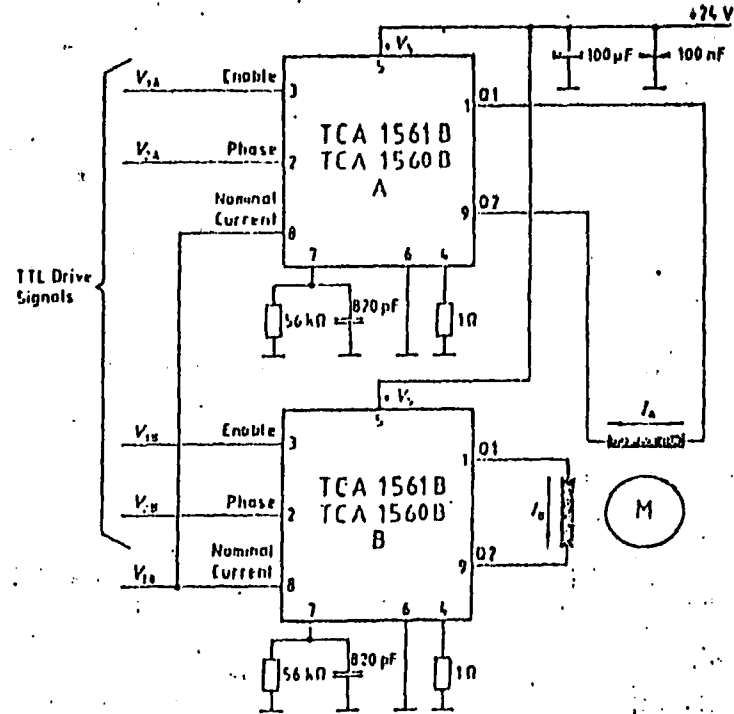
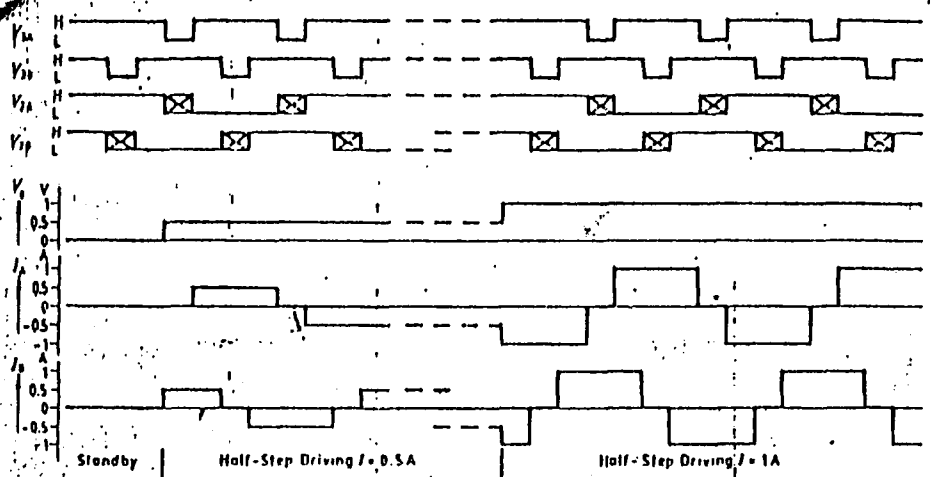


Diagram for Application Circuit



Calculation of Power Dissipation

The total power dissipation P_{tot} comprises

- Saturation losses P_{sat} (transistor saturation voltage and diode forward voltages)
- Quiescent current losses P_q (quiescent current multiplied by supply voltage)
- Switching losses P_s (turn-on/turn-off operation)

The following equations give the power dissipation for chopper operation without phase reversal. This can be regarded as "worst case", as, in addition to the switching losses, full-load current flows for the entire time.

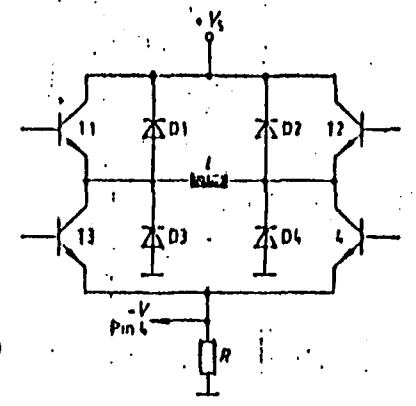
$$P_{tot} = P_{sat} + P_q + P_s$$

with $P_{sat} \approx I_H |V_{satw} \cdot D + V_{fD} (1 - D) + V_{satw}|$

$$P_q = I_q \cdot V_s$$

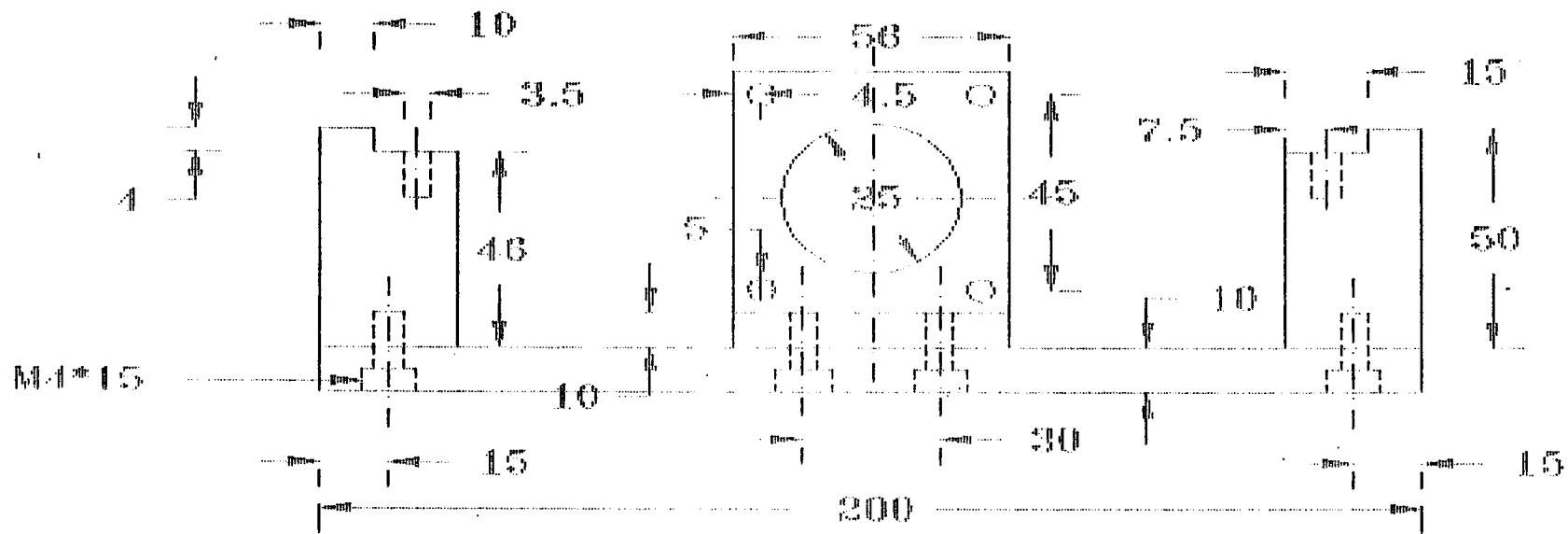
$$P_s \approx \frac{V_s}{T} \left\{ \frac{I_H \cdot t_{on}}{2} + \frac{(I_H + I_R) t_{off}}{4} + \frac{I_H}{2} (t_{on} + t_{off}) \right\} I_H$$

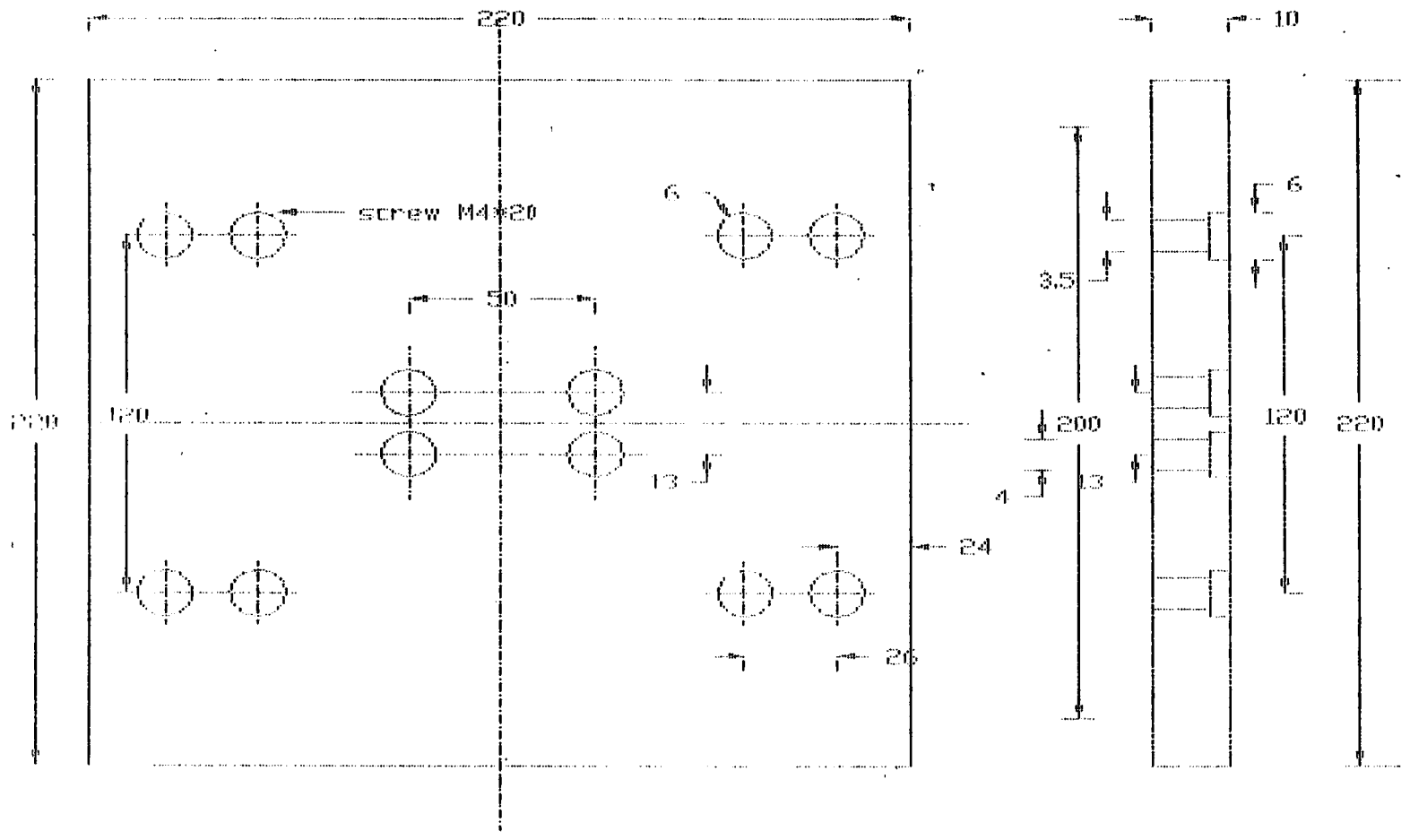
- I_H = Rated current (mean value)
- I_q = Quiescent current
- I_R = Reverse current during turn-on delay time
- I_P = Peak reverse current
- I_D = Conducting time of chop transistor
- t_{on} = Turn-on time
- t_{off} = Turn-off time
- t_{on} = Turn-on delay time
- t_{off} = Turn-off delay time
- T = Cycle duration
- D = Duty cycle I_D/T
- V_{satw} = Saturation voltage of sink transistor (T3, 4)
- V_{satw} = Saturation voltage of source transistor (T1, 2)
- V_{fD} = Forward voltage of free-wheel diode (D1, 2)
- V_s = Supply voltage

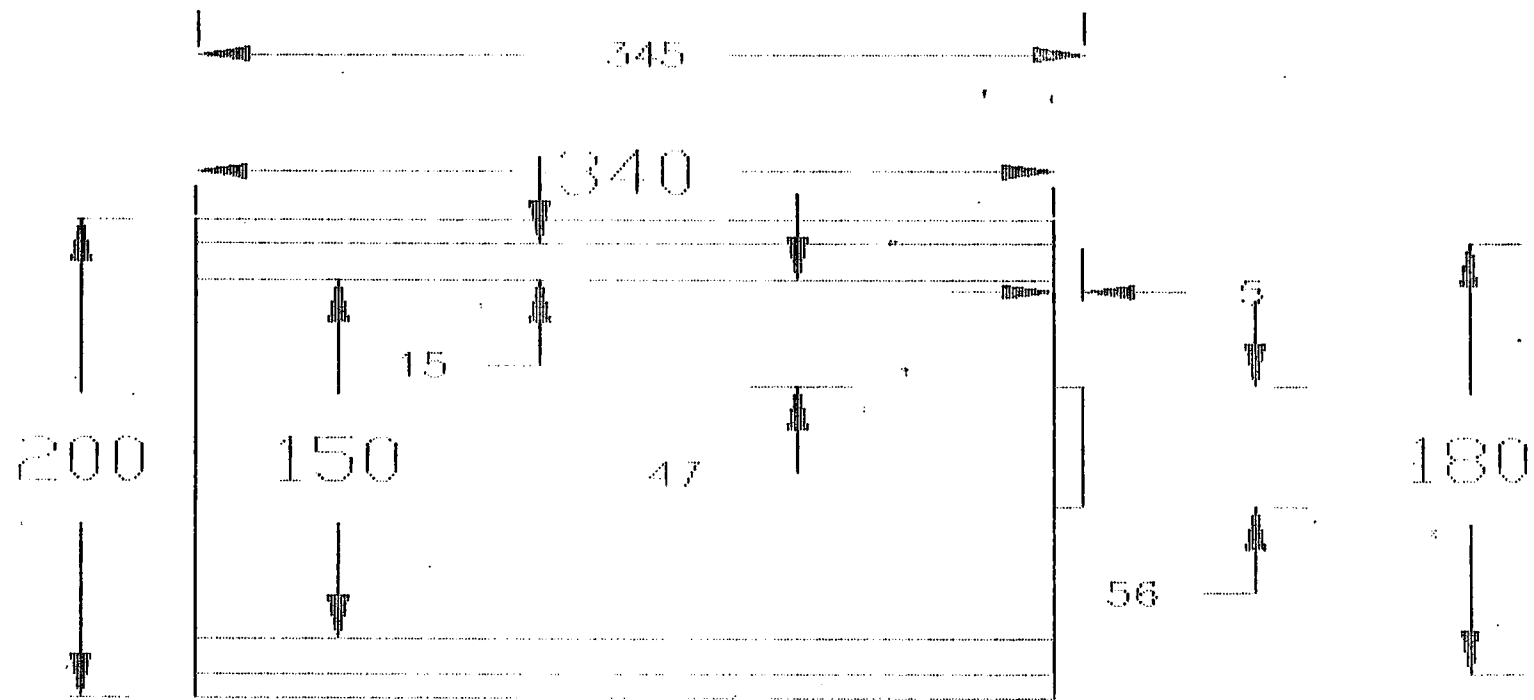


XXXXXXXX XYZ-TABLE

front view

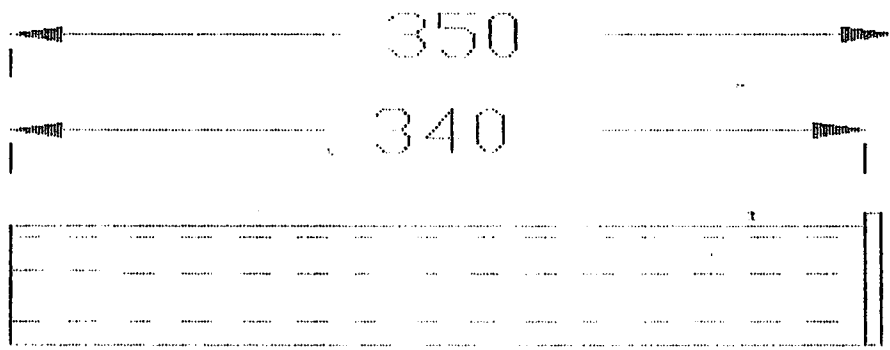
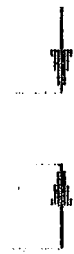






top view

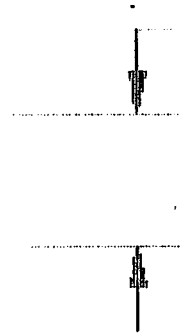
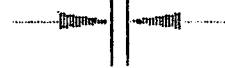
30



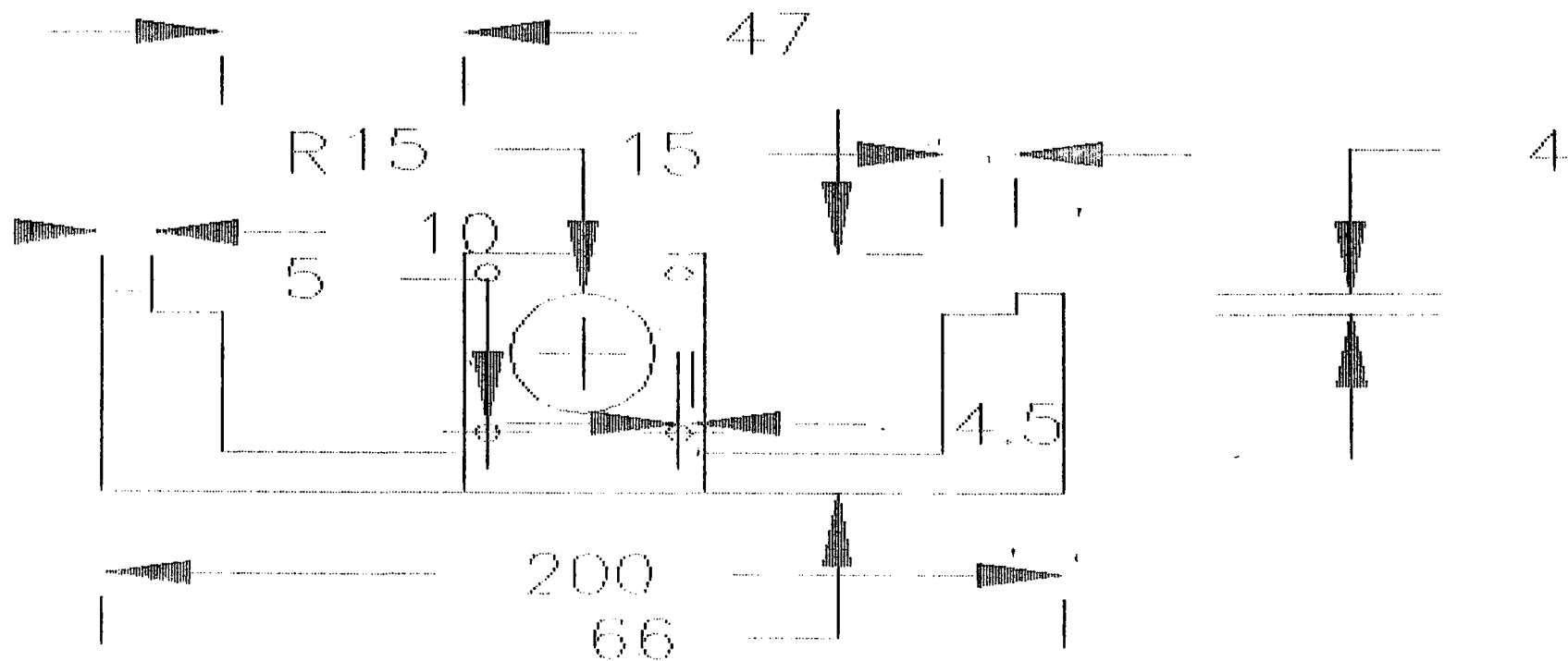
350

340

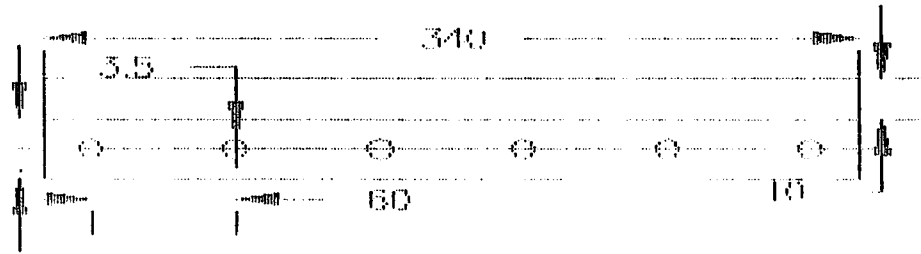
5



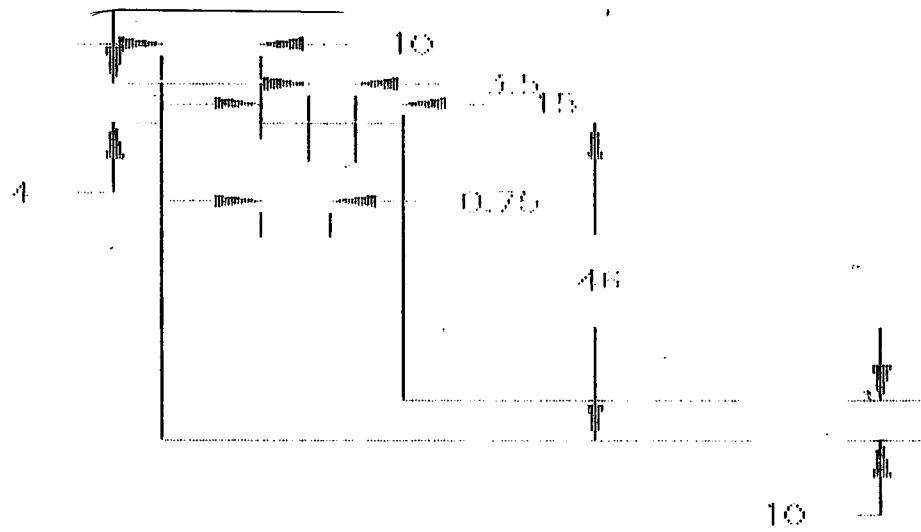
56

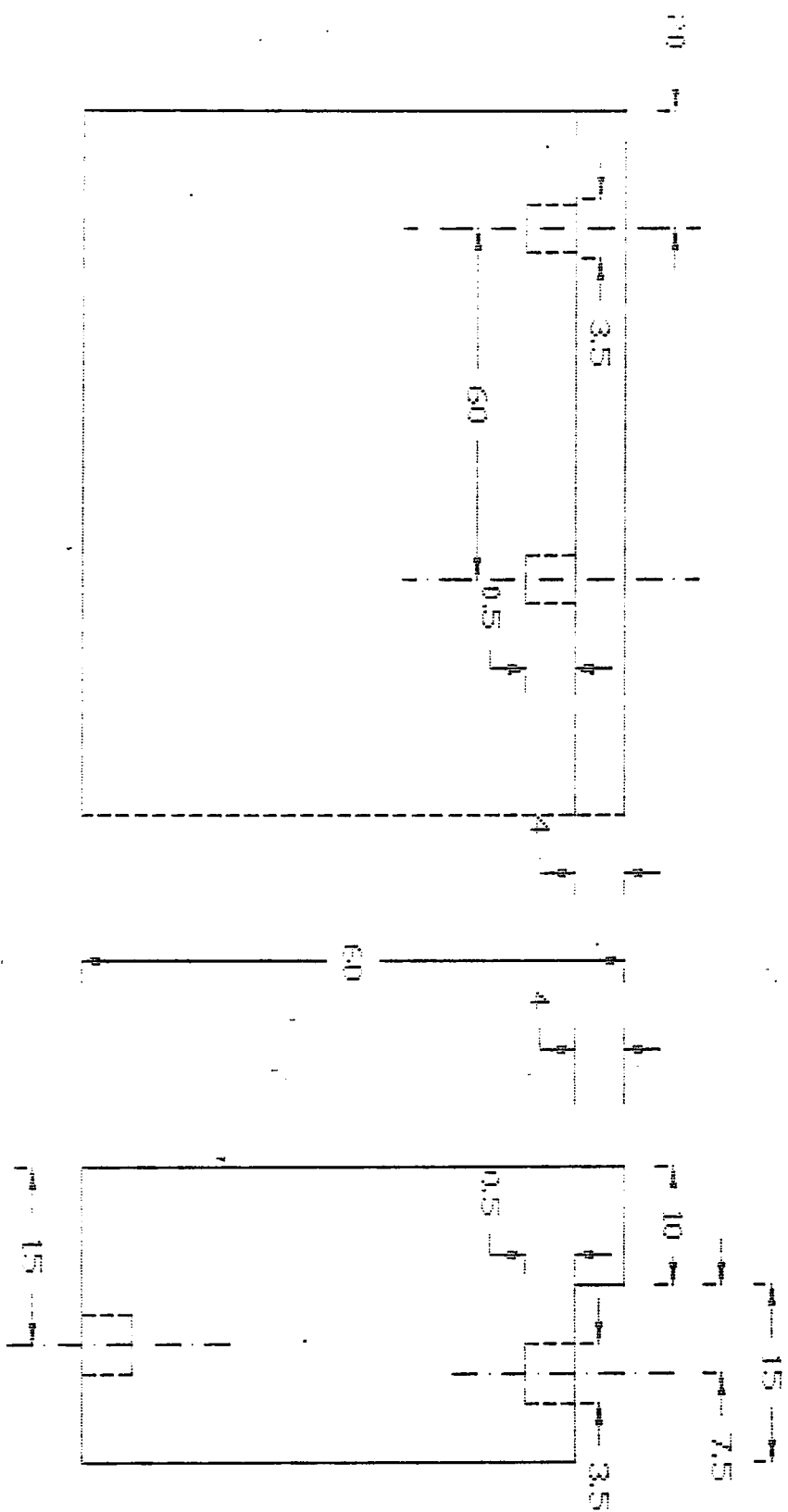


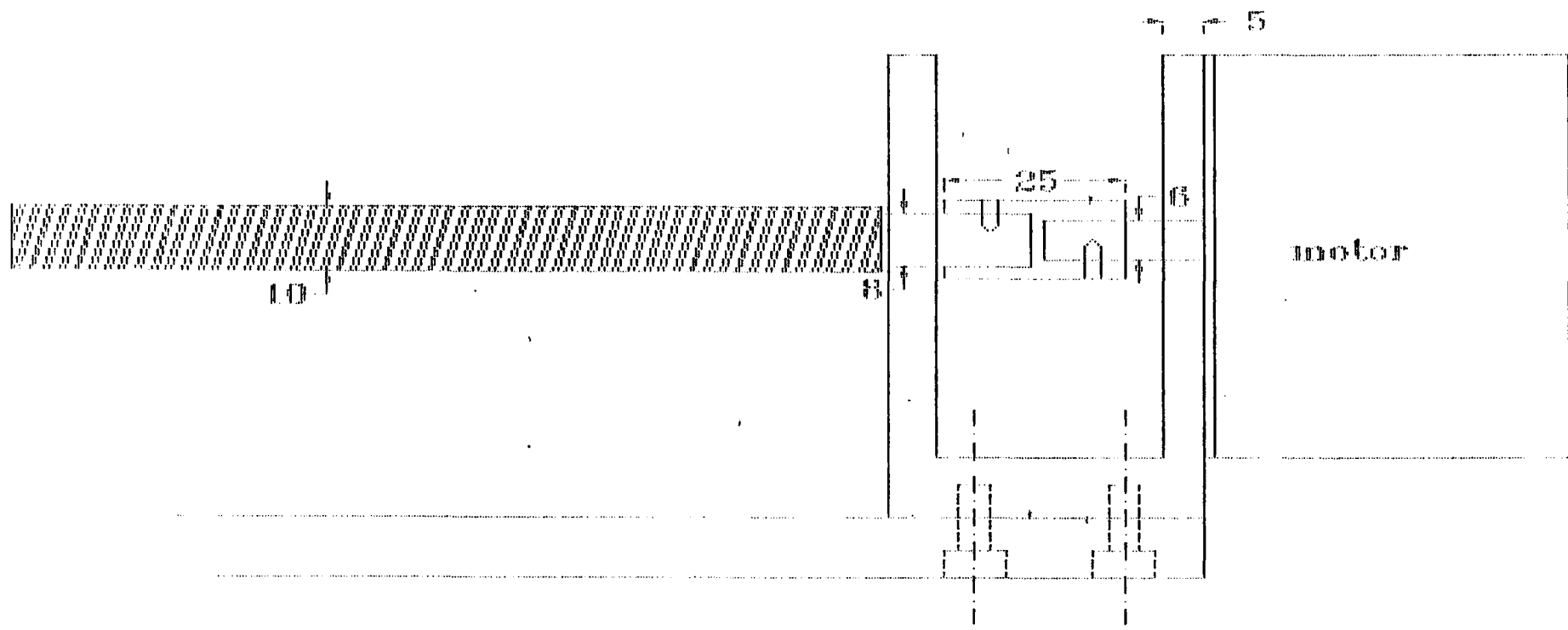
front view

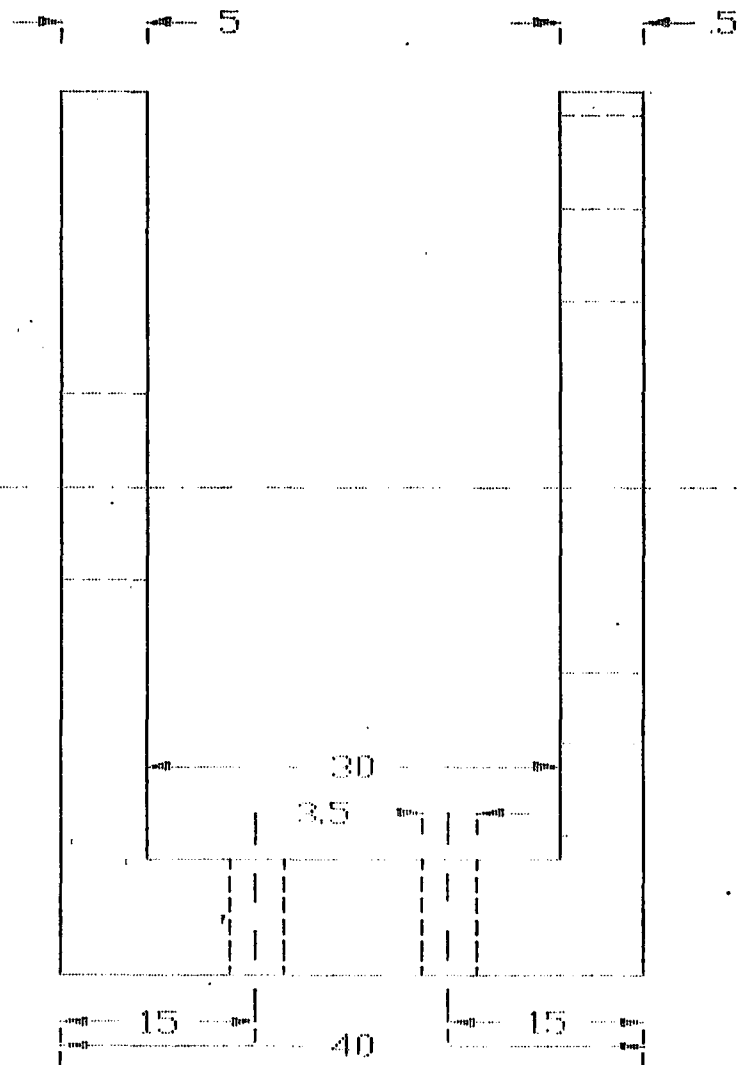
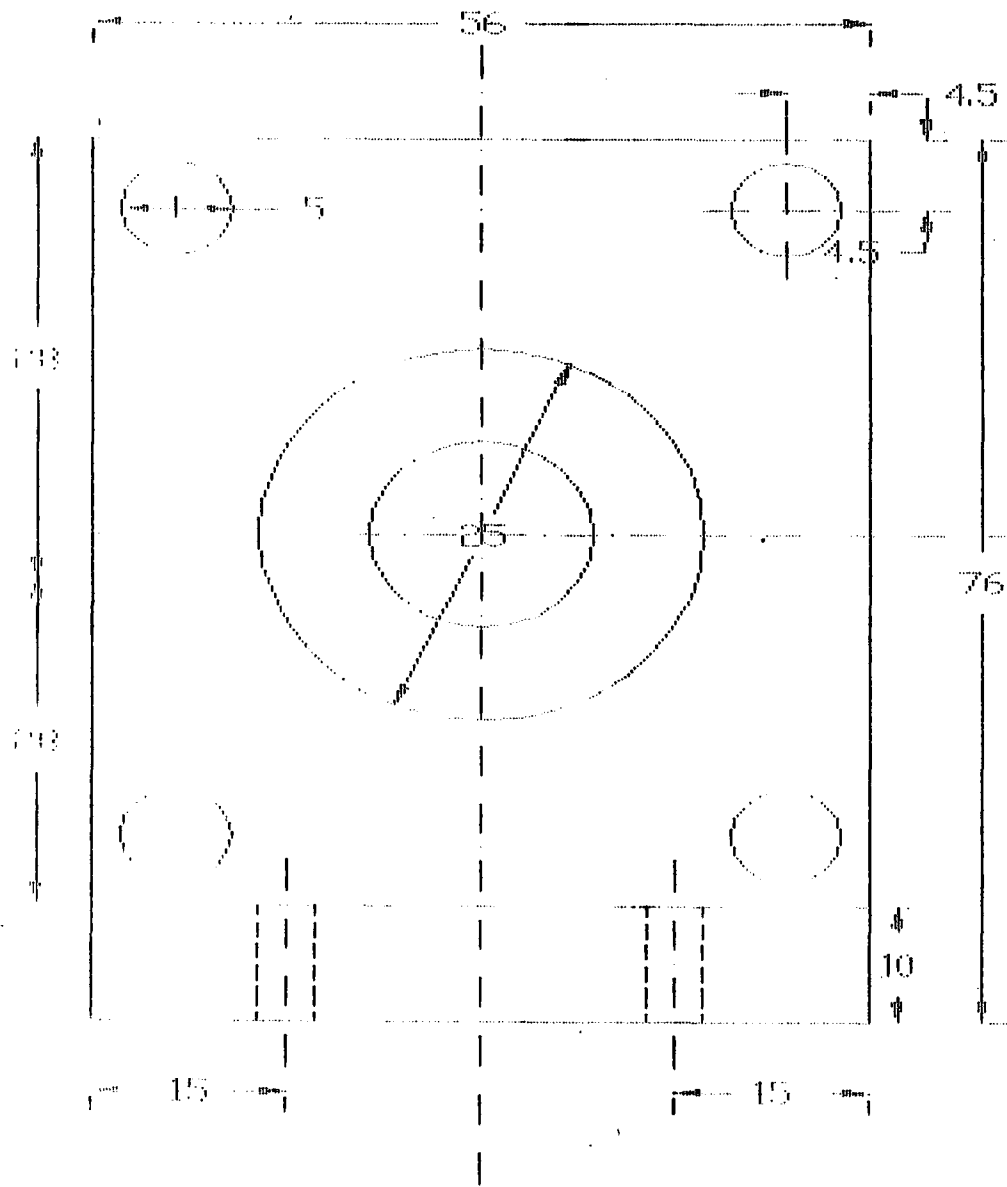


13

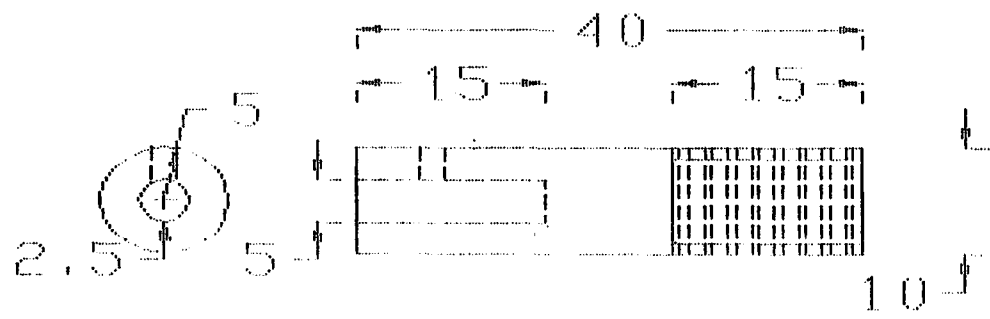
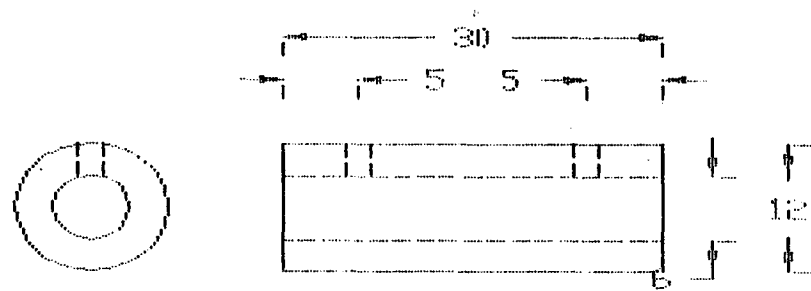


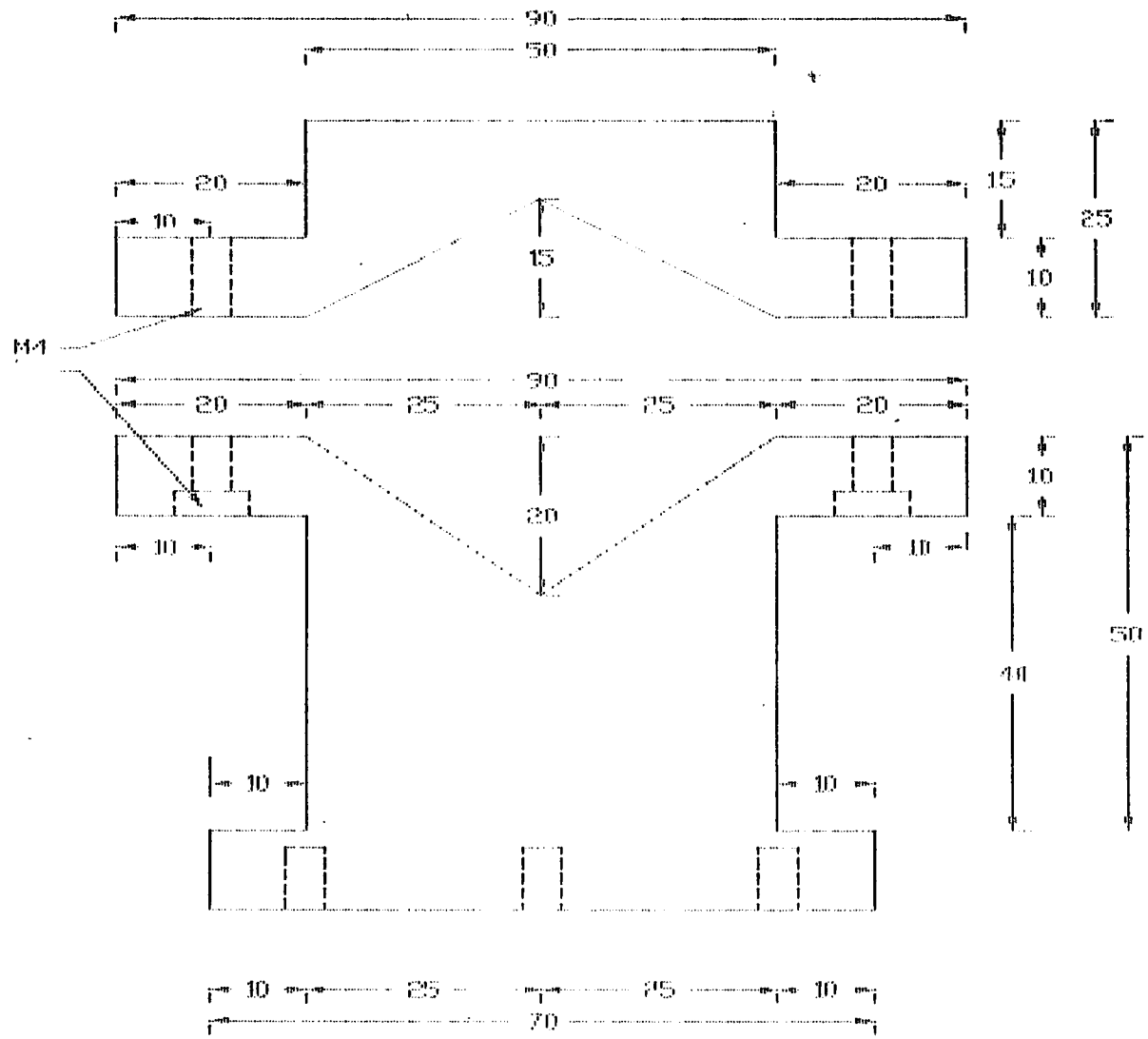


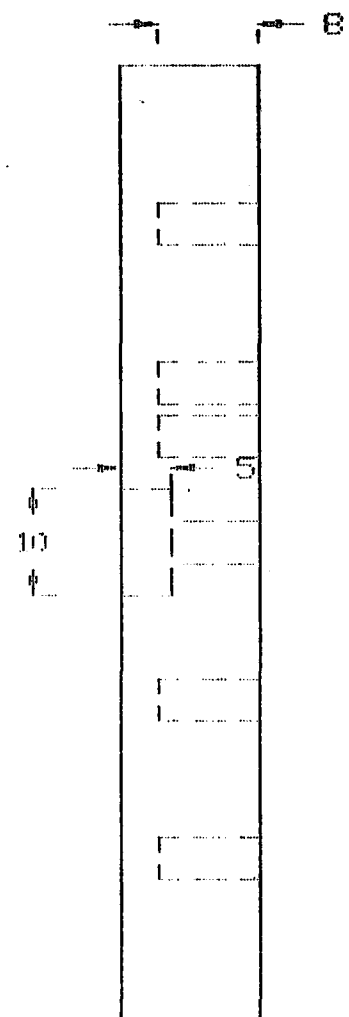
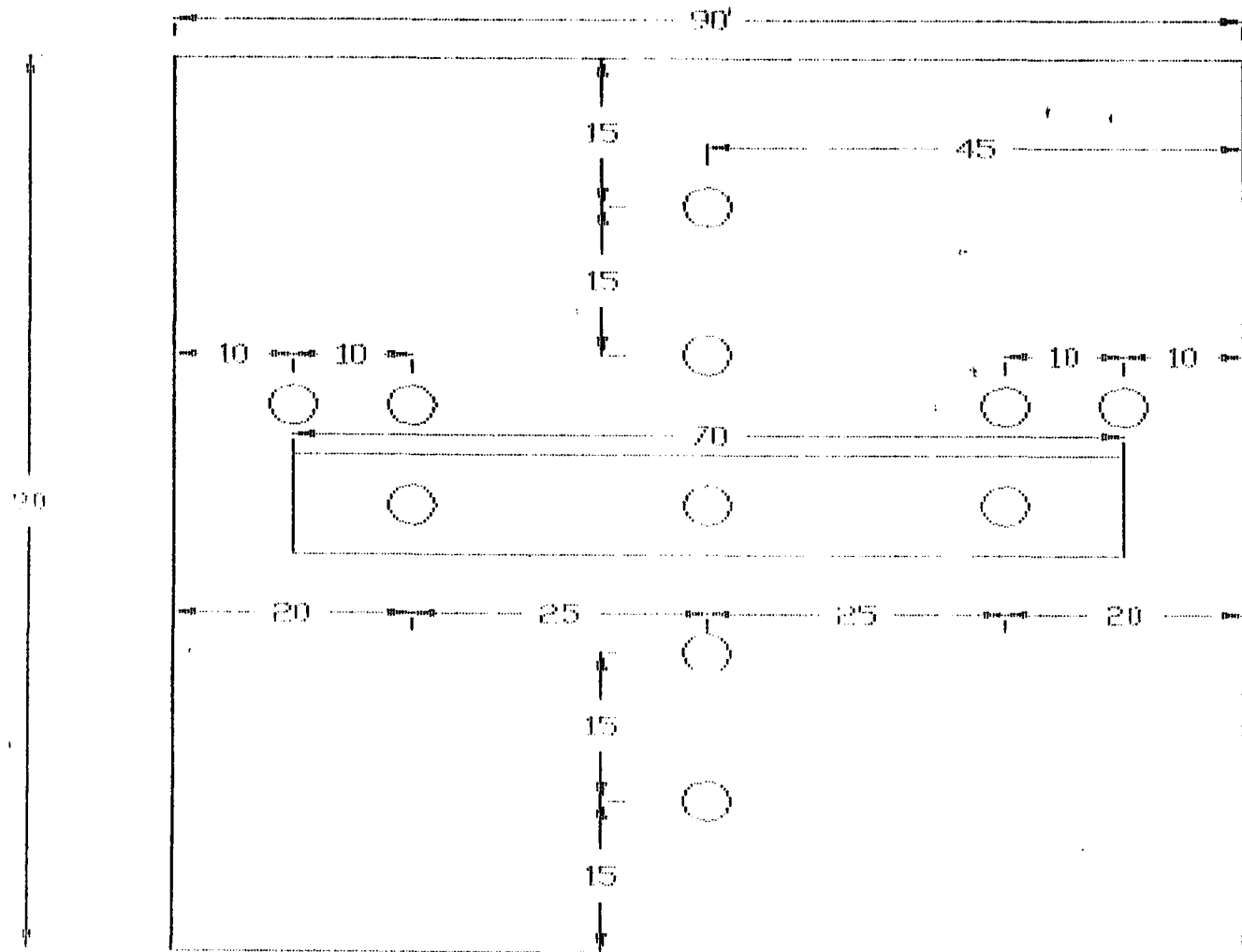


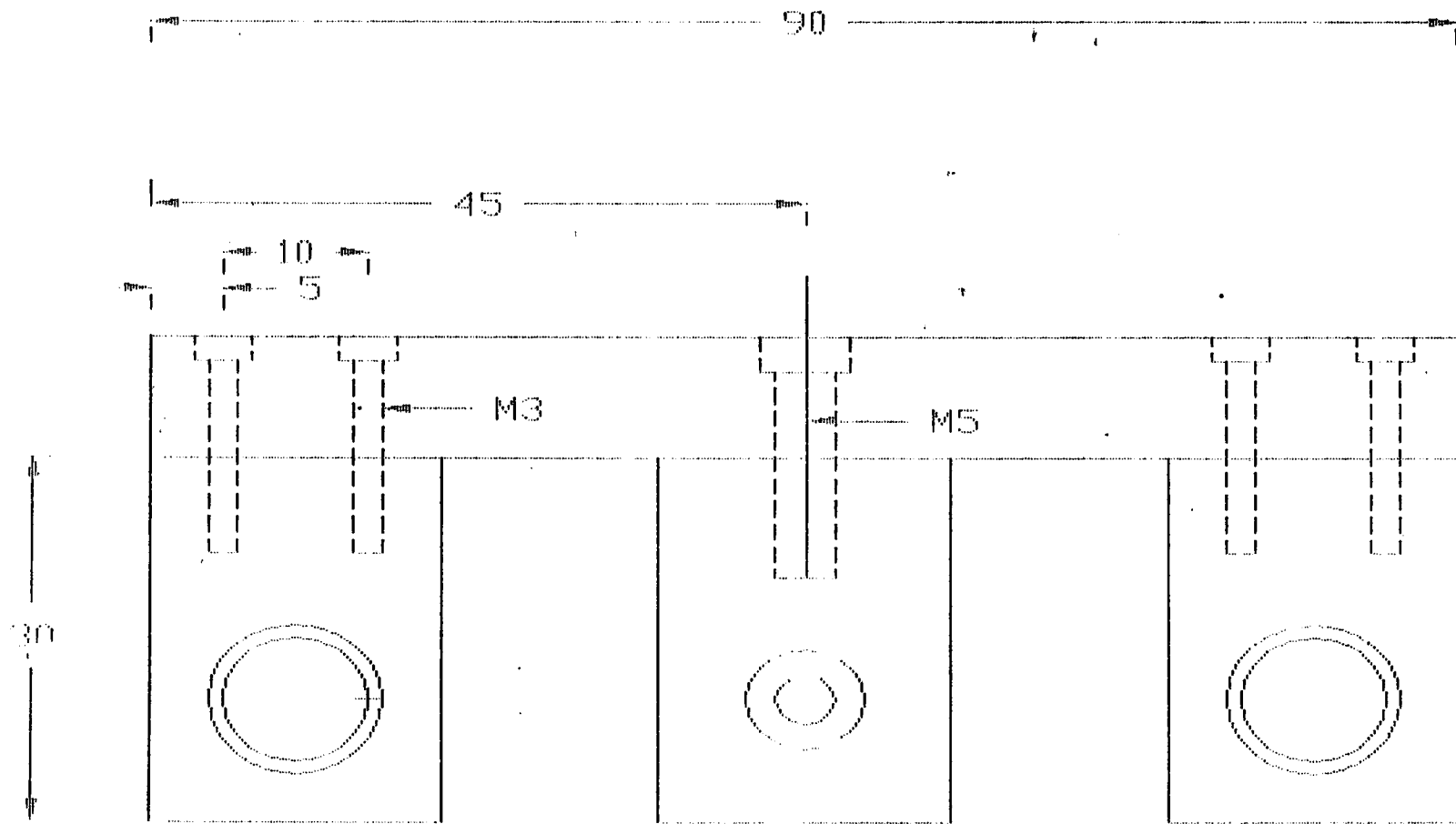


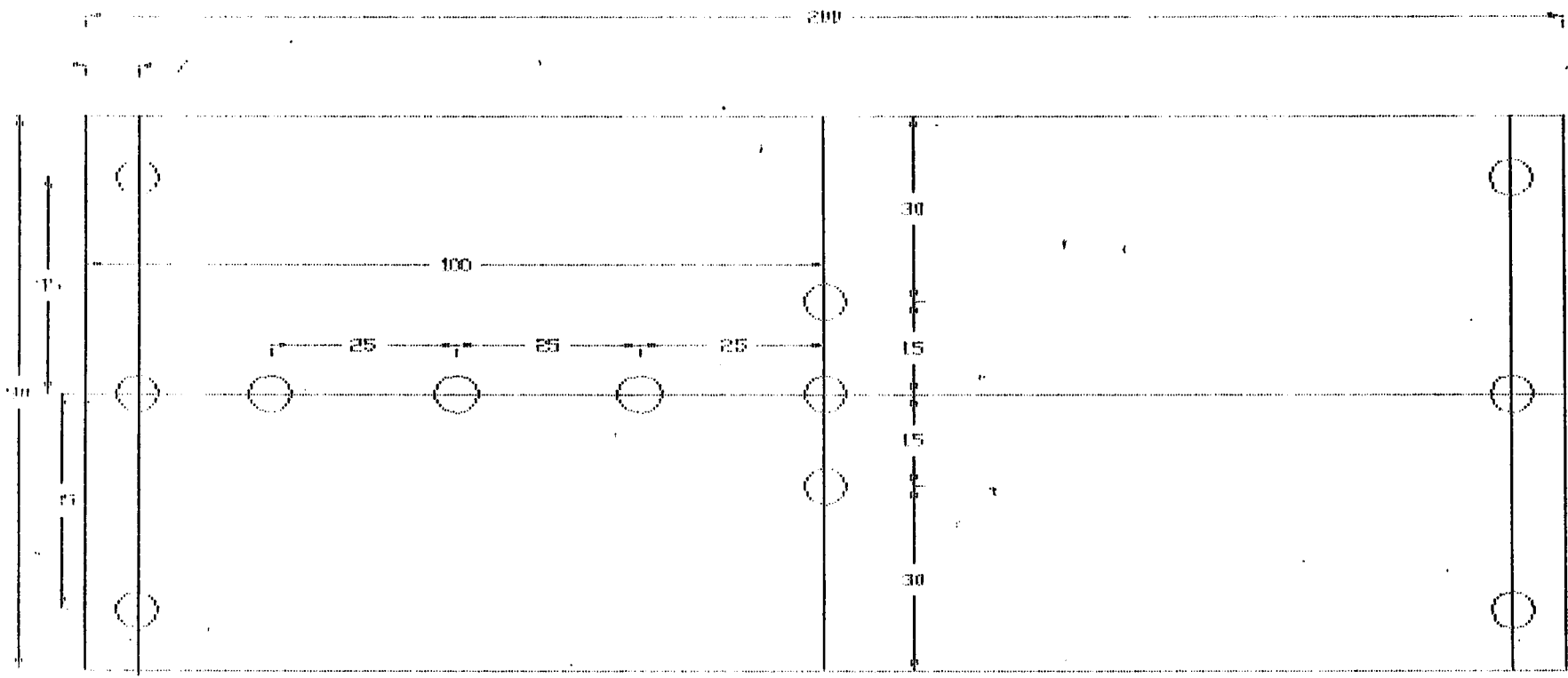
coupling motor

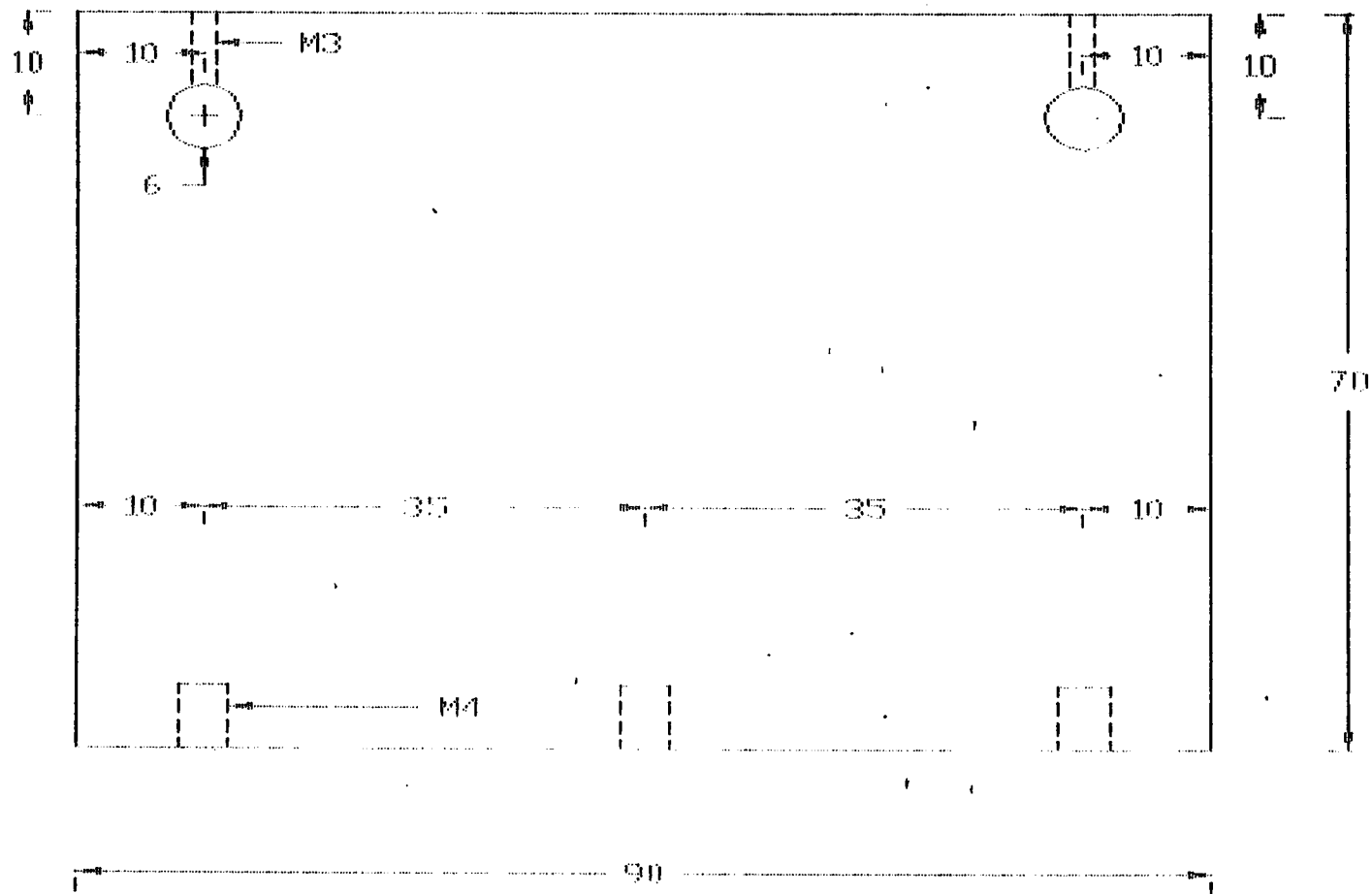


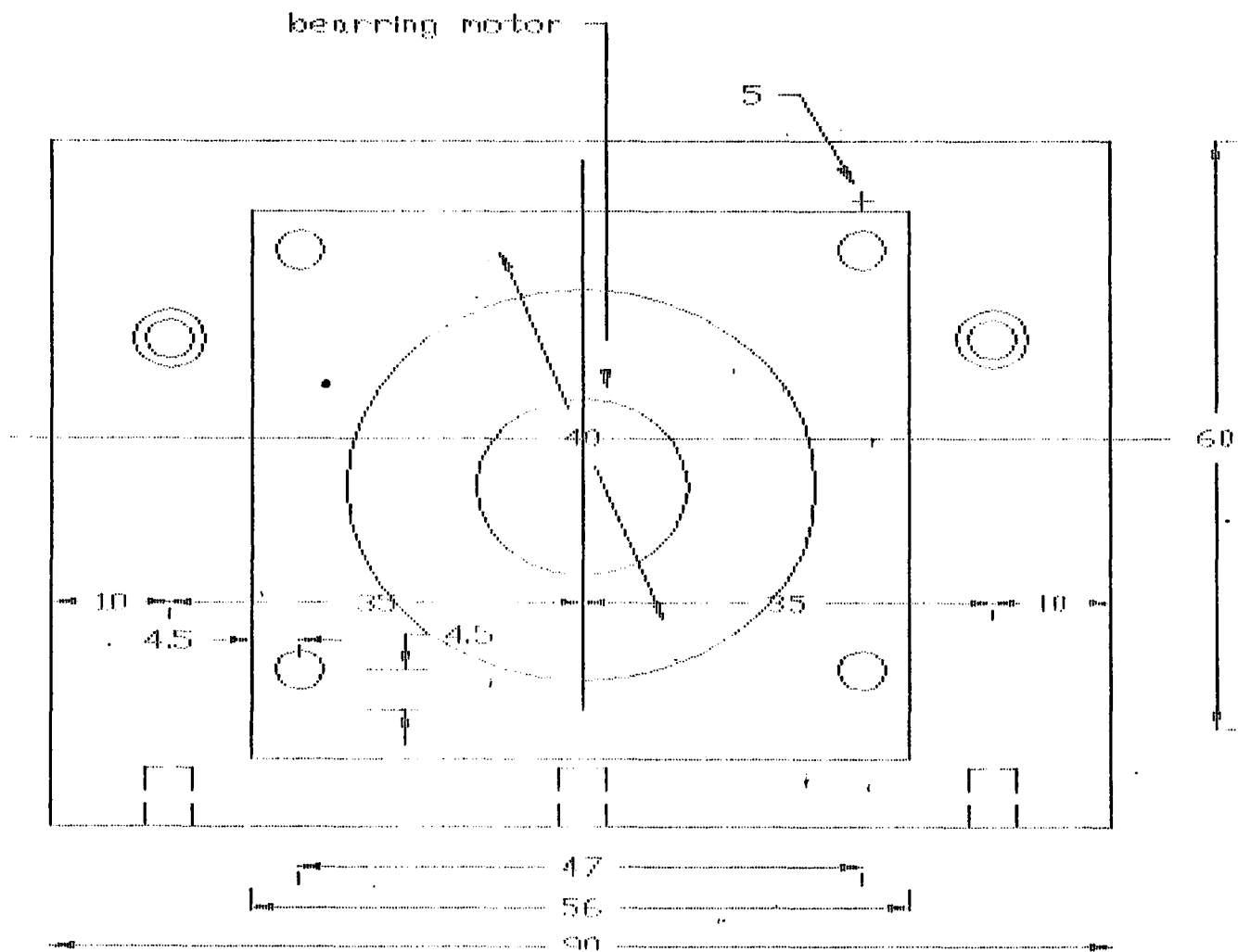


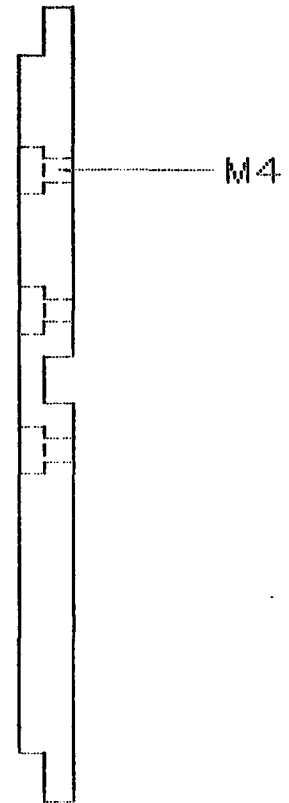
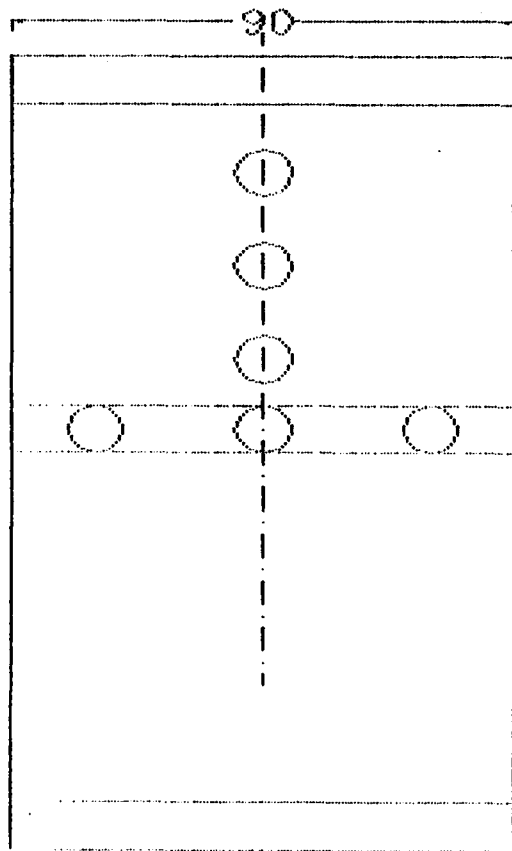


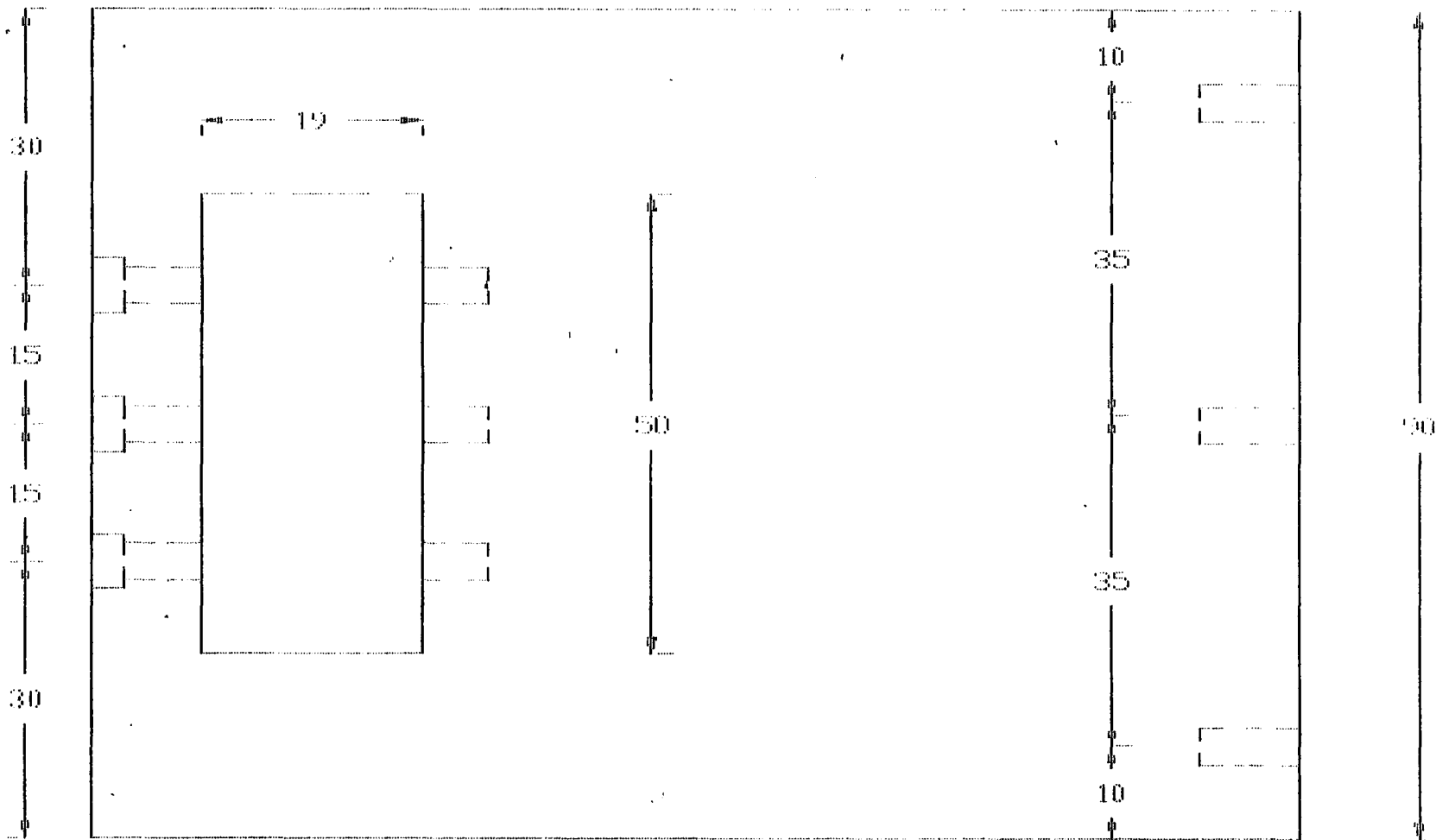




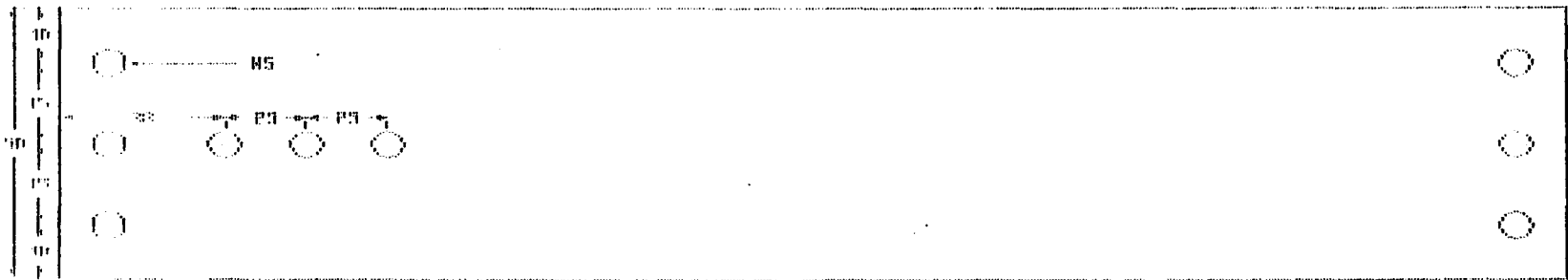


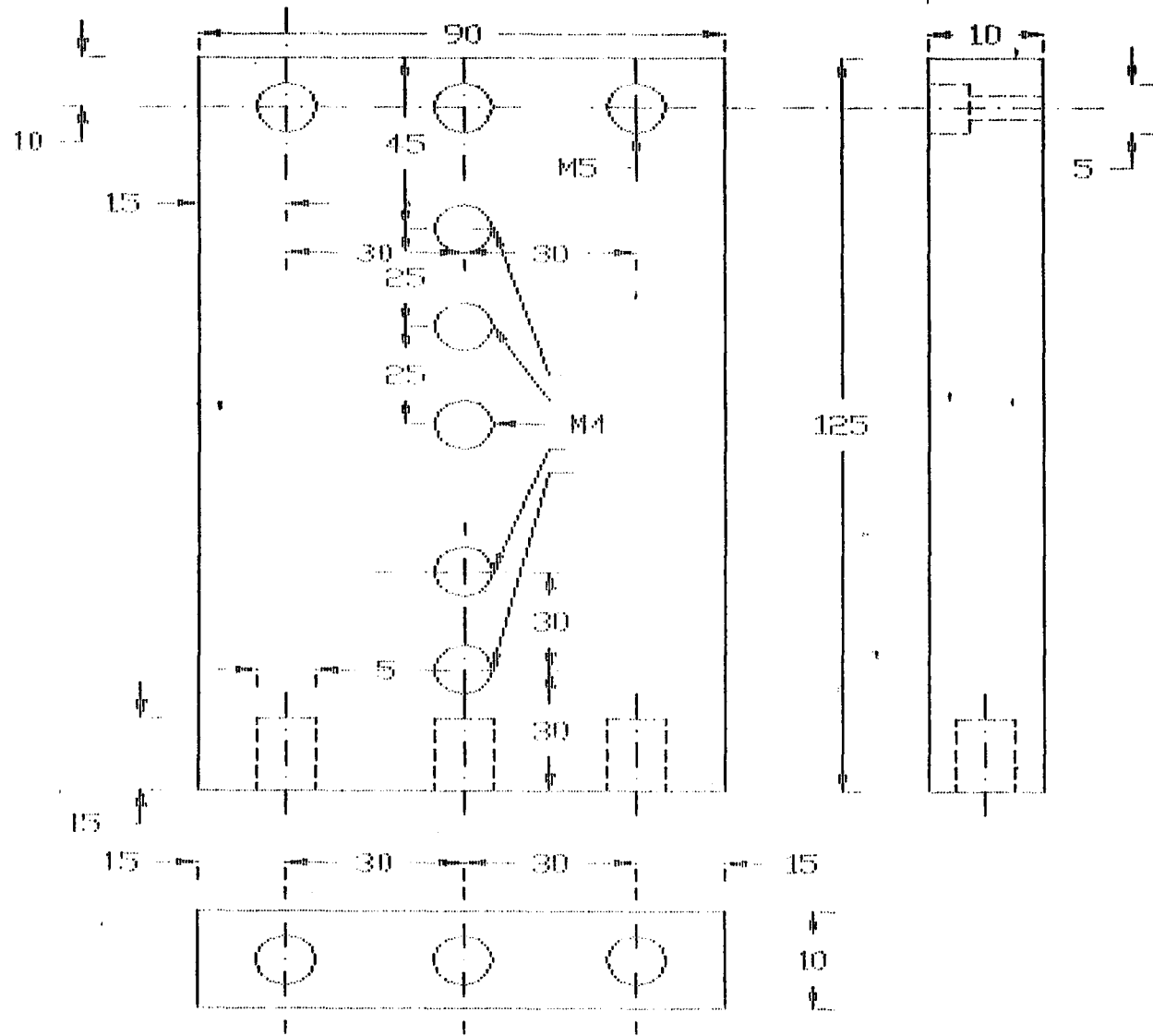


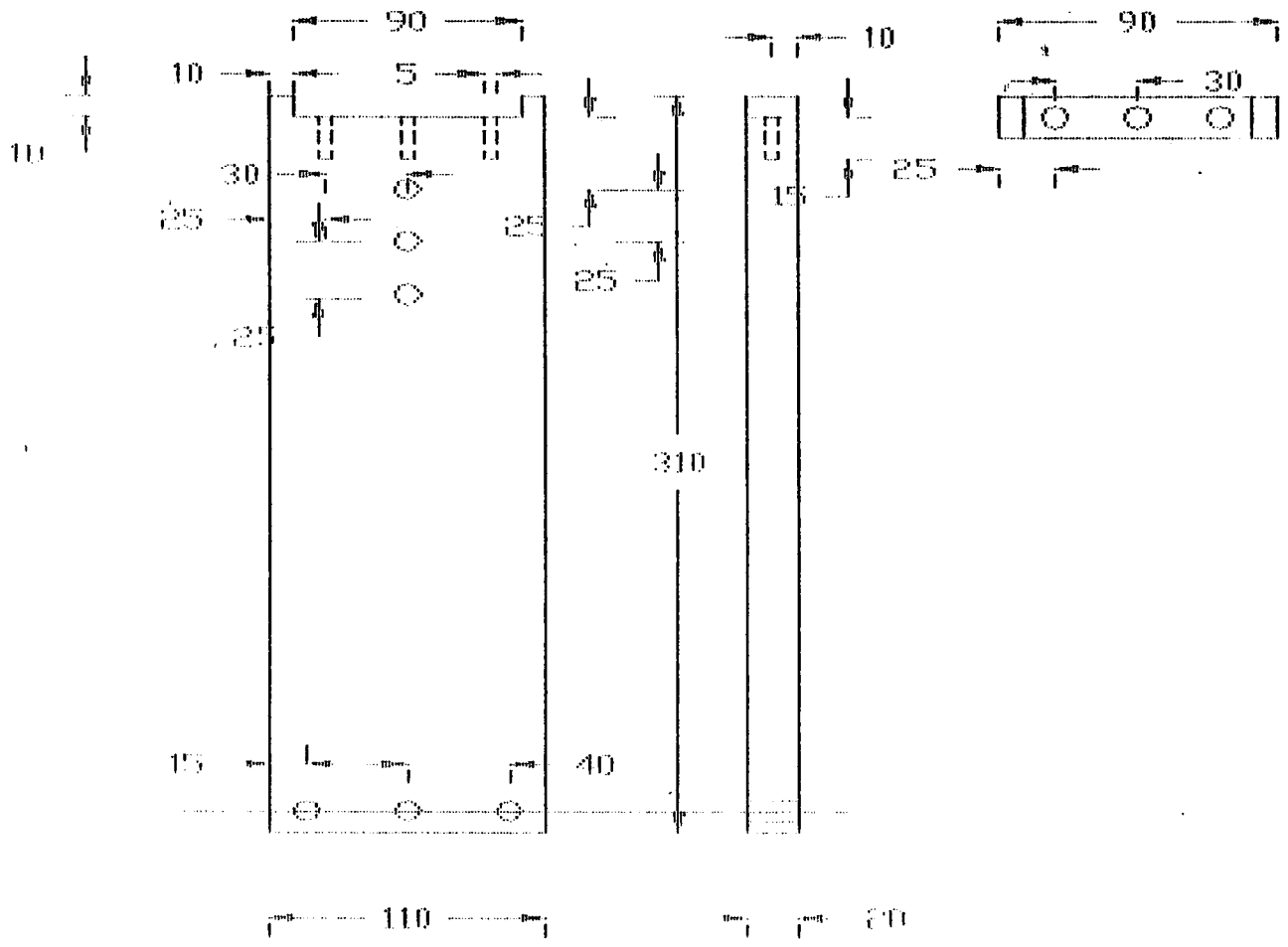


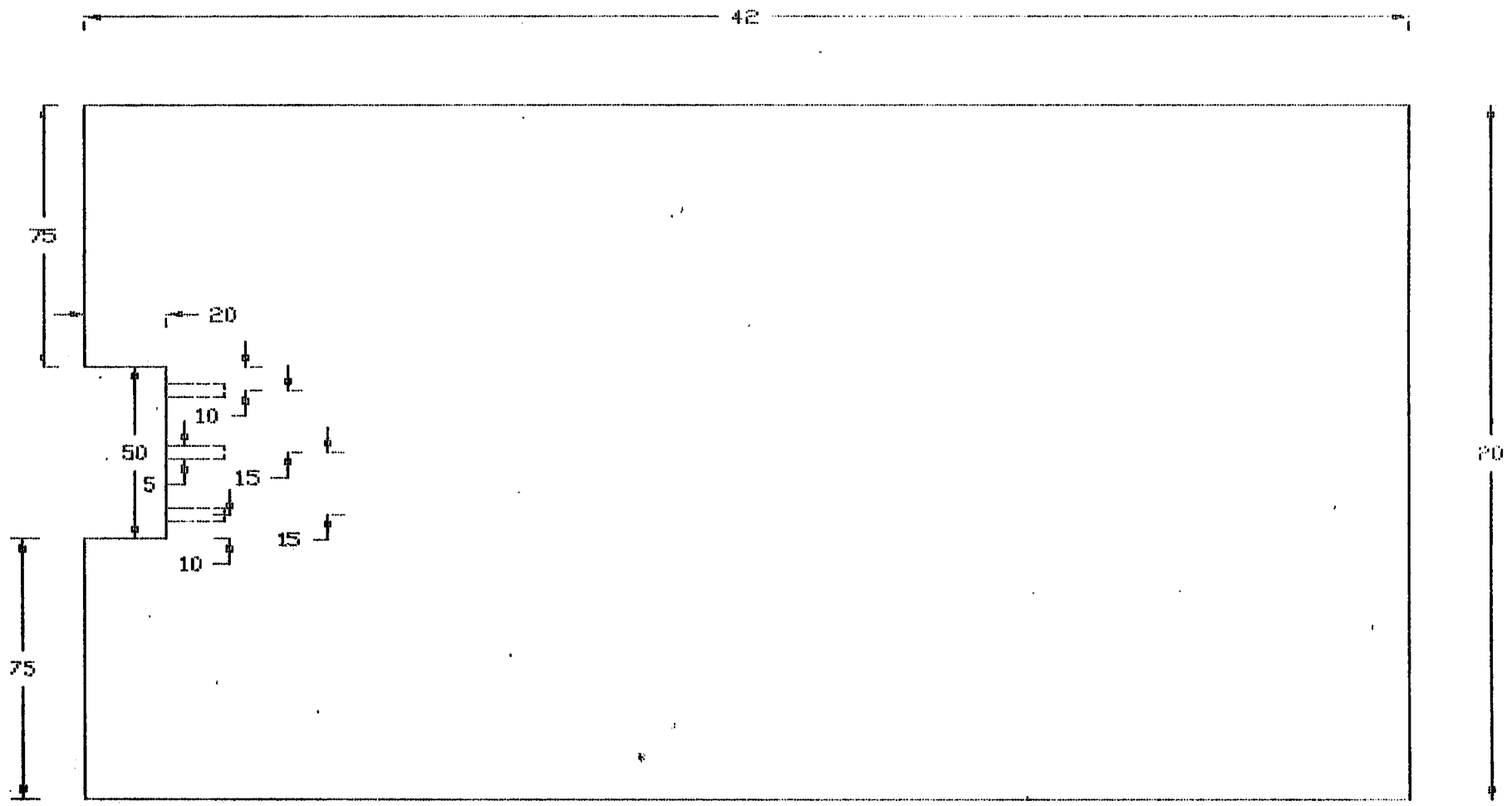


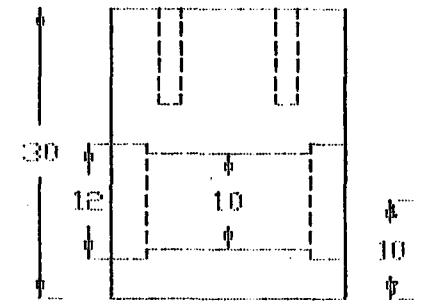
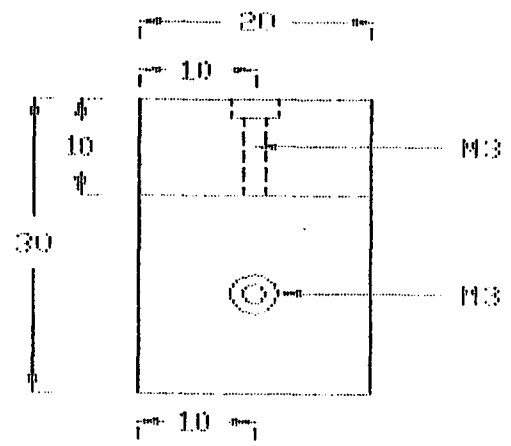
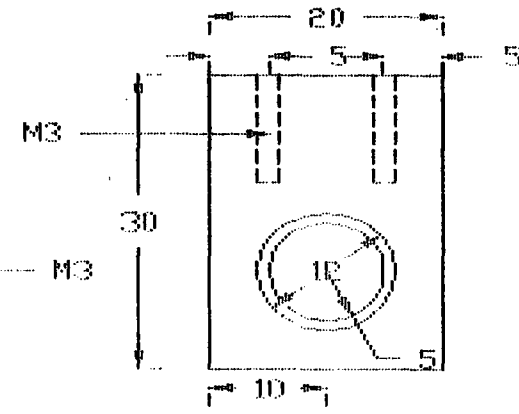
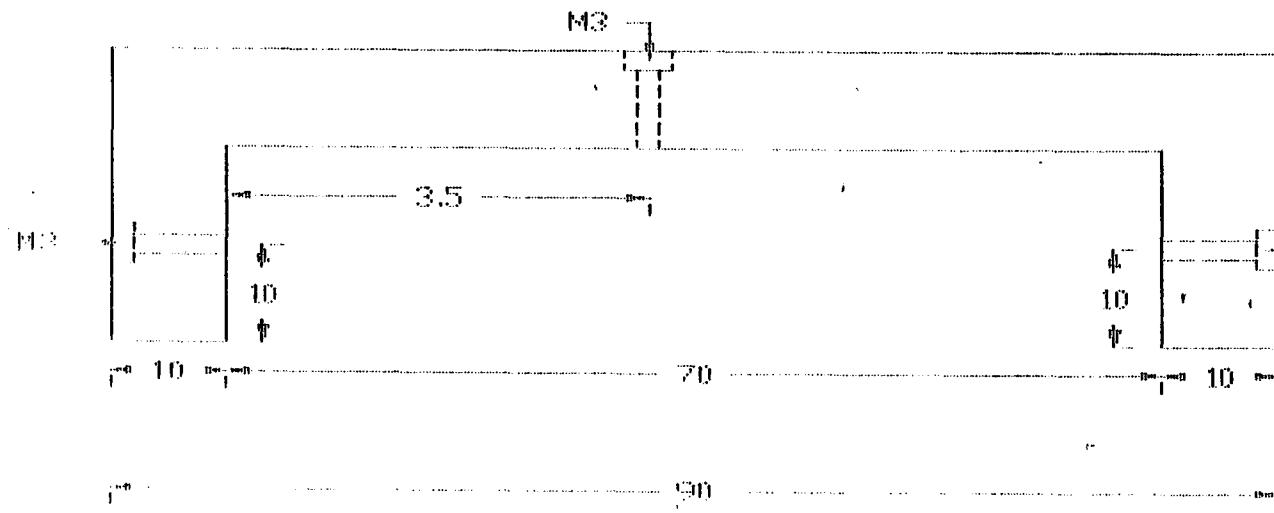
- | - 7











เอกสารอ้างอิง

1. โยธิน เปรมปราณีรัตน์, ระบบเซอร์โว และ อิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลมอเตอร์,
ตำราชุดวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ, 2533
2. จิตี หนงแก้ว, เทคนิคการเชื่อมต่อ IBM PC กับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อประยุกต์ใช้
งานต่าง ๆ, ซีไอเคยูเคชั่น, 2533
3. นกุล กระจ่าง, การเขียนโปรแกรมและประมวลผลข้อมูลด้วยเทอร์โบปาสคาล,
ซีไอเคยูเคชั่น, 2535
4. วัฒนา พลพละ, "กราฟิกพล็อตเตอร์ ขนาด A2/A3 ทำเองกับมือ",
เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 127(2536):25-36
5. OSG CORPORATION, Products Information Vol.54, Japan, 1990
6. THK CO., LTD., Ball Screw and Support Unit for Small OA
Equipment, Japan 1992
7. THK CO., LTD., Ball Screws, Japan 1992